

목 차

분 기 보 고 서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요.....	3
1. 회사의 개요.....	3
2. 회사의 연혁.....	7
3. 자본금 변동사항.....	13
4. 주식의 총수 등	14
5. 의결권 현황.....	15
6. 배당에 관한 사항 등	15
II. 사업의 내용	18
III. 재무에 관한 사항	45
1. 요약재무정보	45
2. 연결재무제표	47
3. 연결재무제표 주식	54
4. 재무제표	99
5. 재무제표 주식	104
6. 기타 재무에 관한 사항.....	146
IV. 감사인의 감사의견 등	157
V. 이사의 경영진단 및 분석의견.....	161
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	162
1. 이사회에 관한 사항.....	162
2. 감사제도에 관한 사항.....	167
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.....	170
VII. 주주에 관한 사항.....	171
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....	176
1. 임원 및 직원의 현황	176
2. 임원의 보수 등	184
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	187
X. 이해관계자와의 거래내용.....	194
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	196
【 전문가의 확인 】	202
1. 전문가의 확인	202
2. 전문가와의 이해관계	202

분기보고서

(제 68 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
 2015년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2015년 5월 15일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 성 욱

본 점 소 재 지 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) <http://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무본부장 (성 명) 이 명 영

(전 화) 02-3459-5541~8

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2015. 05. 15

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사

박 성

박성복

공시 책임자

이 명

이명영

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연 도말 자산총액	지배관계 근 거	주요종속 회사 여부
에스케이하이이엔지㈜	2001.04	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	55,008	지분 50% 초과보유	X
에스케이하이시스템㈜	2008.03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	40,789	지분 50% 초과보유	X
㈜실리콘화일	2002.11	경기도 성남시 분당구 성남대로 343번길9, SK U타 워 16층	전자·전기 부품 개발 및 제조	53,371	지분 50% 초과보유	X
SK hynix America Inc.(SKHYA)	1983.03	3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	반도체판매	1,711,746	지분 50% 초과보유	○
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA)	1995.07	1830 Willow Creek Circle, Eugene OR, 97401, U.S.A	반도체생산	49,061	지분 50% 초과보유	X
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	1995.07	1st Floor, Block 10-3, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15, IRELAND	반도체판매	194,318	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	1989.03	Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str. 16, D-65479 Raunheim, Germany	반도체판매	135,384	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Asia Pte.Ltd.(SKHYS)	1991.09	8 Temasek Boulevard #11-03, Suntec City Tower3, Singapore 038988	반도체판매	386,135	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor India Private Limited(SKHYIS)	2006.11	Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB (International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India	반도체판매	722	지분 50% 초과보유	X
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.(SKHYH)	1995.04	Suite 1707-08, 17/F., Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong	반도체판매	563,598	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1996.09	23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo	반도체판매	285,122	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	1996.07	11F, No.392, Rueyguang Road, Neihu Dist, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C	반도체판매	628,791	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	2001.08	Room 2102-2103A, Gubei International Fortune Center N0. 1438 Hongqiao Road, Shanghai, China	반도체판매	53,853	지분 50% 초과보유	X
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	2005.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼생산 및 판매	4,179,186	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	2006.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼생산 및 판매	269,999	지분 50% 초과보유	○

SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. (SKHYCQL)	2013.09	Xiyong Comprehensive Bonded Zone B Block v2-4/02, Shapingba strict, Chongqing, China	웨이퍼생산 및 판매	341,984	지분 50% 초과보유	○
SK APTECH Ltd. (SKAPTECH)	2013.09	Wanchai, Hong Kong	해외현지투자 가 지주회사	158,383	지분 50% 초과보유	○
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	2010.08	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	반도체판매	22,647	지분 50% 초과보유	X
SK hynix Italy S.r.l. (SKHYIT)	2012.05	V.le Colleori 15, Palazzo Orione 20864 Agrate Brianza (MB), Italy	기술센타	2,610	지분 50% 초과보유	X
SK hynix memory solutions Inc. (SKHMS)	2012.08	3103 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	기술센타	59,922	지분 50% 초과보유	X
SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd. (SKHYFST)	2013.08	6F-1. Mo. 6. Taiyuen 1st(Taiyuen Hi-tech Industrial Park) Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan	기술센타	8,209	지분 50% 초과보유	X
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	2014.06	Kalvaryiskaya, 42 Fifth Floor Minsk, Belarus, 220073	기술센타	3,961	지분 50% 초과보유	X
MMT 특정금전신탁	-	-	특정금전신탁	0	지분 50% 초과보유	X

※ 주요 종속회사 판단기준: 직전 사업연도말 자산총액 750억원 이상

[연결대상회사의 변동현황]

사업 연도	연결에 포함된 종속회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제68기	에스케이하이엔지(주) 등 22개사	-	-	-
제67기	에스케이하이엔지(주) 등 22개사	(주)실리콘화일 Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE)	청산
제66기	에스케이하이엔지(주) 등 21개사	SK APTECH Ltd. SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd. SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.(SKHYFST)	아미파워	청산

※ 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였음.

[연결대상회사의 당기 중 변동내용]

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091

전화번호: 031-630-4114

홈페이지: <http://www.skhynix.com>

마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 반도체소자 제조 및 판매
- 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
- 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
- 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
- 기계부분품 제조업 및 금형제조업
- 기술연구 및 용역수탁업
- 전자 전기기계, 기구의 임대업
- 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
- 정보서비스업
- 출판업
- 무역업
- 부동산 매매 및 임대업
- 발전업
- 건설업
- 전자관 제조업
- 창고업
- 주차장업
- 위성통신사업
- 전기통신회선설비 임대사업

- 전자상거래 및 인터넷 관련사업
- 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

- (1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)
- (2) 기업집단에 소속된 회사 (2015. 3. 31일 기준 계열사 : 82개사)

업종	상장사	비상장사
지주회사(1)	SK(주)	-
에너지 · 화학 (34)	SK이노베이션(주), SK케미칼(주), SKC(주), SK가스(주), (주)부산도시가스	SK E&S(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), (주)대한송유관공사, SK모바일에너지(주), 충청에너지서비스(주), 영남에너지서비스(주), 이니츠(주), 전북에너지서비스(주), 전남도시가스(주), 강원도시가스(주), 엔티스(주), SK유화(주), SKC에어가스(주), 코원에너지서비스(주), SK더블유(주), 유베이스매뉴팩처링아시아 (주), 울산아로마틱스(주), 피엠피(주), 위레에너지서비스(주), 하남에너지서비스(주), SK인천석유화학(주), SK어드밴스드(주), SK트레이딩인터내셔널(주), 당진에코파워 (주), 보령LNG터미널(주), SK배터리시스템즈(주), 에스엠피씨(주)
정보통신/ 전기전자 (18)	SK텔레콤(주), SK커뮤니케이션즈(주), SK브로드밴드(주), SK C&C(주), SK하이닉스(주), SKC솔믹스(주), (주)아이리버	SK플래닛(주), SK텔레시스(주), SK텔링크(주), 인포섹(주), (주)커머스플래닛, 텔레비전미디어코리아(주), 네트워크오앤에스(주), (주)실리콘화일, (주)에이앤티에스, SKC라이팅(주), 피에스앤마켓팅(주)
건설/물류/서비스 (23)	SK네트웍스(주)	SK건설(주), SK해운(주), 행복나래(주), SK디앤디(주), 엠앤서비스(주), (주)SK엔카닷컴, 에프앤유신용정보(주), SK네트웍스서비스(주), SK하이신택(주), (주)네오에스네트웍 스, 네트럭(주), SK신택(주), 스피드모터스(주), SK하이이엔지(주), 지허브(주), 엠케이에스개런티(유), SK임업(주), 대전맑은물(주), 광주맑은물(주), SK핑크스(주), 서비스에이스(주), 서비스탑(주)
금융(1)	SK증권(주)	-
기타(5)	(주)유비케어, 바이오랜드(주)	SK바이오팜(주), SK와이번스(주), 제주유나이티드FC(주)

(*) 사명 변경 : 울산아로마틱스(주) (舊 아로케미(주)), 행복나래(주) (舊 엠알오코리아(주)),
SK하이신택(주) (舊 (주)하이신택), SK하이이엔지(주) (舊 (주)하이닉스엔지니어링), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주))
SK배터리시스템즈(주) (舊 SK컨티넨탈이모션코리아(주))

사. 신용평가에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 다음과 같습니다.

구분	평가기관	현등급	최종평가일
국내	NICE신용평가	A+	2014.06.20
	한국기업평가	A+	2014.05.30
	한국신용평가	A+	2014.06.18
해외	Moody's	Ba1	2014.12.12
	S&P	BB+	2014.11.21

최근 3개 사업연도 신용등급과 관련한 상세 내역 및 각 등급에 따른 정의는 본 보고서 'II. 11. 가 최근 3년간 신용등급'을 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 중요한 변동상황

(1) 회사의 주된 변동내용

1949. 10	국도건설 주식회사 설립
1983. 02	현대전자산업주식회사로 상호 변경
1996. 12	기업공개 및 상장
1997. 03	대표이사 김영환 외 이사 5인 변경 선임 이사 5인, 감사 1인 변경 선임
1999. 05	LG그룹과 LG반도체 주식 양수도 계약 체결
1999. 07	LG반도체 대주주 지분 인수
1999. 10	현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
2000. 03	박종섭 대표이사 외 이사 1인, 감사위원 2인 변경 선임
2000. 05	전장사업부문 (주)현대오토넷으로 분사
2000. 08	모니터사업부문 "현대이미지퀘스트(주)"로 분사
2001. 03	주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경 박상호 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
2001. 05	통신단말기 사업부문 "현대큐리텔"로 분사 통신 ADSL 사업부문 "현대네트웍스"로 분사
2001. 07	통신 네트워크 사업부문 "현대시스콤"으로 분사
2001. 08	현대그룹으로부터 계열분리
2001. 10	채권금융기관 공동관리 시작
2001. 12	현대큐리텔, '팬텍 컨소시엄'에 지분 매각
2002. 01	현대시스콤, '쓰리알'에 지분 매각
2002. 05	시러스 로직社와 파운드리 전략적 장기공급 계약체결 박종섭 대표이사 사임

2002. 06 최대주주 변경(현대상선(주) → (주)한국외환은행)

2002. 07 우의제 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임

2002. 12 현대네트웍스, '엠비엔'에 지분 매각

2003. 02 박상호 대표이사 사임

2003. 04 STMicro社와 낸드플래시 메모리 공동 개발 및 파운드리 공급 계약 체결

2003. 06 환경/안전/보건 기술연구소 설립

2004. 06 매그나칩반도체 유한회사와 비메모리 사업부문 영업양도계약 체결

2004. 08 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시와 중국 현지공장설립 협력계약 체결

2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도

2004. 11 STMicro社와 중국 현지 합작공장설립을 위한 협력계약 체결

2005. 03 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호 사외이사 선임
박시룡, 장운중 사외이사 임기만료 퇴임

2005. 07 채권금융기관 공동관리 조기종료
현대이미지케스트(주), (주)빅터스캐피탈코리아에 지분 매각

2005. 10 (주)현대오토넷 지분매각 완료
출자전환주식 공동관리협의회 1차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)

2006. 03 권오철 이사, 손방길 사외이사 선임, 정형량 이사 임기만료 퇴임

2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립

2006. 06 출자전환주식 공동관리협의회 2차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)

2006. 09 300mm 연구소(R3 R&D Fab) 개소

2007. 03 김종갑 대표이사 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 4인 포함) 선임
- 이사 선임: 김종갑, 최진석
- 사외이사 선임: 박종선, 김경한, 조동성, 김형준
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호
우의제 대표이사 임기만료 퇴임
이사 1인(오춘식), 사외이사 4인(김범만, 김수창, 이선, 이준호) 임기만료 퇴임

2007. 04 청주 신규 M11(300mm) 공장 착공

2007. 07 공정거래 자율준수프로그램 도입

2007. 10 환경운동연합과 '환경경영검증위원회' 협약 체결

2007. 11 '일하는 이사회'를 위한 신(新)이사회 제도 도입

2008. 02 김경한 사외이사 중도 퇴임

2008. 03 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
사외이사 3인(황학중, 민형욱, 손방길) 임기만료 퇴임

2008. 06 정홍원 사외이사 중도 퇴임

2009. 03	권오철 이사 재선임 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 이사 선임: 권오철, 박성욱 -. 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
2009. 11	중국 후공정 합작사 HITECH 설립
2010. 03	최대주주 변경((주)한국외환은행 → 한국정책금융공사) 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 미래에셋자산운용투자자문(주)) 권오철 대표이사외 이사 1인 신규 선임, 김종갑 이사 재선임 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 이사 선임: 김종갑, 권오철, 김민철 -. 사외이사 선임: 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 김창호
2010. 06	중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
2010. 08	최대주주 변경(미래에셋자산운용투자자문(주) → 한국정책금융공사)
2010. 10	최대주주 변경(한국정책금융공사 → 국민연금공단)
2011. 03	사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 사외이사 선임: 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑희, 정상환 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 조현명
2011. 09	정상환 사외이사 중도 퇴임
2012. 02	최대주주 변경(국민연금공단 → 에스케이텔레콤(주)) 사외이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 이사 선임: 최대원, 하성민, 박성욱 -. 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
2012. 06	미 컨트롤러 업체 LAMD(Link_A_Media Devices) 인수 본계약 체결
2012. 09	플래시 솔루션 디자인 센터 설립
2013. 03	김준호 사내이사 1인 신규 선임
2014. 03	이사 2인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임 -. 이사 선임: 임형규 -. 사외이사 선임: 최종원 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원 이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임 -. 이사 선임: 박성욱
2015. 03	-. 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 김대일, 이창양 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양

(2) 종속회사의 주된 변동내용

1983. 03 미국 현지법인(HSA) 설립

1989. 03	독일 현지법인(HSD) 설립
1991. 08	싱가폴 현지법인(HSS) 설립
1995. 04	홍콩 현지법인(HSH) 설립
1995. 07	영국 현지법인(HSE) 설립 영국 현지판매법인(HSU) 설립
1995. 08	미국 생산법인(HSMA) 설립
1996. 07	대만 현지법인(HST) 설립
1996. 09	일본 현지법인(HSJ) 설립
2001. 05	사업지원 서비스부문 "(주)현대아스텍" 분사
2001. 07	LCD 사업부문 "(주)현대디스플레이테크놀로지"로 분사
2001. 08	중국 현지판매법인(HSCS) 설립
2001. 12	"에스알씨(주)" 분사
2002. 11	"(주)현대디스플레이테크놀로지" TFT-LCD 사업부문 매각
2005. 04	중국 합작법인(HSSL) 설립 에스알씨(주)→(주)큐알티반도체 사명 변경 (주)현대아스텍→(주)아스텍 사명 변경
2006. 04	중국 현지생산법인(HSMC) 설립
2006. 10	중국 현지생산법인(HSMC) 준공
2007. 01	인도 현지법인(HSIS) 설립
2008. 03	(주)아스텍에서 (주)하이닉스인재개발원 분할 (주)아스텍에서 (주)하이스트으로 분할 (주)아스텍에서 (주)하이로지텍으로 분할 (주)아스텍에서 (주)하이닉스엔지니어링으로 분할
2010. 01	(주)하이닉스엔지니어링에서 (주)아미파워로 분할
2010. 08	중국 현지판매법인(HSCW) 설립
2011. 09	"(주)현대디스플레이테크놀로지" 청산, 주요종속회사 제외 "프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁" 청산, 주요종속회사 제외
2012. 06	낸드플래시 개발업체 아이디어플래시(Ideaflash S.r.l.) 인수, 이탈리아 기술센터(SK Hynix Italy S.r.l.) 전환 설립
2012. 10	(주)하이닉스엔지니어링, (주)큐알티반도체 흡수합병 (주)하이스트, (주)하이로지텍/(주)하이닉스인재개발원 흡수합병
2012. 10	(주)하이닉스엔지니어링→에스케이하이이엔지(주) 사명 변경 (주)하이스트→에스케이하이스트(주) 사명 변경
2013. 09	아미파워(주) 청산, 주요종속회사 제외
2014. 04	에스케이하이이엔지(주) 에서 큐알티(주) 분할 설립 주식교환으로 실리콘화일(주) 인수
2014. 06	벨라루스 소재 연구개발법인 Softeq Flash Solutions LLC. 인수
2014. 07	SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE) 청산, 종속기업 제외
2014. 09	큐알티(주) 지분 전량 매각

나. 상호의 변경

1983. 02	현대전자산업주식회사로 상호 변경
2001. 03	주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
2012. 03	에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·양도 등

1999. 10	현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
2004. 10	비메모리 사업부문 영업양도
2011. 11	에스케이텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약
2014. 01	(주)실리콘화일과 포괄적 주식교환계약

라. 생산설비의 변동

2006. 10	중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 C2(300mm), C1(200mm)공장 준공
2008. 07	미국 유진 공장 E1(200mm) 가동 중단
2008. 08	청주 신규 NAND Flash 전용 M11공장(300mm) 준공
2008. 09	이천 M7(200mm) 및 청주 M9(200mm) 공장 가동 중단
2008. 12	중국 C1(200mm) 공장 가동 중단
2010. 06	중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
2012. 06	청주 신규 NAND Flash 전용 M12공장(300mm) 준공

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2005. 01	전력 소모 30% 줄인 서버용 메모리 모듈 개발
2005. 01	대만 프로모스社와 전략적 제휴를 위한 본계약 체결
2005. 07	2GB DDR2-667 노트북용 모듈 업계 최초 인텔社 인증 획득
2005. 07	당사 출자전환 주식 공동관리 협의회와 '특별 약정' 체결
2005. 11	JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발
2005. 12	512Mb GDDR4 DRAM 개발
2006. 03	80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔社 인증 획득
2006. 12	200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발 60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈 개발
2007. 03	ECC회로 적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
2007. 04	퓨전메모리 제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산
2007. 05	80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품 및 모듈 인텔社 인증 획득 초박형(25 μ m) 20단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
2007. 08	200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발

	이노베이티브 실리콘사와 신개념 메모리 'ZRAM' 라이선스계약 체결
2007. 09	초박형(25 μ m) 24단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package)개발
2007. 10	오보닉스사와 차세대 메모리 'PRAM' 기술 라이선스 계약 체결
2007. 11	1Gb GDDR5 개발
	50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득
	실리콘화일사와 CMOS 이미지 센서(CIS) 사업 추진을 위한 협력 계약 체결
2008. 01	50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈 인텔사 인증 획득
2008. 03	피델릭스사와 전략적 제휴를 위한 협력계약 체결
2008. 04	그란디스사와 'STT-RAM' 라이선스 및 공동개발계약 체결
2008. 05	프로모스사와 포괄적 제휴 협력 계약 체결
2008. 06	파이슨사와 낸드플래시 응용제품 기술에 대한 사업협력계약 체결
	실리콘화일사 지분취득 결정 및 기존 파운드리 계약범위 확대
	3중셀(X3) 기술 기반 32Gb 낸드플래시 개발
2008. 07	씨엔에스테크놀로지사와 시스템반도체 공동개발 및 파운드리 협력계약 체결
2008. 08	뉴모닉스사와 낸드플래시 기술 및 제품 공동 개발 협력계약 체결
	16GB 서버용 모듈 개발
2008. 12	8단 적층 낸드플래시 개발
	50나노급 2Gb 고용량 모바일 DRAM 개발
2009. 01	DDR3 서버용 모듈 4GB ECC UDIMM 인텔사 인증 획득
2009. 02	40나노급 DDR3 DRAM 개발
2009. 05	뉴모닉스사 및 파이슨사와 낸드플래시 응용제품용 컨트롤러 3자 공동개발 계약 체결
	중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 무석산업발전집단유한공사와 합작 반도체 후공정 전문회사 설립을 위한 본계약 체결
2009. 06	4GB 1333Mbps 노트북용 모듈 외 10건 인텔사 DDR3 전용 플랫폼 인증획득
2009. 07	대만 프로모스사와 전략적 제휴 협력계약 종결
2009. 08	50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔사 인증 획득
2009. 10	2세대 1Gb DDR3 개발
2009. 12	40나노급 2Gb GDDR5 개발
2010. 01	40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발
2010. 02	20나노급 64Gb 낸드플래시 개발
2010. 09	휴렛팩커드(HP)사와 Re램 공동개발 계약 체결
2010. 12	30나노급 4Gb DDR3 개발
2011. 03	30나노급 2Gb DDR4 개발
2011. 07	도시바사와 STT-MRAM 공동개발 및 합작사 설립을 위한 공동생산 계약 체결
2012. 03	30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품 인증 획득
2012. 04	스팬션사와 특허사용 크로스라이선스 및 SLC낸드플래시 공급계약 체결
2012. 06	IBM사와 PC램 공동개발 및 기술 라이선스 계약 체결
2012. 08	20나노급 64Gb 낸드플래시 저탄소제품 인증 획득
2012. 09	20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발

2013. 06	20나노급 8Gb LPDDR3 개발 램버스社와 포괄적 특허 라이선스 계약 체결
2013.07	삼성전자와 반도체 특허 크로스라이선스 계약 체결
2013.10	20나노급 6Gb LPDDR3 개발
2013.12	20나노급 8Gb LPDDR4 개발
2014.04	20나노급 8Gb DDR4기반 128GB 모듈 개발
2014.05	20나노급 모바일 D램 저탄소 제품 인증 획득
2014.09	차세대 와이드 IO2 모바일 D램 개발
2014.10	최대용량 비휘발성 하이브리드 D램 모듈 개발
2015. 02	도시바와 NIL 기술 공동 개발 계약 체결
2015. 02	사업연속성경영시스템(ISO22301) 인증 획득

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2010년 01월 04일	전환권행사	보통주	28,608	5,000	23,328	2010.01.04~2010.03.22
2010년 04월 01일	전환권행사	보통주	565,120	5,000	23,328	2010.04.01~2010.06.25
2010년 07월 08일	전환권행사	보통주	44,150	5,000	23,328	2010.07.08~2010.09.01
2010년 10월 29일	전환권행사	보통주	115	5,000	23,328	2010.10.29~2010.11.16
2011년 01월 13일	전환권행사	보통주	434,385	5,000	23,328	2011.01.13~2011.03.25
2011년 04월 01일	전환권행사	보통주	1,460,643	5,000	23,328	2011.04.01~2011.06.10
2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2012.02.13
2012년 02월 14일	유상증자(제3자 배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000	
2012년 02월 15일	전환권행사	보통주	4,159	5,000	23,328	2012.02.15~2012.02.23
2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328	
2012년 05월 02일	주식매수선택권 행사	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수선택권 행사
2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2012년 08월 20일	전환권행사	보통주	21	5,000	23,328	
2012년 10월 30일	주식매수선택권 행사	보통주	30,300	5,000	22,800	우리사주매수선택권 행사
2012년 12월 07일	전환권행사	보통주	3,016	5,000	23,328	2012.12.07~2012.12.18
2013년 02월 13일	전환권행사	보통주	9,527	5,000	23,328	2013.02.13~2013.03.28

2013년 04월 01일	전환권행사	보통주	551,689	5,000	23,328	2013.04.01~2013.06.27
2013년 07월 02일	전환권행사	보통주	15,483,908	5,000	23,328	2013.07.02~2013.08.05
2014년 04월 22일	-	보통주	1,358,537	5,000	-	주식교환
2014년 05월 27일	전환권행사	보통주	4,562,354	5,000	34,394	2014.05.27~2014.06.26
2014년 07월 01일	전환권행사	보통주	10,285,078	5,000	34,394	2014.07.01~2014.09.29
2014년 10월 01일	전환권행사	보통주	1,595,505	5,000	34,394	2014.10.01~2014.10.06

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2015년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당기말 현재의 유통주식수는 보통주 728,001,795주 입니다.

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수		9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수		5,721,980,209	-	5,721,980,209	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수		4,993,977,844	-	4,993,977,844	-
	1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합(21:1)
	2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)		728,002,365	-	728,002,365	-
V. 자기주식수		570	-	570	2014.04.22 주식교환
VI. 유통주식수 (IV-V)		728,001,795	-	728,001,795	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익	직접 취득	장내	보통주	-	-	-	-	-	-
		직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		장외	보통주	-	-	-	-	-	-

범위 이내 취득		직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)			보통주	-	570	-	-	570	주식교환
			우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)			보통주	-	570	-	-	570	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	728,002,365	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	570	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	728,001,795	-
	우선주	-	-

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

(2) 제54조(중간배당)

- ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
- ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- ⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제68기 1분기	제67기	제66기
주당액면가액 (원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		1,295,730	4,195,456	2,872,857
주당순이익 (원)		1,780	5,842	4,045
현금배당금총액 (백만원)		-	218,401	-
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	5.2	-
현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.6	-
	우선주	-	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	-	300	-
	우선주	-	-	-
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 상기 금액은 연결 재무제표 기준이며, 당기순이익, 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 사용함.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장조사기관인 가트너(Gartner, 2015년 3월, 금액기준)에 따르면, 지난 2014년도 세계 반도체 시장규모는 US\$ 3,403억에 이르렀으며, 이중 메모리 제품은 US\$803억의 시장규모를 기록하며 전체 반도체 시장의 약 24% 수준에 달하였습니다. 또한 메모리 반도체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 DRAM은 지난 2014년 US\$461억을 기록하며 전체 메모리 시장의 약 57%를 차지하였고, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US\$ 298억으로 37%, 노어플래시가 US\$ 22억으로 3%를 차지하였습니다.

아래 표에 나타낸 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 수출에 있어서 12.1%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2014년 반도체 수출은 DRAM 시장 개편 및 수요 증가로 전년 대비 9.2% 증가하였습니다.

※ 전체 수출중 반도체 비중

(단위: 백만USD, %)

구분	2014	2013	2012	2011	2010
총수출	572,664	559,649	548,076	555,214	466,384
반도체	63,065	57,741	50,949	50,879	51,464
전년비 증감율	9.2	13.3	0.1	-1.1	61.2
비중	12.1	10.3	9.3	9.2	11.0

출처 : 관세청, 2015년 2월

이러한 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 구분됩니다.

가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM (Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 과점화 되는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전 제품의 디지털화에 따라 스마트TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다.

낸드플래시 제품이 주로 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응의 중요성이 커지고 있습니다.

나) 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분류가 되며, 자사는 이중 CIS를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 비메모리 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있으며, 특히 CIS의 사용 분야 중 스마트폰과 태블릿PC향의 출하량과 매출 비중이 각각 50%를 넘어 고성장 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다. 2011년과 2012년에는 저성장을 기록하였으나 2014년에 전체 반도체는 전년 동기 대비 7.9%, 메모리 반도체 분야는 16.9%의 높은 성장을 기록하여 2년 연속 최대 매출을 기록하였습니다. 2015년 또한 DRAM수요는 PC 및 모바일에서 서버 영역으로, NAND 수요는 모바일에서 PC와 Server 대용량 스토리지 영역으로 주요 수요처가 확대되며 지속적인 성장이 예상됩니다.

메모리 반도체 시장의 지속 성장 전망에 반해 생산(공급) 측면은 제한적인 증가가 예상됩니다. 공정 미세화 기술은 한계에 다다르고 있으며, 생산 및 연구 개발을 위한 투자 비용이 급증하고 있는 반면, 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 더욱 다양화 및 고도화되고 있습니다. 이에 기존과 같은 외형 경쟁을 위한 무리한 공급 확대는 제한적일 것으로 전망됨에 따라, 향후 메모리 반도체 산업은 안정적 수요와 제한적인 공급으로 인해 메모리 시장 성장의 기회가 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

[DRAM]

시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2015년 3월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 세계 경제의 점진적 회복 및

모바일 시장 확대, 공급 안정 등의 요인으로 2013년 \$349억(+33%), 2014년 \$461억(+32%)의 큰 폭의 매출 성장을 기록하였습니다. 분야별로 살펴 보면, PC 시장은 경기 침체로 인한 저성장 기조가 유지되어 DRAM 수요를 견인하는데 어려움을 겪고 있으나, 2014년 Windows XP의 서비스 종료를 전후로 노후 PC의 교체 수요가 회복되었으며, 개인용 컴퓨터의 이동성(mobility)에 대한 요구가 증가함에 따라 울트라북 등 노트북 컴퓨터로의 교체 및 신규 수요가 확대될 전망입니다. 한편, 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 모바일 기기는 DRAM 수요를 견인하는 주요 분야로서, 스마트폰과 태블릿 PC에서 채용하는 DRAM 용량은 2013년 각각 0.76GB와 0.90GB에서 2019년에는 2.96GB와 2.79GB 으로 증가될 것(Gartner, 2015년 3월)으로 예상됩니다, 또한, 고화질의 콘텐츠 유통 증가와 주요 게임 콘솔의 출시에 따라 이를 빠르게 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 증가할 전망입니다. 상기와 같이 디지털 기기의 증가에 따른 DRAM 수요 증가뿐만 아니라, 대용량 콘텐츠 처리를 위한 기기당 탑재량 증가에 따라 DRAM 수요는 앞으로도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices) 등에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2015년 3월, 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 2013년에는 23%(\$289억)의 고성장을 이루었으며, 2014년에도 3.1%(\$298억)의 성장을 기록하였습니다. 이는 스마트폰, 태블릿 PC를 포함한 휴대용 기기 및 PC용 SSD, 기타 응용복합 제품 등 향후 낸드플래시의 수요를 견인할 제품 시장의 지속적 성장 전망에 기반한 것입니다.

향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가 전개되며 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 일부 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또한번의 도약을 할 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라 등 다양한 분야에 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 스마트폰, 태블릿 PC의 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다. 가트너(Gartner, 2015년 3월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지센서 시장은 2013년 US\$93억에서 2019년 US\$133억 규모로 연평균 6.1%의 성장이 예상되며, 특히 당사가 생산중인 CMOS 이미지센서 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서의 비중이 2013년 87%에서 2019년 95%까지 증가하며 연평균 7.5%의 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다. 실제로 메모리 반도체의 경우 미국과 유럽의 매출액 비중은 2013년 24%에서 2019년 22%로 축소가 예상되는 반면, 아시아 지역의 매출액 비중은 2013년 74%에서 2018년 78%로 지속 증가할 전망입니다.(Gartner, 2015년 3월, 금액기준)

[DRAM]

DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 서버 및 모바일로 분산되고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화 됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 SSD 등으로 바뀌고 있으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿PC, 노트북, PC, Server, Storage, Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어든 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스, 후방 카메라, 스마트TV 등 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 이미지 센서 중 자사가 생산중인 CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 기술 및 원가 경쟁력, 2. 시장 대응 능력(고객확보, 제품 포트폴리오) 3. 설비투자 능력 등이 있습니다. 최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다.

지금까지는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화함에 따라 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술 업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2015년 1분기는 계절적 수요 약세의 영향으로 인한 출하량과 가격이 소폭 하락한 가운데 당사는 미세공정 전환을 가속화하고 고부가가치 제품 비중 확대를 통한 수익성 중심 경영에 주력하였습니다.

당사의 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 약 29% 증가한 약 4조 8천 1백 8십 3억 원을 기록하였으며, 연결기준

영업이익은 전년 동기 대비 약 50% 증가한 약 1조 5천 8백 8십 5억 원을 기록하였습니다. 연결기준 당기순이익은 전년 동기 대비 약 61% 증가한 약 1조 2천 9백 5십 5억 원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 1분기 (2015.01.01~ 2015.03.31)	제67기 4분기 (2014.10.01~ 2014.12.31)	전분기 대비 증감	제67기 1분기 (2014.01.01~ 2014.03.31)	전년 동기 대비 증감
매출액	4,818,341	5,147,931	-6.4%	3,742,690	28.7%
영업이익	1,588,530	1,667,158	-4.7%	1,057,266	50.2%
당기순이익	1,295,456	1,624,084	-20.2%	802,254	61.5%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제68기 1분기 누계]

(단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	4,818,341	100.0%	DRAM, NAND Flash, MCP 등
합계	4,818,341	100.0%	

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자부품 제조업(분류번호: 321)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율

구 분	'14년	'13년	'12년	'11년	'10년
DRAM	27.1%	26.6%	24.7%	22.8%	21.8%
NAND Flash	10.8%	10.7%	9.9%	11.7%	9.5%

출처: IDC, 2015년 3월, 매출액 기준

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

(가) 메모리반도체 사업

[DRAM]

컴퓨팅 메모리(Computing Memory) 사업의 경우 가격이 높고 품질의 신뢰성이 바탕이 되어야 하는 고용량(High Density) 서버용 제품 비중과 이동성 확대에 따른 노트북(Notebook) 및 울트라북(Ultrabook) 제품의 비중이 확대되고 있습니다.

PC 출하량은 Tablet 등 Mobile Device 성장에 따라 2013년 큰 폭으로 감소하였으나, 전년 이후 Tablet 성장세 둔화 등에 기인하여 감소폭은 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 2015년은 ULT(Ultra-Light and Thin) form

factor 및 Chromebook을 포함한 저가 PC 수요 증가로 Consumer PC 수요 회복이 전망되고 있습니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)과 스마트 기기의 성장에 따른 인터넷 데이터 트래픽의 폭발적인 증가로 인하여 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 특히 Google, Facebook, Microsoft와 같은 대형 인터넷 포털 업체의 데이터 센터는 서버 시스템 수요를 빠르게 증가시키고 있는 추세입니다. 당사는 TCO(Total Cost of Ownership) 절감을 중요시하는 데이터 센터의 제품 효율성 요구 증대에 부응하기 위해 저전력과 고속의 서버용 모듈(Module) 제품을 공급하고 있습니다. 한편 2014년 출시된 Intel Haswell-EP CPU로 인해 서버용 DDR4 메모리 수요가 점차 증대되는 추세이며 이는 2016년 Broadwell-EP CPU의 출시 이후 본격적인 시장 증대가 전망됩니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory)는 동영상 및 3D 그래픽 기술의 발전과 함께 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 주요 그래픽 칩셋 업체들과의 전략적 관계강화를 통하여 데스크탑, 노트북용, HPC용 등 PC 그래픽 및 기존 Game외에 의료, 교육, Network Communication 등 분야로 활용 영역을 넓히고 있는 차세대 게임콘솔 분야에서도 주도적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

컨슈머 메모리(Consumer Memory) 시장은 스마트 디지털TV, 디지털 셋톱박스(Set-top Box), 블루레이 플레이어(Blu-ray player) 등의 디지털 영상 가전제품, 프린터를 포함한 PC 주변기기, 자동차용 네비게이션 제품 등에 다양하게 사용됩니다. 또 당사는 클라우드 컴퓨팅 확대에 따른 네트워크 인프라 장비에 맞는 고용량, 고속의 첨단 컨슈머 메모리를 개발하여 경쟁력 있는 제품을 시장에 공급하고 있으며, 고온 및 저온에도 견딜 수 있는 극한 환경에 특성화된 IT(Industrial Temperature) 제품과 AT(Automotive Temperature) 제품을 개발, 공급하는 등 고객의 다양한 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 휴대전화뿐만 아니라 모바일 특성에 연산 기능이 향상된 태블릿PC, 울트라북에도 사용되고 있으며, 디지털 카메라, 네비게이션, MP3 플레이어 등과 같은 모바일 컨슈머 제품등에도 채용이 확대되고 있습니다. 라이프 스타일 변화에 따른 IT 수요 증가 및 무선 통신 환경의 발전, 정보통신 융합(Convergence)의 가속화로 현재 가장 성장성이 높은 제품입니다. 스마트폰과 태블릿의 성능 강화와 다양한 Wearable 기기 등장 그리고 신형 시장의 스마트폰 보급률 확대 추세는 향후에도 모바일 메모리 제품의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하였습니다. 낸드플래시 시장이 이렇게 성장을 지속하는 이유는 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서 낸드플래시 채용률이 지속적으로 높아지고 있기 때문입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대에 따른 채용량 증가로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 스마트TV, 스마트카 등의 신개념 도입으로 인하여 과거에 저용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 분야에서도 고용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근에는 SSD(Solid State Drive)와 같은 낸드플래시를 기반으로 한 다양한 형태의 Storage Solution이 노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은 낸드플래시 시장에서 당사는 저용량부터 고용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용분야별 선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한, 높은 기술력을 바탕으로 Floating Gate 방식의 10nm대 Planar

NAND 및 3D NAND를 개발, 빠른 NAND 시장 변화에 발 맞추어 대응하고 있습니다.

(나) 비메모리반도체 사업

회사는 지난 2007년 11월, 제품 포트폴리오를 더욱 다양화하고, 기존 메모리 사업 역량을 활용하여 안정적인 수익성과 높은 투자효율성이 기대되는 CIS 사업에 재진출하였습니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2011년부터 2017년까지 연평균 성장률 약 16%의 시장을 형성할 것이라고 예상되고 있습니다. (출처: Techno-Systems Research, 출하량 기준)

현재는 모바일 폰과 노트북, 태블릿에 가장 많이 쓰이고 있으나 최근 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR 및 캠코더, 자동차, 보안 장비, 게임기, 가전 제품 등으로 응용 범위가 급속히 확대되고 있습니다. 전체 Application 중 수량 비중이 가장 큰 모바일 폰의 경우, 화상 통신이 가능한 전면부 카메라(Front Facing Camera)와 사진 촬영을 위한 후면부 카메라(Rear View Camera)용으로 두 개의 이미지 센서가 장착되고 있으며 이러한 경향은 태블릿에도 반영되어 기기당 이미지 센서 탑재 비율 역시 늘어나는 추세입니다.

최근 Smartphone 시장과 Phablet 시장에서는 서브 카메라로 2M/5M 제품과 메인 카메라로 8M/13M가 보편화되고 있으며, Flagship model에는 16M/21M와 같은 초 고사양 제품이 후면 카메라로 채용되고 있습니다. 한편, 노트북 용 이미지센서 시장은 HD, FHD가 주류를 이루고 있으며 일부 저가 model에는 VGA 제품으로 전환되는 경향을 보이고 있습니다. 나아가 태블릿 역시 VGA~5M의 제품이 전면 카메라와 후면 카메라에 채용되고 있습니다.

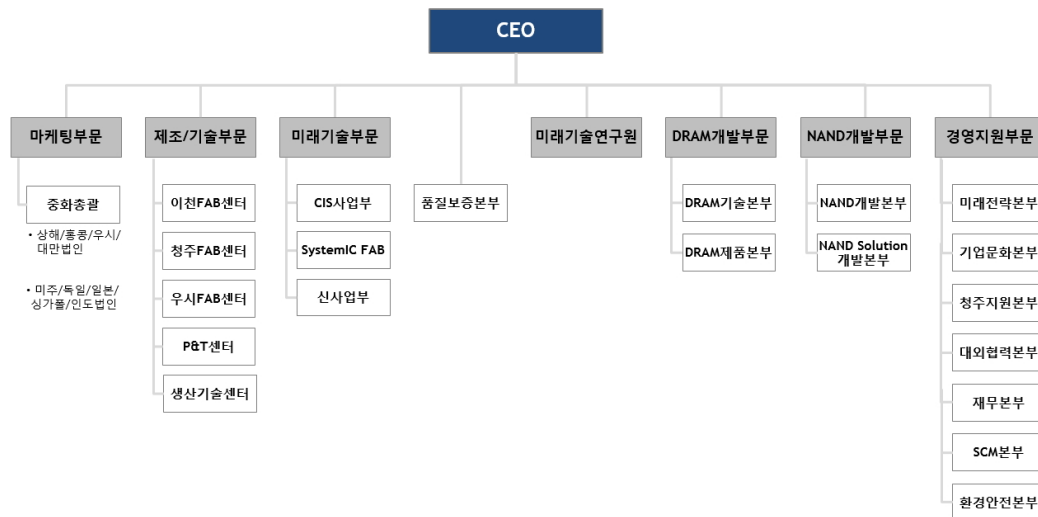
당사는 센서 중 가장 많은 수량 비중을 점유하고 있는 모바일폰 응용시장과 이와 유사한 특징을 요구하고 있는 노트북 시장, 그리고 최근 급속한 성장세를 보이고 있는 Tablet과 Toy 시장에 집중하고 있으며, 고화소 시장로의 진입을 위해 5M/8M 나아가 13M 라인업 구축을 위해 노력하고 있습니다. 아울러 응용 시장 확대를 통해 신규 시장 및 지역, 고객을 발굴하여 매출의 안정성 강화와 사업 수익성을 개선하고 있으며, 새로운 시장 및 고객을 창출하기 위해 IP개발과 신기술 확보를 통해 기술 및 가격 경쟁력을 보유한 제품 개발에도 주력하고 있습니다.

2012년 4분기에는 BSI(Back-Side Illumination) 기술을 적용한 제품 개발이 완료되었으며, 2013년부터 BSI 기술을 적용한 8M, 5M, FHD, HD 제품의 안정적 생산과 효율적인 고객대응으로 마켓 포지션을 강화하고 있습니다. 2014년 4분기에는 첫 13M 제품 출시를 통해 고화소 시장으로도 확대하고 있습니다.

시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, Chipset, AP 업체 등과 협업을 통한 제품 기획과 판매가 최근 활발히 이루어지고 있으며, 최근 모바일 디바이스의 얇은 Bezel 특성을 맞추기 위해 두께를 낮추는 소형화 추세에도 발맞추어 가고 있습니다.

그리고 고객과 시장 확대를 위하여 국내, 중국, 일본 뿐 아니라 미구주 지역 등에서도 다양한 마케팅 활동과 고객 지원활동을 진행하고 있으며, 고객 확대와 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 강화해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도(제출일 기준)



다. 사업부문별 재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, MCP 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	4,818,341 (100%)
합계					4,818,341 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

2014년 DRAM 가격은 우호적인 수급환경에 힘입어 PC DRAM 등 전 제품에 걸쳐 안정적 가격 환경이 유지되었습니다. 2015년 1분기에는 계절적 수요 약세 영향으로 DRAM 가격 하락이 이루어졌습니다.

또한 2014년 NAND 가격은 시장 공급 증가 및 원가 절감에 따라 가격 하락이 지속되었으며, 2015년 1분기에도 계절적 수요 약세에 따라 가격 하락이 계속되었습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 섬스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

Lead Frame은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

Substrate는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땜하여 회로기능을 완성시키는 인쇄 배선판입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비 고
반도체 부문	원재료	Wafer	F A B	97,400	11	-
		Lead Frame& Substrate	P K G	52,084	6	-
		PCB	M O D	38,474	4	-
		기타		354,800	41	-
		소 계		542,757	62	-
	저장품	S/P , 부재료		328,401	38	-
	합 계			871,159	100	-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 독일, 미국, 한국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입 하고 있습니다. 당사는 당사와 거래하는 매입처 등과 일상적인 영업 활동 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

웨이퍼는 그 원재료가 되는 폴리 실리콘의 수급 동향에 따라 300mm 웨이퍼 완제품 가격이 큰 영향을 받습니다. 특히, 폴리 실리콘은 웨이퍼 이외에도 태양전지(Solar Cell)의 원료로도 사용되기 때문에 태양전지의 수요에 따라 폴리 실리콘의 일시적 부족현상이 발생하면 웨이퍼의 공급에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서, 당사는 주요 원재료인 웨이퍼의 원활한 확보를 위해 유가 및 폴리 실리콘 시장

의 가격동향은 물론, 동일한 원재료를 사용하는 태양전지 수급동향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

최근 반도체 공정에 사용되는 웨이퍼 수요 증가 추세에 따라 당사는 웨이퍼 시장의 수급동향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 당사 주요 매입처와의 중장기적 협력 관계 강화를 통해 안정적 생산 자원 및 대응력을 강화해 나갈 것입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 국내사업장 기준 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2015년 1분기의 총 가동일은 90일로, 각 지역별 팹(Fab)의 가동인원 및 가동률을 고려하여 계산한 당사의 평균 가동시간은 월 12,163,680시간입니다.

생산능력은 "해당 분기까지의 최대생산일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2015년 1분기 생산능력은 2,755,351백만원입니다.

(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	제68기 1분기	제67기 연간	제66기 연간
반도체 부문	2,755,351	10,346,301	9,685,779

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사의 2015년 1분기 생산실적은 2,755,351백만원으로 집계되었으며, 동 기간 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제68기 1분기	제67기 연간	제66기 연간
반도체 부문	2,755,351	10,346,301	9,685,779

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
------	--------	--------	-------

반도체 부문	36,491,040	36,491,040	100
--------	------------	------------	-----

※가동률은 각 지역별 팹(Fab)의 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함.

다. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 15조 1,478억원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2015.01.01								
취득원가	542,952	2,020,429	621,345	34,956,922	3,037	772,844	1,602,357	40,519,885
감가상각누계액		△562,724	△319,991	△24,721,171	△2,174	△516,775		△26,122,833
손상차손누계액		△23,847	△19,163	△254,597		△1,646		△299,254
정보보조금		△317		△6,853		△294		△7,464
기초순장부금액	542,952	1,433,541	282,191	9,974,302	863	254,129	1,602,357	14,090,334
기중변동액								
취득			42	13,799		2,334	1,905,406	1,921,581
처분	△4	△57		△2,931		△40	△1,873	△4,905
손상차손						△2		△2
감가상각		△14,823	△5,905	△837,306	△99	△22,030		△880,164
대체	23,908	△5,243	5,949	935,379	568	45,578	△1,007,074	△935
환율변동 등	60	1,725	1,488	18,121		△61	593	21,926
기말순장부금액	566,916	1,415,143	283,764	10,101,364	1,332	279,907	2,499,409	15,147,835
2015.03.31								
취득원가	566,916	2,017,341	629,965	35,780,490	3,474	792,063	2,499,409	42,289,659
감가상각누계액		△578,185	△327,038	△25,417,672	△2,143	△510,238		△26,835,275
손상차손누계액		△23,699	△19,164	△254,452		△1,648		△298,962
정보보조금		△315		△7,003		△270		△7,587
기말순장부금액	566,916	1,415,143	283,764	10,101,364	1,332	279,907	2,499,409	15,147,835

라. 투자계획

2015년 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액 (제68기 누적)	비 고
보완투자 등	기계장치 외	생산능력증가	2015.01.01~ 2015.03.31	1,951	-
합 계				1,951	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제68기 1분기	제67기	제66기
반도체 부문	제품 외	DRAM, 낸드플래시, MCP 등	4,818,341	17,125,566	14,165,102
합 계			4,818,341	17,125,566	14,165,102

※ 매출실적은 연결기준입니다.

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

국내에서는 마케팅부문 내 AP영업팀 관할 하에 대리점 8개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국 등에 10개 법인이 소재하고 있으며 산하에 18개의 사무소 및 9개 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 거래하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 조건 등으로 거래하고 있습니다.

(4) 판매전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝 유지' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 서버, 그래픽, 모바일, 컨수머 등 응용분야의 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다.

수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래시장 발굴을 추진하고 있습니다.

고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다.

지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

반도체는 IT 컨슈머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하며, 당사는 세계 유수의 Computing 관련 전자 업체와 모바일 디바이스 제조업체, 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등에 제품을 공급하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기 공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외 사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	4,541	5,017,357	3,894	4,303,129
EUR	2	2,425	118	141,040
JPY	9,542	87,807	39,052	359,383

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	71,423	(71,423)
EUR	(13,862)	13,862
JPY	(27,158)	27,158

(2) 가격위험

연결실체는 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 연결실체는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.

(3) 이자율 위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결실체는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결실체는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자 차이를 결제하게 됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감 전순이익은 4,002백만원 만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다.

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 위험관리의 일반적 전략

[위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있으며, 그주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 외환관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하고 있습니다.

[파생상품계약 운용]

현재 환위험 헤지 목적의 파생상품 운용은 없습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 운영하고 있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
- ② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
- ③ 외환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
- ④ 외환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
- ⑤ 외환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

다. 위험관리 관련 추진사항

당사는 영업상의 환율 변동 영향을 축소하기 위해 파생상품 거래를 체결하고 있습니다. 파생상품 거래를 매매목적의 거래로 분류하여 회계처리 하고 있으며, 발생한 손익은 기업회계기준에 따라 당기 손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

8. 파생상품 거래현황

연결실체는 이자율 스왑 등을 통하여 이자율위험 등을 관리하고 있습니다. 또한, 내재파생상품인 해외전환사채에 내재되어 있는 전환권옵션을 분리하여 공정가치로 평가하여 당기손익으로 인식하였습니다.

당분기말과 전기말 현재 기타금융부채로 계상되어 있는 파생금융부채의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
이자율스왑	-	30
비유동:		
이자율스왑	956	708
합 계	956	738

당분기와 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한평가손익 및 거래 손익은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	-	247	560	638

② 전분기

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	200	115	322	237
내재파생상품	15,627	-	-	-
합 계	15,827	115	322	237

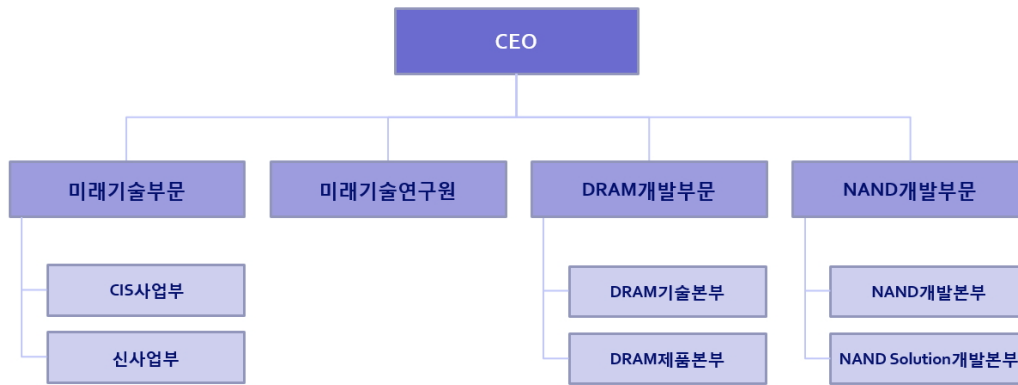
9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항목	내용	비고
삼성전자	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	
	계약 기간	2013년 6월 1일~	
	목적 및 내용	삼성전자가 보유하고있는 반도체 관련 모든 특허에 대한 사용권을 확보하여 향후 잠재적 분쟁 가능성 원천적 해소	
	기타 주요내용	-	
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	
	계약 기간	2013년 7월 1일~2018년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하	
실리콘화일	계약 유형	주식교환계약	
	계약 기간	2014년 1월 28일	계약 체결일
	목적 및 내용	주식의 포괄적 교환을 통해 실리콘화일을 완전자회사로 편입하여 CIS 사업의 경영 효율성 증대	
	기타 주요내용	주식교환일: 2014년 4월 22일 주식교환비율: 에스케이하이닉스 보통주 : 실리콘화일 보통주 =1 : 0.2232438	
Softeq Flash Solutions LLC	계약 유형	주식 인수	
	계약 기간	2014년 5월 15일	
	목적 및 내용	NAND Flash 개발 역량 향상을 위해 인수	
	기타 주요내용	-	
Violin Memory	계약 유형	자산 인수	
	계약 기간	2014년 5월 29일	
	목적 및 내용	NAND 솔루션 역량 강화를 위해, Violin사의 PCIe Card 부문 자산 및 인력을 인수	
	기타 주요내용	PCIe Card 관련 특허에 대한 Cross-License 체결	
Toshiba	계약 유형	공동 개발 계약	
	계약 기간	2015년 02월 05일	
	목적 및 내용	차세대 노광기술(Nano Imprint Lithography) 개발	
	기타 주요내용	-	

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 미래기술부문 및 미래기술연구원과 DRAM개발부문(DRAM기술본부, DRAM제품본부), NAND개발부문(NAND개발본부, NAND Solution개발본부)에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제68기 1분기	제67기	제66기	비 고
원 재 료 비		15,190	50,849	44,940	-
인 건 비		160,058	573,698	440,289	-
감 가 상 각 비		50,719	157,476	129,047	-
위 탁 용 역 비		51,726	153,570	101,378	-
기 타		148,808	488,147	428,824	-
연구개발비용 계		426,501	1,423,739	1,144,477	-
회계처리	판매비와 관리비	346,719	1,242,363	954,206	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	79,782	181,376	190,271	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		8.9%	8.3%	8.1%	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

구 분	연구과제명	기대효과
제68기	1) 2ynano급 6Gb LPDDR3	미세공정 전환을 통한 수익성 개선 제품으로 High-end Smartphone & Tablet 向 3GB LPDDR3 제품 개발을 통한 매출 확대에 기여할 것으로 예상
	2) 1xnano급 64Gb TLC	3 bit cell 기술을 기반으로 개발된 저가 시장 대응용 제품임, 우수한 원가 경쟁력을 바탕으로 USB, Card 시장부터 Mobile시장 까지 진입할 예정임

	3) 1x나노급 1st PCIe Client SSD	1x나노급 NAND를 채용한 PCIe 컨트롤러 탑재 1st Client SSD 제품으로 SATA에 이은 PCIe SSD 시장 진출 기반을 마련하였고, SSD 라인업이 보강되어 고객 확대에 기여할 것으로 예상됨.
	4) 1x나노급 2nd eMMC5.0	1x나노급 NAND를 채용한 eMMC 5.0 2nd 제품 개발 완료. 1st 제품 대비 Sequential Write(연속 쓰기)와 Sustain Performance를 개선하였으며, 차세대 eMMC5.1 기능 일부를 추가 반영하여 Mid-high 시장의 수익성 개선에 기여 할 것으로 예상됨.
	5) 2M, 1/5" (130nm, 1.75um, , Raw Sensor)	기존 2M SoC Sensor에서 Image Signal Processor를 제외한 Raw Sensor 제품으로서 보급형 스마트폰 시장의 Low Cost Solution 요구를 만족시킴으로서 2M SOC 시장을 대체해 갈 것으로 예상됨.

구 분	연구과제명	기대효과
제67기	1) 2x나노급 Enterprise향 SSD	자체 개발한 컨트롤러 및 펌웨어를 채용한 자사 최초 2x나노급 Enterprise향 SSD 제품으로, Power Loss Protection 기능을 탑재하여 순간적으로 전원이 차단되어도 모든 데이터를 안전하게 보호할 수 있으며, 어떠한 환경에서도 지속적인 성능 및 Latency를 유지하도록 하여 서버 시스템에 최적화 되어 있음. 향후 지속적인 성장이 예상되는 데이터 센터에 사용하는 솔루션으로 자사 SSD 사업 확대를 통한 매출 및 수익성 확보에 기여할 것으로 기대됨.
	2) 4G LPDDR2	모바일 2ynano 기술로 개발된 제품으로서 2x나노 Tech 모바일 DRAM이 사용되고 있는 시장의 Tech migration을 통한 Low cost 전략 제품임. 기존 대비 Net die 70% 증가로 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	3)5M 1/4" (90nm, 1.40um pixel, FSI)	중국 시장에서 판매되고 있는 기존 제품 대비 수익성 증대를 위해 Net die를 11% 증가시킨 제품으로 원가 절감을 통한 제품 경쟁력 향상으로 매출과 수익성 확대에 기여할 것으로 보임.
	4)5M 1/4" (90nm, 1.40um pixel, BSI)	중국 및 한국 시장의 중저가 스마트폰향으로 전면 및 후면카메라에 5M 제품의 채용이 확대되고 있어 중저가폰의 고화질 제품으로의 판매 확대가 예상됨
	5) 5M 1/5" (90nm, 1.12um pixel, BSI)	5M 제품의 픽셀 크기 축소되는 추세에 맞추어 이를 적용한 제품으로서 향후 매출과 수익성 확대에 기여할 것으로 예상됨.
	6) 1x나노급 Client SSD	자사 SSD 제품에 10나노급 NAND를 채용하여 기존 20나노급 SSD 제품 대비 원가 경쟁력을 확보함으로써 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
	7) 1.0M 1/6" (90nm, 1.75um Pixel, BSI)	Notebook향 기존 제품의 원가를 개선한 제품으로 90나노 BSI Tech을 적용하여 기존 제품 대비 감도를 향상하였고 생산 효율성을 개선함으로써 향후 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	8) 2ynm 4Gb DDR3(x16)	2014년 이후 4Gb 시장 수요 수익 창출을 위한 Embedded 향 제품 개발. 원가 경쟁력 확보하였으며 고객 Sample 조기 대응으로 Consumer, Graphics, Computing 등으로 응용처 확대가

		예상되어 매출과 수익성 확대에 기여할 것으로 예상됨.
9) 2ynm 4Gb GDDR5		DRAM 2ynano 기술을 적용한 Graphic 제품으로, 2014년 4분기 이후 Graphics 시장이 2Gb에서 4Gb로 전환되는 상황에서 생산 효율화를 통한 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
10) 2ynm 8Gb LPDDR4		Mobile 2ynano 기술로 개발된 차세대 Mobile DRAM 제품으로서 고사양 smartphone 및 tablet 시장의 12.8GB/s 이상 High bandwidth를 요구하는 제품에 채용 예정임. Mobile 외 Computing향 제품에 채용될 것으로 예상되는 제품으로 향후 매출 및 수익성 확보에 기여할 것으로 예상됨
11) 2xnm 2Gb HBM		TSV 기술 이용한 제품으로 Graphics에서 Post GDDR5 대체하는 신규 제품을 세계 최초로 개발 완료하였으며, 업계 최초 1.2V 동작 전압에서 초당 128GB 데이터 처리 가능한 고성능 제품임. 향후 HPC, Network 등 다양한 응용처로 확장되어 매출과 수익성 확대에 기여 할 것으로 보임.
12) 5M, 1/4" (90nm, 1.40um Pixel, SoC)		5M SoC 첫 제품으로서 보급형 스마트폰 시장을 목표로 개발된 제품으로 삼성 및 중국 시장에 진입 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.
13) 2ynm 6Gb LPDDR4		Mobile 2ynano 기술로 개발된 차세대 Mobile DRAM 제품으로 고사양 스마트폰 및 태블릿향 제품 중 3GB를 요구하는 제품에 채용될 것으로 예정으로 LPDDR4 초기 시장 진입에 기여할 것으로 예상됨
14) 2ynm 4Gb LPDDR3		미세공정전환을 통한 수익성 개선 제품으로 mid-end 급 SmartPhone 向 위주로 Buisiness 전개 예상 됨.
15) 2ynm 8Gb DDR4		8Gb Base로 개발된 DRAM 2ynm DDR4 제품으로 Premium Server 시장 선도를 위해 전략적으로 개발되었으며 TSV 및 3DS 패키징 기술력을 바탕으로 주요 고객사에 인증이 완료되었음.
16) 2ynm 4Gb DDR4		DRAM 2ynano 기술로 개발된 DDR4 제품으로 Intel Broadwell System 기반 DDR4 Server 수요 증가 및 고객 채용을 예상하며 15년 이후 DDR4 초기 시장을 선점하여 DRAM 매출 및 수익성 확보에 기여할것으로 예상됨.
17) 1xnm 64Gb MLC		기존 1x나노 제품의 원가경쟁력을 강화한 제품으로 Wafer 1장당 얻을 수 있는 Chip수를 개선하였음에도 불구하고 특성과 신뢰성이 개선하여 매출증대에 큰 기여를 할 것으로 예상됨
18) 1xnm 128Gb TLC		자사 최초의 TLC 제품으로 1x나노 기술을 기반으로 개발됨. 동일 Cell에 3bit를 저장하는 방식으로 기존의 2bit를 저장하던 MLC 대비 높은 Bit growth를 실현한 제품으로 원가경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.
19) 1xnm 2nd Client SSD		1x나노급 NAND를 채용한 자사 SATA Controller 탑재 SSD 제품으로 고용량 NAND를 채용하여 1T이상의 SSD 시장 대응이 가능하며, 주요 OEM 고객 인증으로 매출 및 수익성 확보에 기여 할 것으로 예상됨
20) 3D 1st 128Gb MLC		공정 미세화 한계 극복하고자 3차원 구조로 Cell 적층하는 기술 적용한 자사 첫 제품이며, 기존 2차원 구조 대비 높은 신뢰성과 특성을 가진 3D 시장진입의 교두보 확보할 수 있는 기술을 확

		보하였다는 의미가 있음.
구 분	연구과제명	기대효과
제66기	1) 4Gb GDDR5	GDDR5 제품중 20나노급 공정 기술을 적용한 첫 고용량 제품으로서 그래픽 시장의 프레임 버퍼(Frame Buffer) Size 증가 요구를 반영한 제품임. 저전력 고성능 구현으로 그래픽 시장을 리드할 것으로 기대되는 프리미엄 제품으로, 하이브리드 설계구조 적용으로 원가 경쟁력을 위한 와이어 본딩/8Gbps 솔루션으로 Flip Chip 동시 지원 가능.
	2) 32/64/128/256GB mSATA SSD	지난해 인수한 SKHMS와의 시너지를 통한 첫 자체 2y나노 SSD(mSATA) 제품으로 기존 2x나노 SSD 제품 대비 우수한 성능과 원가 경쟁력을 가지고 있음. OEM향 노트북, 태블릿 시장에서 다양한 고객 요구에 대응할 수 있는 제품을 확보함에 따라 매출과 수익성 확대에 크게 기여할 것으로 기대됨.
	3) 4/16/32/64GB e-NAND(eMMC4.5)	2y나노 eMMC4.5 제품으로 기존 2y나노 eMMC4.41 제품 대비 2배 이상 향상된 성능을 통해 Ci-MCP와 고용량 eMMC 제품의 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
	4) 2M 1/5"(130nm, 1.75um pixel, Hi-257)	중국 시장에서 저가형 스마트폰의 메인 카메라로 2M 제품 채용이 확대되고 있는 시점에서 Net Die를 기존 제품 대비 40% 증가시킨 제품으로서 당사의 시장점유율을 확고히 하는데 기여할 것으로 기대됨.
	5) 4Gb DDR4	20나노급 공정 기술을 적용한 세계 최초의 DDR4 양산 제품으로 인텔 하스웰(Haswell) 시스템 개발 초기부터 참여하여 PMO(Platform Memory Organization) 샘플 대응을 통해 시스템과 모듈간 Align을 진행. 자사 최초로 인텔 CDC(Columbia Design Center) PlugFest에 참석하여 Green Light 획득. DDR4 시장의 선도적 진입 및 리더십 확보를 위한 교두보를 마련하였음.
	6) 2Gb GDDR5	20나노급 공정 기술을 적용한 제품으로 기존 30나노급 대비생산성 향상에 기여. 기존 제품 대비 퍼포먼스(저전력 및 고속 동작 지원)가 향상되어 그래픽 메모리 시장을 선도하며, 2Gb 제품의 주력 생산이 될 제품. High-end PC향 그래픽 및 서버 등에도 채용을 추진중으로 신규 시장 창출이 기대됨.
	7) 2Gb SLC NAND	30나노급 기술을 적용한 4bit ECC 지원 제품으로 모바일향으로 개발되었으며, 기존 40nm급 대비 생산성이 29% 향상됨. 공정 미세화를 통한 수율과 품질을 확보하여 가격 경쟁력 확보 및 수익성 향상이 예상되며, 당사의 시장점유율을 높이는데 기여할 것으로 기대됨.
	8) 64Gb MLC NAND	세계 최초 1x나노 공정을 적용한 핵심제품으로서 기존 고용량 20nm 64Gb 제품 대비 생산성이 크게 향상되어 원가 경쟁력을 확보하였으며, 최근 크게 수요가 증가되고 있는 모바일향 eMMC 및 PPN, 스토리지향 SSD 등 솔루션 제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
	9) 64/128/256/512GB STD2.5" SSD, 64/128/256GB M.2 SSD	자체 개발한 컨트롤러를 채용한 2y나노 2.5인치 스탠다드SSD 및 M.2 SSD 제품으로 기존2y나노SSD 제품 대비 우수한 성능과 원가 경쟁력을 확보함으로써 향후 높은 성장성과수익성이

		예상되는 PC OEM 시장 집중 및 고객 다변화로 SSD 매출 및 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
10) 4Gb LPDDR3		모바일 2x나노 기술로 개발된 제품으로 모바일 기기의 High performance 요구와 울트라북의 Low Power 제품 채용에 따른 모바일 DRAM 매출 확대에 기여할 것으로 예상됨.
11) 1Gb/512Mb DDR2		4x나노에서 2x나노로 전환한 컨수머향 DDR2 제품으로 nVIDIA社 Automotive향 Biz 진입을 통해 지속적으로수익을 창출하는 제품으로 자리잡을 것으로 기대됨. 또한 Half Chip 설계 기술 적용으로 512Mb Density 시장에 대해서도 전략적 대응이 가능.
12) 8Gb LPDDR3		모바일 2y나노 기술로 세계 최초 개발된 8Gb LPDDR3 제품으로 최근 요구되고 있는 모바일 기기의 High Performance 와 저 전력 특성을 확보하였으며, 두께에 민감한 제품 수요에 대응할 수 있어 모바일 DRAM 매출 확대에 기여할 것으로 예상됨.
13) 16/32/64GB e-NAND(eMMC4.5)		1x나노 공정의 NAND 제품을 적용한 모바일 솔루션 제품으로 기존 2Ynm eMMC4.5 제품 대비 원가 경쟁력을 확보하였으며, Small PKG 고용량 제품 라인업 완성으로 자사 모바일 제품 경쟁력을 확보하여 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
14) 128,256GB M.2 2260 SSD		자사 2y나노 Tech NAND를 적용한 울트라북용 SSD 제품으로 차세대 Formfactor를 지원함으로써 신규 시장의 주요 OEM 고객 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.
15) 4Gb DDR3		Main Memory 2y나노급 세계 최소 Cell Size 제품 개발로 원가 경쟁력 확보하였으며 R/H Free 대응으로 품질 경쟁력 확보 및 고용량 제품에 대한 지속적인 수요 대응으로 PC 및 Server시장 매출 확대에 기여 할 것으로 예상.
16) 1G LPDDR2		Modem 통신 방식이 3G에서 LTE로 진화함에 따라 LPDDR1에서 LPDDR2 Migration이 발생하고, 이에 대한 SOC 업체의 SIP 대응을 위한 KGD 제품 개발로 매출 향상에 기여할 것으로 예상.
17)6G LPDDR3		PKG Height로 인해 8G LPDDR3로 대응이 불가능한 3GB Solution 대응을 위해 개발 추진. Time to Market을 위해 개발 기간 단축 달성 및 세계 최초 6Gb LPDDR3 개발. 자사의 개발 역량 표출 및 3GB Solution에서 시장선점과 매출 향상에 기여할 것으로 예상.
18) 64G MLC B-die		세계 최소의 1x나노 공정을 적용한 핵심제품으로써 기존 1x나노 64G MLC 대비 Net Die 개선을 통해 원가 경쟁력 향상에 기여하였으며, 이를 통해 최근 크게 수요가 증가되고 있는 Mobile향 eMMC 및 PPN과 Storage향 SSD 등 Solution제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
19) 128G MLC		세계 최소의 1x나노 공정이 적용된 자사 최초 128G High Density 제품임. SSD 적용 시 적층을 통해 1TB까지 지원이 가능하여 대용량 Storage 시장 공략을 위한 NAND Line Up을 구축.
20) 32G MLC		기존 2x나노 32G MLC 대비 세계 최소 1x나노 공정 적용을 통

		한 Net Die 개선으로 원가 경쟁력 향상을 이끌어내었으며, 이를 통하여 eMMC 및 CiMCP에 적용되어 제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
	21) 8/16/32GB e-NAND(eMMC5.0)	차세대 고성능 eMMC 인터페이스 규격을 지원하는 1x나노 eMMC5.0 제품 출시를 통해 eMMC 시장에서 원가 및 성능 경쟁력을 확보하였으며, 기존 OEM 고객 외에도 중국 등의 신규 고객 확보를 통한 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
	22) 32/64GB M.2 2242 SSD	2x나노 Tech NAND와 Amber Controller를 적용하여 만든 Cache 용 SSD 제품으로 인텔의 차세대 SSD 규격인 M.2 2242를 지원하고, 최근 Trend인 Dual Driver(SSD Cache+HDD Main Storage) Ultrabook 시장 진입을 통해 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.
	23) 2M 1/5"(130nm, 1.75um pixel)	2M MIPI I/F를 지원하는 Hi-256의 수익성을 개선한 제품으로 중국향 Low-cost 버전인 Hi-257을 기반으로 MIPI I/F를 추가하여 Net die를 Hi-256 대비 증가시켜 수익성 개선에 크게 기여함과 동시에 중국 시장의 MIPI I/F 채용 확대에 시장 점유율 확대에도 기여할 것으로 보임.
	24) 1.7M 1/6"(90nm, 1.75um pixel)	이미지 센싱 기능 외에 근접센서/조도센서/Motion detection/Face Recognition 등의 부가 기능을 one-chip화 함으로써 부가 가치를 창출하고 틈새 시장에 진출하여 매출에 기여할 것으로 기대됨.
	25) 8M 1/4"(90nm, 1.12um BSI pixel)	BSI 1.12um Pixel을 적용한 첫 제품으로 모바일폰에서 가장 많은 점유율과 성장률이 예상되는 8M 제품 개발을 완료함으로써 향후 CIS 매출에 많은 기여를 할 것으로 기대됨.

11. 기타 투자이사결정에 필요한 사항

가. 최근 3년간 신용등급

[국내]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등 급범위	평가구분
13.06.20	회사채(정기평가)	A+	한기평	AAA ~ D	정기평가
13.06.20	회사채(정기평가)	A+	한신평	AAA ~ D	정기평가
13.06.27	회사채(정기평가)	A+	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
13.06.20	기업어음(본평가)	A2+	한기평	A1~D	본평가
13.06.20	기업어음(본평가)	A2+	한신평	A1~D	본평가
13.06.27	기업어음(본평가)	A2+	NICE신평	A1~D	본평가
14.05.30	회사채(정기평가)	A+	한기평	AAA ~ D	정기평가
14.06.18	회사채(정기평가)	A+	한신평	AAA ~ D	정기평가
14.06.20	회사채(정기평가)	A+	NICE신평	AAA ~ D	정기평가

14.06.19	기업어음(본평가)	A1	한기평	A1~D	본평가
14.06.18	기업어음(본평가)	A1	한신평	A1~D	본평가
14.06.20	기업어음(본평가)	A1	NICE신평	A1~D	본평가
14.12.12	기업어음(정기평가)	A1	한기평	A1~D	본평가
14.12.18	기업어음(정기평가)	A1	한신평	A1~D	본평가
14.11.13	기업어음(정기평가)	A1	NICE신평	A1~D	본평가

[해외]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등 급범위	평가구분
13.02.22	발행회사	BB	S & P	AAA ~ D	수시평가
13.08.20	발행회사	Ba2	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
13.12.05	발행회사	BB+	S & P	AAA ~ D	수시평가
14.11.21	발행회사	BB+	S & P	AAA ~ D	수시평가
14.12.12	발행회사	Ba1	Moody's	Aaa ~ C	수시평가

※ 상기 S&P 및 Moody's의 본점 소재지는 미국임.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급	등급의 정의
------	--------

A1	적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B	적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D	상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급	등급의 정의
Aaa	최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.
Aa	신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.
A	중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.
Baa	신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.
Ba	투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.
B	투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.
Caa	신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.
Ca	투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.
C	채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급	등급의 정의
AAA	채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.
AA	채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.
A	채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BB	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨

B	현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.
CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.
CC	채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.
D	채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

나. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있습니다. 당사의 S/A 고객은 본 보고서 작성일 현재 총 15개사로 각 응용 분야별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

다. 지식재산권 보유현황

2015년 3월 31일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 12,886건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 지적재산권 개발, 출원/등록 및 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

라. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

'산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조'에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

마. 환경보호 정책 및 현황

(1) ESH경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO14001(환경경영시스템) 및 OHSAS18001(안전보건경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있으며, 이를 통해 ESH경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다.

ESH 경영시스템 내부 전문심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 환경안전보건 영향요인

을 모니터링 하고, 또한 이를 효율적으로 관리하기 위해 전담조직을 구성하여 체계적으로 관리하고 있습니다.

당사는 환경 및 안전보건 분야의 지속적인 개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나 갈 것입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[온실가스 에너지 목표관리제]

당사는 정부에서 시행하는 온실가스 에너지 목표관리제 관리업체로서 2011년부터 당사의온실가스 배출량을 측정, 검증하여 보고하고 있으며, 매년 온실가스 저감 목표를 수립하여 달성을 위해 노력하고 있습니다.

공정가스인 PFCs 배출 저감을 위해 대체가스 적용, PFCs 저감 장치 효율 관리를 위한 EPA 방법론 도입 및 운영, 공정 최적화, 촉매가스 활용 등 다양한 아이টে을 지속적으로 추진하고 있으며 에너지 절감 활동에서는 전사 Task Force 운영을 통해 저감 아이টে 발굴 및 이행, 저감 로드맵 수립, 운영현황 공유 등 체계적인 관리 하에 에너지 저감 활동을 강화하고 있습니다.

[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 5년 연속 선정, 명예의 전당 입성]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는탄소경영 최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초, 국내 유일 기업으로 명예의 전당에 입성하였습니다.

(3) 친환경제품을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/Eco-efficiency/탄소성적]

2013년 10월에는 환경부로 부터 20나노급 4G DDR3 제품에 대하여 반도체 업계 최초 환경성적표지 인증 획득했을 뿐 아니라 2014년에는 20나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대 하였습니다. 또한 회사는 2008년도부터 Eco-efficiency를 개발하여 각 제품별 환경성을 공개하고, 환경영향을 감소시키기 위한 지표로 활용하고 있습니다.

당사는 2013년 12월 20나노급 4G DDR3 제품에 대해 영국 로이드 인증원으로 부터 국내 최초 탄소라벨링 인증을 획득하였으며, 2014년 4월에 20나노급 4Gb LPDDR2 제품과 4Gb LPDDR3 제품에 대해 환경부로부터 저탄 소제품 인증을 획득하였습니다. 이는 2009년 탄소성적표지 최초 인증 이후 10 번째로 받은 인증으로 회사는 앞으로도 주요 DRAM 및 NAND Flash 제품에 대해 지속적으로 탄소성적표지 인증을 획득할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하고 그 결과를 환경경영검증위원회 보고서로 발행하였습니다.

2010년도 부터는 검증위원회에서 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하여 오고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략관련 의견을 수렴 후, 경영활동에 반영하고 있습니다. 2014년 11월, 건강한 일터를 만들어가기 위하여 외부 전문가와 노사대표로 구성된 SK 하이닉스 산업보건검증위원회를 구성하여 운영해 오고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제68기 1분기	제67기	제66기
[유동자산]	9,621,593	10,363,514	6,653,124
· 현금및현금성자산	342,269	436,761	631,867
· 단기금융상품	3,905,993	3,618,014	2,154,532
· 매출채권	3,260,778	3,732,926	1,941,675
· 재고자산	1,564,861	1,497,563	1,178,300
· 기타	547,692	1,078,250	746,750
[비유동자산]	17,771,320	16,519,764	14,144,174
· 관계기업 및 조인트벤처투자	105,545	97,090	107,097
· 매도가능금융자산	126,783	127,314	158,770
· 유형자산	15,147,835	14,090,334	12,129,797
· 무형자산	1,401,266	1,336,680	1,110,403
· 기타	989,891	868,346	638,107
자산총계	27,392,913	26,883,278	20,797,298
[유동부채]	5,161,878	5,765,304	3,078,239
[비유동부채]	3,105,299	3,081,671	4,652,200
부채총계	8,267,177	8,846,975	7,730,439
[지배기업 소유주지분]	19,126,225	18,036,453	13,067,243
· 자본금	3,657,652	3,657,652	3,568,645
· 자본잉여금	4,143,736	4,143,736	3,406,083
· 기타포괄손익누계액	△27,757	△41,815	△108,807
· 기타자본항목	△24	△24	-
· 이익잉여금	11,352,618	10,276,904	6,201,322
[비지배지분]	△489	△150	△384
자본총계	19,125,736	18,036,303	13,066,859
매출액	4,818,341	17,125,566	14,165,102
영업이익	1,588,530	5,109,466	3,379,785
연결총당기순이익	1,295,456	4,195,169	2,872,857
지배기업의 소유주지분	1,295,730	4,195,456	2,872,470
비지배지분	△274	△287	387
기본주당순이익	1,780 원	5,842 원	4,045 원

연결에 포함된 회사수	23개사	23개사	22개사
-------------	------	------	------

[△는 부(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제68기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2015년 3월 31일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2015년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

2. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 1분기	제67기	제66기
[유동자산]	8,339,267	8,641,074	5,798,909
· 현금및현금성자산	153,074	252,078	371,204
· 단기금융상품	3,301,855	3,172,173	2,115,581
· 매출채권	3,111,307	3,540,213	1,803,460
· 재고자산	1,269,733	1,217,282	920,590
· 기타	503,298	459,328	588,074
[비유동자산]	18,048,885	16,707,826	14,097,350
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	4,131,083	3,973,889	3,326,243
· 매도가능금융자산	126,074	126,605	158,374
· 유형자산	11,888,199	10,862,530	9,243,030
· 무형자산	1,018,533	971,316	819,009
· 기타	884,996	773,486	550,694
자산총계	26,388,152	25,348,900	19,896,259
[유동부채]	4,739,144	4,812,528	2,476,997
[비유동부채]	2,927,114	2,861,708	4,216,651
부채총계	7,666,258	7,674,236	6,693,648
[자본금]	3,657,652	3,657,652	3,568,645
[자본잉여금]	4,182,016	4,182,016	3,444,363
[기타포괄손익누계액]	-	-	7,824
[기타자본항목]	△24	△24	-
[이익잉여금]	10,882,251	9,835,020	6,181,779
자본총계	18,721,894	17,674,664	13,202,611
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	4,799,778	16,893,716	13,896,309
영업이익	1,571,545	5,047,353	3,215,116
당기순이익	1,267,247	3,771,761	2,796,967
기본주당순이익	1,741원	5,252원	3,938원

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제68기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2015년 3월 31일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2015년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 68 기 1분기말 2015.03.31 현재

제 67 기말 2014.12.31 현재

제 66 기말 2013.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 68 기 1분기말	제 67 기말	제 66 기말
자산			
유동자산	9,621,593	10,363,514	6,653,124
현금및현금성자산	342,269	436,761	631,867
단기금융상품	3,905,993	3,618,014	2,154,532
매출채권	3,260,778	3,732,926	1,941,675
기타수취채권	280,422	881,885	323,759
재고자산	1,564,861	1,497,563	1,178,300
당기법인세자산	1,524	1,629	9,242
매각예정자산	27,807	27,661	26,557
기타금융자산	0	0	245,808
기타유동자산	237,939	167,075	141,384
비유동자산	17,771,320	16,519,764	14,144,174
관계기업 및 공동기업투자	105,545	97,090	107,097
매도가능금융자산	126,783	127,314	158,770
기타수취채권	63,285	58,989	43,090
기타금융자산	323	323	2,017
유형자산	15,147,835	14,090,334	12,129,797
무형자산	1,401,266	1,336,680	1,110,403
투자부동산	28,126	28,456	28,609
이연법인세자산	279,923	272,102	198,570
기타비유동자산	618,234	508,476	365,821
자산총계	27,392,913	26,883,278	20,797,298
부채			
유동부채	5,161,878	5,765,304	3,078,239

매입채무	684,649	787,822	648,793
미지급금	1,919,395	1,358,816	788,304
기타지급채무	657,204	1,182,956	677,120
차입금	1,157,451	1,755,020	870,320
기타금융부채		30	2,194
유동총당부채	26,637	25,932	52,584
당기법인세부채	671,356	583,529	12,084
기타유동부채	45,186	71,199	26,840
비유동부채	3,105,299	3,081,671	4,652,200
기타지급채무	121,076	132,947	177,101
차입금	2,414,792	2,419,739	3,679,895
기타금융부채	956	708	107,094
확정급여부채	506,792	465,350	635,740
이연법인세부채	2,212	3,463	
기타비유동부채	59,471	59,464	52,370
부채총계	8,267,177	8,846,975	7,730,439
자본			
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,126,225	18,036,453	13,067,243
자본금	3,657,652	3,657,652	3,568,645
자본잉여금	4,143,736	4,143,736	3,406,083
기타자본	(24)	(24)	
기타포괄손익누계액	(27,757)	(41,815)	(108,807)
이익잉여금(결손금)	11,352,618	10,276,904	6,201,322
비지배지분	(489)	(150)	(384)
자본총계	19,125,736	18,036,303	13,066,859
자본과부채총계	27,392,913	26,883,278	20,797,298

연결 포괄손익계산서

제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 68 기 1분기		제 67 기 1분기		제 67 기	제 66 기
	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	4,818,341	4,818,341	3,742,690	3,742,690	17,125,566	14,165,102
매출원가	2,529,949	2,529,949	2,110,422	2,110,422	9,461,725	8,864,587
매출총이익	2,288,392	2,288,392	1,632,268	1,632,268	7,663,841	5,300,515

판매비와경상개발비	699,862	699,862	575,002	575,002	2,554,375	1,920,730
영업이익(손실)	1,588,530	1,588,530	1,057,266	1,057,266	5,109,466	3,379,785
금융수익	200,602	200,602	131,714	131,714	678,570	560,570
금융비용	179,122	179,122	156,457	156,457	799,771	747,329
지분법 손익	5,695	5,695	388	388	23,145	19,256
기타영업외수익	5,422	5,422	6,885	6,885	618,684	368,513
기타영업외비용	19,047	19,047	70,307	70,307	582,424	505,870
법인세비용차감전 순이익(손실)	1,602,080	1,602,080	969,489	969,489	5,047,670	3,074,925
법인세비용	(306,624)	(306,624)	(167,235)	(167,235)	852,501	202,068
당기순이익(손실)	1,295,456	1,295,456	802,254	802,254	4,195,169	2,872,857
기타포괄손익	12,377	12,377	(16,737)	(16,737)	(52,361)	22,125
확정급여제도의 재측정요소	(1,616)	(1,616)	(24)	(24)	(119,874)	15,587
매도가능금융자 산평가손익			3,418	3,418	(7,824)	(655)
해외사업환산손 익	13,426	13,426	(21,276)	(21,276)	71,631	8,419
관계기업의 기타 포괄손익에 대한 지분	567	567	1,145	1,145	3,706	(1,226)
총포괄손익 소계	1,307,833	1,307,833	785,517	785,517	4,142,808	2,894,982
당기순이익(손실))의 귀속						
지배기업의 소유 지분	1,295,730	1,295,730	802,538	802,538	4,195,456	2,872,470
비지배지분	(274)	(274)	(284)	(284)	(287)	387
총포괄손익의 귀속						
지배기업의 소유 지분	1,308,172	1,308,172	785,787	785,787	4,142,574	2,894,652
비지배지분	(339)	(339)	(270)	(270)	234	330
지배기업의 소유지 분에 대한 주당이 익						
기본주당이익 (원)	1,780	1,780	1,130	1,130	5,842	4,045
희석주당이익 (원)	1,780	1,780	1,104	1,104	5,842	4,045

연결 자본변동표

제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

			자본									
			지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배자본	자본 합계			
			자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금			지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
2013.01.01 (기초자본)			3,488,419	3,053,874		(115,402)	3,313,265	9,740,156	(714)	9,739,442		
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					2,872,470	2,872,470	387	2,872,857		
		매도가능금융자산평가 손익				(655)		(655)		(655)		
		확정급여제도의 재측정 요소					15,587	15,587		15,587		
		관계기업의 기타포괄손 익에 대한 자본				(1,226)		(1,226)		(1,226)		
		해외사업환산손익				8,476		8,476	(57)	8,419		
		총포괄손익				6,595	2,888,057	2,894,652	330	2,894,982		
	자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래	유상증자										
		배당금의 지급										
		중속기업 취득을 위한 신주교부										
		전환사채의 전환	80,226	352,209				432,435		432,435		
		자기주식 취득										
		주식선택권 행사										
		주식선택권 소멸										
		중속기업의 지분율변동 효과										
		연결범위의 변동										
		지배력을 상실하지 않 는 중속기업에 대한 지 배기업의 소유자본 변 동										
		기타의 변동										
		자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래 소계	80,226	352,209				432,435		432,435		
		2013.12.31 (기말자본)			3,568,645	3,406,083		(108,807)	6,201,322	13,067,243	(384)	13,066,859
		2014.01.01 (기초자본)			3,568,645	3,406,083		(108,807)	6,201,322	13,067,243	(384)	13,066,859
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					4,195,456	4,195,456	(287)	4,195,169		
		매도가능금융자산평가 손익				(7,824)		(7,824)		(7,824)		
		확정급여제도의 재측정 요소					(119,874)	(119,874)		(119,874)		
		관계기업의 기타포괄손 익에 대한 자본				3,706		3,706		3,706		
		해외사업환산손익				71,110		71,110	521	71,631		
		총포괄손익				66,992	4,075,582	4,142,574	234	4,142,808		
	자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래	유상증자										
		배당금의 지급										
		중속기업 취득을 위한 신주교부	6,793	47,277				54,070		54,070		
		전환사채의 전환	82,214	690,376				772,590		772,590		
		자기주식 취득			(24)			(24)		(24)		
		주식선택권 행사										
		주식선택권 소멸										
		중속기업의 지분율변동 효과										
		연결범위의 변동										

		지배력을 상실하지 않 는 종속기업에 대한 지 배기업의 소유지분 변 동									
		기타의 변동									
		자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래 소계	89,007	737,653	(24)			826,636		826,636	
2014.12.31 (기말자본)			3,657,652	4,143,736	(24)	(41,815)	10,276,904	18,036,453	(150)	18,036,303	
2014.01.01 (기초자본)			3,568,645	3,406,083		(108,807)	6,201,322	13,067,243	(384)	13,066,859	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					802,538	802,538	(284)	802,254	
		매도가능금융자산평가 손익				3,418		3,418		3,418	
		확정급여제도의 재측정 요소					(24)	(24)		(24)	
		관계기업의 기타포괄손 익에 대한 지분				1,145		1,145		1,145	
		해외사업환산손익				(21,290)		(21,290)	14	(21,276)	
		총포괄손익				(16,727)	802,514	785,787	(270)	785,517	
		자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래	유상증자								
	배당금의 지급										
	종속기업 취득을 위한 신주교부										
	전환사채의 전환										
	자기주식 취득										
	주식선택권 행사										
	주식선택권 소멸										
	종속기업의 지분율변동 효과										
	연결법위의 변동										
	지배력을 상실하지 않 는 종속기업에 대한 지 배기업의 소유지분 변 동										
	기타의 변동										
	자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래 소계										
	2014.03.31 (기말자본)			3,568,645	3,406,083		(125,534)	7,003,836	13,853,030	(654)	13,852,376
	2015.01.01 (기초자본)			3,657,652	4,143,736	(24)	(41,815)	10,276,904	18,036,453	(150)	18,036,303
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					1,295,730	1,295,730	(274)	1,295,456	
		매도가능금융자산평가 손익									
		확정급여제도의 재측정 요소					(1,615)	(1,615)		(1,615)	
		관계기업의 기타포괄손 익에 대한 지분				566		566		566	
		해외사업환산손익				13,492		13,492	(65)	13,427	
		총포괄손익				14,058	1,294,115	1,308,173	(339)	1,307,834	
		자본에 직접 반영된 소유 주와의 거래	유상증자								
	배당금의 지급						(218,401)	(218,401)		(218,401)	
	종속기업 취득을 위한 신주교부										
	전환사채의 전환										
	자기주식 취득										
	주식선택권 행사										
	주식선택권 소멸										
	종속기업의 지분율변동										

		효과								
		연결범위의 변동								
		지배력을 상실하지 않 는 종속기업에 대한 지 배기업의 소유자분 변 동								
		기타의 변동								
		자본에적립반영된 소유 주와의 거래 소계								
		2015.03.31 (기말자본)		3,657,652	4,143,736	(24)	27,757	11,352,618	19,126,225	(489)

연결 현금흐름표

제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 68 기 1분기	제 67 기 1분기	제 67 기	제 66 기
영업활동현금흐름	2,537,650	1,210,525	5,866,691	6,372,056
영업으로부터 창 출된 현금흐름	2,766,600	1,228,284	6,305,229	6,521,553
이자수취	27,595	17,132	35,658	58,888
이자지급	(36,742)	(39,137)	(151,551)	(199,553)
배당금수취	995	4	17,134	17,414
법인세의환급(납 부)	(220,798)	4,242	(339,779)	(26,246)
투자활동현금흐름	(2,027,076)	(1,713,446)	(6,087,827)	(4,892,125)
단기금융상품의 감소	4,167,756	3,616,041	21,059,587	3,927,831
단기금융상품의 증가	(4,441,778)	(4,273,064)	(22,467,339)	(4,956,446)
기타수취채권의 감소	789	365	3,501	2,728
기타수취채권의 증가	(2,140)	(2,415)	(15,735)	(5,969)
매도가능금융자 산의 처분	531	768	28,602	331
매도가능금융자 산의 취득		(325)	(1,415)	(115,564)
기타금융자산의 감소		245,847	275,422	29,681

기타금융자산의 증가		(30,072)	(29,611)	(276,591)
파생상품거래로 인한 현금유입	560		2,371	3,656
파생상품거래로 인한 현금유출	(667)	(1,867)	(4,534)	(6,550)
유형자산의 처분	3,479	26,575	198,959	15,509
유형자산의 취득	(1,628,365)	(1,230,914)	(4,800,722)	(3,205,797)
무형자산의 처분	155		286	200
무형자산의 취득	(125,580)	(64,887)	(336,291)	(301,496)
투자부동산의 처 분				
정부보조금의 수 령	378	502	20,241	
관계기업투자의 취득	(2,194)			
종속기업과 기타 사업의 지배력 상 실에 따른 현금흐 름			(1,467)	
사업결합으로 인 한 현금유출			(19,682)	(3,648)
매각예정자산의 처분				
재무활동현금흐름	(607,329)	189,835	28,343	(1,499,989)
차입금의 증가	883,054	1,347,321	3,848,816	3,528,687
차입금의 상환	(1,490,383)	(1,157,486)	(3,820,449)	(5,028,676)
자기주식의 취득			(24)	
보통주의 발행				
지배력을 상실하 지 않는 종속기업 에 대한 소유지분 의 변동				
'배당금의 지급				
현금및현금성자산 에 대한 환율변동 효과	2,263	1,180	(2,313)	(6,462)
현금및현금성자산 의 순증가(감소)	(94,492)	(311,906)	(195,106)	(26,520)
기초현금및현금성 자산	436,761	631,867	631,867	658,387

기말현금및현금성 자산	342,269	319,961	436,761	631,867
-------------	---------	---------	---------	---------

3. 연결재무제표 주석

1. 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경춘대로 2091에 본사와서울특별시 강남구 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing)에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

한편, 2015년 3월 31일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤(주)	146,100,000	20.07
주식관리협의회(*):	7,432,667	1.02
(주)한국외환은행	7,092,500	0.97
(주)신한은행	335,000	0.05
기타	5,167	0.00
국민연금공단 및 기타주주	574,469,698	78.91
합 계	728,002,365	100.00

(*) SK텔레콤(주)가 주식관리협의회와 2011년 11월 14일에 체결한 에스케이하이닉스(주) 주식 매매계약에 의하여 주식관리협의회는 거래종결일(2012년 2월 14일) 이후 잔여 주식을 보유하는 동안 회사의 이사 및 감사의 선임에 관하여 SK텔레콤(주)의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

또한, 주식관리협의회는 동 주식에 대한 의결권을 행사함에 있어서 직접적인 이해관계가 없는 안건에 대하여 합리적으로 거부할 만한 사유가 없는 한 SK텔레콤(주)의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

따라서 SK텔레콤(주)는 당분기말 현재 주식관리협의회가 보유하고 있는 주식에 대하여 의결권을 실질적으로 행사할 수 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	주요영업활동	결산월	소유지분율(%)	
				당분기말	전기말
에스케이하이이엔지(주)	국 내	사업지원 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이시스템(주)	국 내	사업지원 및 공사 등	12월	100	100
(주)실리콘화일	국 내	전자·전기부품 개발 및 제조	12월	100	100
SK hynix America Inc.(SKHYA)	미 국	해외판매법인	12월	97.74	97.74
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA)(*1)	미 국	해외제조법인(영업중단)	12월	100	100
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	독 일	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	영 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	싱가포르	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)(*2)	인 도	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	홍 콩	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SKHYCS)	중 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	일 본	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	대 만	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	중 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Italy S.r.l.(SKHYIT)	이탈리아	해외연구개발법인	12월	100	100
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	미 국	해외연구개발법인	12월	100	100
SK hynix Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	대 만	해외연구개발법인	12월	100	100
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	홍 콩	지주회사	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)(*3)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	벨라루스	해외연구개발법인	12월	100	100
MMT(특정금전신탁)	국 내	특정금전신탁	12월	100	100

(*1) 종속기업인 SK hynix America Inc.(SKHYA)의 종속기업입니다.

(*2) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)의 종속기업입니다.

(*3) 종속기업인 SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)의 종속기업입니다.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동내역은 없습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기말			전기말		
	총자산	총부채	총자본	총자산	총부채	총자본
SK hynix America Inc.(SKHYA)	1,497,191	1,431,432	65,759	1,711,746	1,634,047	77,699
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	449,621	376,410	73,211	386,135	313,152	72,983
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	454,923	367,141	87,782	563,598	478,449	85,149
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	331,916	274,677	57,239	285,122	227,860	57,262
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	436,897	412,437	24,460	628,791	605,861	22,930
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	3,904,446	854,443	3,050,003	4,179,186	1,197,588	2,981,598
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	115,218	81,289	33,929	135,384	98,477	36,907
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	208,890	193,997	14,893	194,318	179,990	14,328
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)	356,383	182,683	173,700	341,984	174,936	167,048

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기			전분기		
	매출액	당기순손익	총포괄손익	매출액	당기순손익	총포괄손익
SK hynix America Inc.(SKHYA)	2,003,272	(8,371)	(8,371)	1,335,987	(10,445)	(10,445)
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	500,740	(155)	(155)	438,392	(2,076)	(2,076)
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	863,272	2,149	2,149	718,210	549	549
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	241,383	(30)	(30)	172,737	(268)	(268)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	523,805	1,093	1,093	459,988	3,022	3,022
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	509,418	48,354	48,354	464,660	(54,279)	(54,279)
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	135,088	912	912	166,266	(115)	(115)
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	187,393	488	488	131,100	(242)	(242)
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)	75,001	5,499	5,499	-	(2,322)	(2,322)

(6) 당분기말과 전기말 현재 연결실체에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2014년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

4. 영업부문

연결실체는 반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
제품의 판매	4,773,451	3,724,953
용역의 제공	44,890	17,737
합 계	4,818,341	3,742,690

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
DRAM	3,632,987	2,992,117
NAND Flash	1,044,841	623,133
기 타	140,513	127,440
합 계	4,818,341	3,742,690

(3) 당분기와 전분기 중 지역별(법인소재지 기준) 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
국 내	293,056	298,129
중 국	952,884	740,003
대 만	518,553	462,304
아시아(중국, 대만제외)	739,930	611,552
미 국	1,993,696	1,334,550
유 럽	320,222	296,152
합 계	4,818,341	3,742,690

(4) 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산(금융상품, 기타수취채권, 관계기업 및 공동기업투자, 이연법인세자산 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
국 내	13,510,336	12,356,735
중 국	3,326,872	3,255,550
대 만	5,788	5,831
아시아(중국, 대만제외)	750	798
미 국	340,799	333,908
유 럽	10,916	11,124
합 계	17,195,461	15,963,946

(5) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결실체 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객 "가"와 "나"로부터 발생한 매출액은 각각 874,758백만원(전분기: 500,922백만원)과 621,233백만원(전분기: 371,080백만원)입니다.

5. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	342,269	342,269
단기금융상품	2,477,506	-	1,428,487	3,905,993
매출채권	-	-	3,260,778	3,260,778
기타수취채권	-	-	343,707	343,707
기타금융자산	-	-	323	323
매도가능금융자산	-	126,783	-	126,783
합 계	2,477,506	126,783	5,375,564	7,979,853

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	436,761	436,761
단기금융상품	1,842,020	-	1,775,994	3,618,014
매출채권	-	-	3,732,926	3,732,926
기타수취채권	-	-	940,874	940,874
기타금융자산	-	-	323	323
매도가능금융자산	-	127,314	-	127,314
합 계	1,842,020	127,314	6,886,878	8,856,212

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	684,649	684,649
미지급금	-	1,919,395	1,919,395
기타지급채무(*)	-	778,280	778,280
차입금	-	3,572,243	3,572,243
기타금융부채	956	-	956
합 계	956	6,954,567	6,955,523

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	787,822	787,822
미지급금	-	1,358,816	1,358,816
기타지급채무(*)	-	1,315,903	1,315,903
차입금	-	4,174,759	4,174,759
기타금융부채	738	-	738
합 계	738	7,637,300	7,638,038

(*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	657,204	1,182,956
소 계	657,204	1,182,956
비유동:		
임대보증금	2,626	2,357
장기미지급금	118,450	130,566
장기미지급비용	-	24
소 계	121,076	132,947
합 계	778,280	1,315,903

6. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2014년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결실체의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	4,541	5,017,357	3,894	4,303,129
EUR	2	2,425	118	141,040
JPY	9,542	87,807	39,052	359,383

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전 순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	71,423	(71,423)
EUR	(13,862)	13,862
JPY	(27,158)	27,158

(나) 가격위험

연결실체는 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 연결실체는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격 위험에 노출되어 있지 않습니다.

(다) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결실체는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결실체는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의 차이를 결제하게 됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 4,002백만원 만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다.

② 신용위험

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리 업무를 수행하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

당분기 중 차입금의 차입 및 상환, 장기차입금의 유동성 대체를 제외하면 전기말 대비 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름의 중요한 변동은 없습니다.

(2) 자본관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	8,267,177	8,846,975
자 본 (B)	19,125,736	18,036,303
현금및현금성자산 등 (C)(*)	4,248,262	4,054,775
차입금 (D)	3,572,243	4,174,759
부채비율 (A/B)	43%	49%
순차입금비율 (D-C)/B	-4%	1%

(*) 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합계액입니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	2,477,506	-	2,477,506	-	2,477,506
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	342,269	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,428,487	-	-	-	-
매출채권(*1)	3,260,778	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	343,707	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	323	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	126,783	-	-	-	-
합 계	5,502,347	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	956	-	956	-	956
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	684,649	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,919,395	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	778,280	-	-	-	-
차입금	3,572,243	-	3,653,724	-	3,653,724
합 계	6,954,567	-	3,653,724	-	3,653,724

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	1,842,020	-	1,842,020	-	1,842,020
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	436,761	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,775,994	-	-	-	-
매출채권(*1)	3,732,926	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	940,874	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	323	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	127,314	-	-	-	-
합 계	7,014,192	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	738	-	738	-	738
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	787,822	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,358,816	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	1,315,903	-	-	-	-
차입금	4,174,759	-	4,243,974	-	4,243,974
합 계	7,637,300	-	4,243,974	-	4,243,974

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 동일한 상품(즉 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정하였습니다.

③ 가치평가기법

수준 2의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1과 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없습니다.

7. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
국책과제관련 사용제한	-	3
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	46,000	46,000
차입금 상환보증 예치금	22,013	21,655
소비세 이연납부에 대한 예치금	5,522	4,601
L/C개설 보증금	-	4,764
관세예치금	591	584
소 계	74,126	77,607
기타금융자산:		
직장보육시설자금 담보제공	308	308
당좌개설보증금	12	12
기 타	3	3
소 계	323	323
합 계	74,449	77,930

8. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	264,113	845,468
미수수익	9,786	28,337
단기대여금	3,694	3,504
단기보증금 및 예치금	2,829	4,576
소 계	280,422	881,885
비유동:		
장기미수금	24,156	22,880
장기대여금	6,440	7,199
보증금	32,372	28,585
장기성예치금	317	325
소 계	63,285	58,989
합 계	343,707	940,874

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	3,263,276	(2,498)	3,260,778	3,735,845	(2,919)	3,732,926
유동성 기타수취채권	281,851	(1,429)	280,422	883,553	(1,668)	881,885
비유동성 기타수취채권	69,362	(6,077)	63,285	65,023	(6,034)	58,989
합 계	3,614,489	(10,004)	3,604,485	4,684,421	(10,621)	4,673,800

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	환율변동	기 말
매출채권	2,919	-	(335)	-	(86)	2,498
유동성 기타수취채권	1,668	-	(238)	-	(1)	1,429
비유동성 기타수취채권	6,034	43	-	-	-	6,077
합 계	10,621	43	(573)	-	(87)	10,004

② 전분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	환율변동	기 말
매출채권	3,446	1,020	-	-	(34)	4,432
유동성 기타수취채권	2,062	11	-	(26)	-	2,047
비유동성 기타수취채권	12,510	18	-	-	34	12,562
합 계	18,018	1,049	-	(26)	-	19,041

9. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
제 품	501,737	(56,986)	444,751	441,393	(33,137)	408,256
재공품	784,030	(41,846)	742,184	795,844	(33,423)	762,421
원재료	196,147	(2,580)	193,567	189,936	(1,899)	188,037
저장품	121,115	(36)	121,079	102,738	(33)	102,705
미착품	63,280	-	63,280	36,180	(36)	36,144
합 계	1,666,309	(101,448)	1,564,861	1,566,091	(68,528)	1,497,563

10. 매각예정자산

당분기와 전분기 중 매각 목적으로 보유하고 있는 자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	27,661	26,557
환율변동효과	146	339
기말장부금액	27,807	26,896

11. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	5,866	4,501
선급비용	226,079	156,590
기 타	5,994	5,984
소 계	237,939	167,075
비유동:		
장기선급비용	606,273	494,908
기 타	11,961	13,568
소 계	618,234	508,476
합 계	856,173	675,551

12. 관계기업 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말			전기말	
				지분율(%)	순자산 지분금액	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(*)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.10	183	2,195	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	중 국	반도체 부품 제조	45.00	103,350	103,350	45.00	97,090
합 계					103,533	105,545		97,090

(*) 당분기 중 Stratio, Inc.의 우선주식 1,136,013주를 취득하였습니다. 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	지분법손익	지분법자본변동	배 당	기 말
Stratio, Inc.	-	2,194	-	1	-	2,195
HITECH	97,090	-	5,695	565	-	103,350
합 계	97,090	2,194	5,695	566	-	105,545

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	지분법손익	지분법자본변동	배 당	기 말
(주)실리콘화일	10,962	(465)	(143)	-	10,354
HITECH	96,135	853	1,288	-	98,276
합 계	107,097	388	1,145	-	108,630

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	2,100	47	1	135
HITECH	202,108	300,452	249,975	22,919

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
HITECH	251,443	306,344	289,990	52,042

(4) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
(주)실리콘화일(*)	-	-	31,958	(1,663)
Stratio, Inc.	-	-	-	-
HITECH	173,820	12,654	144,832	1,894
합 계	173,820	12,654	176,790	231

(*) (주)실리콘화일의 요약 포괄손익계산서는 종속기업으로 편입(2014년 4월 22일)되기 이전 시점까지의 내역입니다.

13. 매도가능금융자산

당분기와 전분기 중 매도가능금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	127,314	158,770
취득금액	-	325
처분금액	(531)	(549)
자본으로 분류된 기타포괄손익	-	3,506
기말장부금액	126,783	162,052

14. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	14,090,334	12,129,797
취득금액	1,921,581	1,584,026
처분금액	(4,905)	(28,200)
감가상각	(880,164)	(774,311)
손상차손	(2)	(25,397)
대 체(*)	(935)	1,389
환율변동 등	21,926	(32,689)
기말장부금액	15,147,835	12,854,615

(*) 당분기 중 무형자산으로 935백만원 대체되었으며, 전분기 중 투자부동산에서 1,389백만원 대체되었습니다.

(2) 당분기말 현재 연결실체의 일부 토지와 건물 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 32 참조)

(3) 금융리스와 운용리스 이용내역

당분기말 현재 연결실체는 ME Semiconductor Rental First L.L.C. 등으로부터 기계장치 등을 금융리스계약을 통하여 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 금융리스 계약에 따른 기계장치 등의 장부금액은 149,047백만원(전기말: 165,414백만원)입니다. 동 기계장치 등은 관련 금융리스부채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

15. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,336,680	1,110,403
취득금액	125,580	64,887
처분금액	(2,007)	(3,517)
상각액	(61,682)	(49,864)
손상차손	(56)	-
대 체(*)	935	-
환율변동 등	1,816	3,075
기말장부금액	1,401,266	1,124,984

(*) 당분기 중 유형자산에서 935백만원 대체되었습니다.

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 79,692백만원(전분기: 34,728만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 392,067백만원(전분기: 314,244백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

16. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	28,456	28,609
감가상각	(330)	(311)
대 체(*)	-	(1,389)
기말장부금액	28,126	26,909

(*) 전분기 중 유형자산으로 1,389백만원 대체되었습니다.

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 330백만원(전분기: 311백만원)은 전액 매출 원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 1,132백만원(전분기: 1,134백만원)입니다.

17. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	331,314	734,165
유동성장기차입금	826,137	820,855
유동성사채	-	200,000
소 계	1,157,451	1,755,020
비유동:		
장기차입금	1,256,987	1,262,772
사 채	1,157,805	1,156,967
소 계	2,414,792	2,419,739
합 계	3,572,243	4,174,759

(2) 당분기와 전분기 중 차입금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	4,174,759	4,550,215
신규차입	883,054	1,347,321
차입금상환	(1,490,383)	(1,157,486)
기 타(*)	4,813	24,128
기말장부금액	3,572,243	4,764,178

(*) 환율변동효과 및 현재가치할인차금 상각액 등이 포함되어 있습니다.

18. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	1,777	2,682
선수수익	288	322
예수금	41,162	67,174
보증예수금	1,059	858
배출부채	846	-
기 타	54	163
소 계	45,186	71,199
비유동:		
기타장기종업원급여부채	59,471	59,464
소 계	59,471	59,464
합 계	104,657	130,663

19. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
판매보증충당부채	6,886	215	(967)	-	6,134
반품충당부채	14,646	8,557	(7,100)	-	16,103
소송충당부채	4,400	-	-	-	4,400
합 계	25,932	8,772	(8,067)	-	26,637

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
판매보증충당부채	13,914	297	(5,181)	-	9,030
반품충당부채	12,564	6,132	(6,906)	-	11,790
소송충당부채	26,106	-	-	-	26,106
합 계	52,584	6,429	(12,087)	-	46,926

(2) 판매보증충당부채

연결실체는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있습니다.

(3) 반품충당부채

연결실체는 판매 후 반품이 예상되는 매출액을 합리적으로 추정하여 매출액과 매출원가에서 각각 차감하고 매출총이익에 해당하는 금액과 반품과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용의 합계액을 충당부채로 설정하고 있습니다.

(4) 소송충당부채

연결실체는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 계상하고 있습니다.

20. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	923,515	887,277
사외적립자산의 공정가치	(416,723)	(421,927)
합 계	506,792	465,350

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말
할인율	3.19% ~ 4.50%	3.19% ~ 4.50%
미래임금상승률	4.92% ~ 5.81%	4.92% ~ 5.81%

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	887,277	656,080
당기근무원가	33,557	26,285
이자원가	9,822	8,857
관계사전출입액	219	482
퇴직급여지급액	(7,322)	(7,742)
기 타	(38)	52
기말장부금액	923,515	684,014

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초잔액	421,927	20,340
이자수익	4,641	229
기여금납입액	15	-
관계사전출입액	41	-
퇴직급여지급액	(8,285)	(540)
재측정요소	(1,616)	(24)
분기말금액	416,723	20,005

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
당기근무원가	33,557	26,285
순이자원가	5,181	8,628
합 계	38,738	34,913

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	415,134	420,300
기 타	1,589	1,627
합 계	416,723	421,927

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 3,025백만원과 134백만원입니다.

21. 파생상품거래

(1) 연결실체는 이자율 스왑 등을 통하여 이자율위험 등을 관리하고 있습니다. 또한, 내재파생상품인 해외전환사채에 내재되어 있는 전환권옵션을 분리하여 공정가치로 평가하여 당기손익으로 인식하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채로 계상되어 있는 파생금융부채의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
이자율스왑	-	30
비유동:		
이자율스왑	956	708
합 계	956	738

(3) 당분기와 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	-	247	560	638

② 전분기

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	200	115	322	237
내재파생상품	15,627	-	-	-
합 계	15,827	115	322	237

22. 자본금 및 자본잉여금

(1) 당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금 및 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
전환권대가	42,928	42,928
기 타	475,011	475,011
합 계	4,143,736	4,143,736
기타자본		
취득금액	(24)	(24)
자기주식수	1	1

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 지배기업의 유통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천주)		
구 분	당분기	전기
기초	728,002	710,201
종속기업 취득을 위한 신주교부	-	1,358
전환사채의 전환	-	16,443
기말	728,002	728,002

23. 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
(부의)지분법자본변동	(4,065)	(4,631)
해외사업장환산외환차이	(23,692)	(37,184)
합 계	(27,757)	(41,815)

(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
(부의)지분법자본변동	(4,631)	566	(4,065)
해외사업장환산외환차이	(37,184)	13,492	(23,692)
합 계	(41,815)	14,058	(27,757)

② 전분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
매도가능금융자산평가손익	7,824	3,418	11,242
(부의)지분법자본변동	(8,337)	1,145	(7,192)
해외사업장환산외환차이	(108,294)	(21,290)	(129,584)
합 계	(108,807)	(16,727)	(125,534)

24. 이익잉여금

(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	30,694	8,854
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	11,086,418	10,032,544
합 계	11,352,618	10,276,904

(*1) 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2015년 3월 20일자 주주총회에서 배당금 218,401백만원이 결의되었으며, 당분기말 현재 미지급배당금은 미지급금에 포함되어 있습니다.

25. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급 여	99,591	78,174
퇴직급여	6,184	5,422
복리후생비	18,863	14,040
지급수수료	37,718	45,728
감가상각비	19,995	14,087
무형자산상각비	57,991	48,933
경상개발비	392,067	314,244
운반보관비	10,190	9,671
송무비	1,002	2,467
임차료	5,800	3,089
세금과공과	4,360	3,466
교육훈련비	7,235	3,206
판매촉진비	10,037	7,194
수도광열비	3,264	2,363
소모품비	13,503	6,513
수선비	1,559	4,581
기 타	10,503	11,824
합 계	699,862	575,002

26. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기(*2)
제품 및 재공품의 변동	(16,258)	(87,016)
원재료 및 소모품 사용	698,561	573,231
종업원급여	663,957	516,096
감가상각 및 무형자산상각	940,686	823,429
기술료	45,349	41,940
지급수수료	173,541	147,747
동력 및 수도광열비	167,371	154,392
수선비	253,092	212,774
외주가공비	264,603	235,084
기 타	38,909	67,747
합 계(*1)	3,229,811	2,685,424

(*1) 연결포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

(*2) 전분기의 비용은 당분기의 분류에 따라 재분류되었습니다.

27. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
금융수익:		
이자수익	8,964	16,273
배당금수익	995	4
당기손익인식금융자산처분이익	13,424	-
매도가능금융자산처분이익	-	220
외환차이	176,172	92,986
파생상품관련이익	560	16,149
당기손익인식금융자산평가이익	487	6,082
소 계	200,602	131,714
금융비용:		
이자비용	26,011	53,340
외환차이	152,226	102,765
파생상품관련손실	885	352
소 계	179,122	156,457
순금융수익(비용)	21,480	(24,743)

28. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분이익	-	457
기 타	5,422	6,428
합 계	5,422	6,885

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	85	2,081
무형자산처분손실	1,852	3,517
기부금	12,364	343
매출채권처분손실	318	782
유형자산손상차손	2	25,397
무형자산손상차손	56	-
기 타	4,370	38,187
합 계	19,047	70,307

29. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

30. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 주, 백만원)		
구 분	당분기	전분기
지배기업소유주지분 분기순이익	1,295,730	802,538
가중평균유통보통주식수(*)	728,001,795	710,200,891
기본주당이익	1,780 원	1,130 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
발행주식수	728,002,365	710,200,891
자기주식 효과	(570)	-
가중평균유통보통주식수	728,001,795	710,200,891

(2) 희석주당이익

당분기는 희석화 효과가 발생하지 아니하여 희석주당이익은 기본주당이익과 동일하며, 전분기 중 희석주당이익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)	
구 분	전분기
지배기업소유주지분 보통주분기순이익	802,538
전환사채 관련 손익	(570)
지배기업소유주지분 보통주희석분기순이익	801,968
가중평균희석유통보통주식수(*)	726,638,891
희석주당이익	1,104원

(*) 전분기 중 희석주당순이익 계산에 사용된 가중평균희석유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)	
구 분	전분기
가중평균유통보통주식수	710,200,891
전환사채 효과	16,438,000
가중평균희석유통보통주식수	726,638,891

31. 특수관계자 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업	Stratio, Inc.
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
기타특수관계자	연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	515	174,429	-
기타특수관계자	SK텔레콤(주)(*1)	5	46,561	253
	SK(주)(*2)	-	9,524	-
	에스케이건설(주)	62	54	387,008
	SK에너지(주)	1,339	18,614	-
	SK네트웍스(주)	-	716	-
	코원에너지서비스	-	1,018	-
	SKC솔믹스(주)	-	8,131	35
	충청에너지서비스(주)	-	10,989	-
	행복나래주식회사	7	15,066	408
	기 타	74	9,310	2,717
합 계		2,002	294,412	390,421

(*1) 영업비용 등에는 배당금 43,830백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 연결실체는 SK(주)와 2012년 3월부터 SK브랜드 사용을 위하여 매출액의 일정비율에 해당하는 금액을 사용료로 지급하기로 약정하였으며, 당분기 중 발생한 SK브랜드사용료는 7,193백만원(전분기: 5,221백만원)입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득
관계기업	실리콘화일	25,109	411	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	12,849	145,445	-
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	879	1,618	308
	SK(주)	-	5,221	-
	SK C&C(주)	70	5,879	12,225
	에스케이건설(주)	262	7,800	124,241
	SK에너지(주)	1,362	19,053	-
	SK네트웍스(주)	-	559	2,772
	코원에너지서비스	-	947	-
	SKC솔믹스(주)	-	6,607	326
	충청에너지서비스(주)	-	11,500	-
	행복나래주식회사	38	14,139	2,020
	기 타	73	4,348	439
합 계		40,642	223,527	142,331

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	채 권	채 무	
		매출채권 등	미지급금 등	차입금(*2)
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,098	135,297	8,778
기타특수관계자	SK텔레콤(주)(*1)	-	46,205	-
	SK(주)	-	2,343	-
	에스케이건설(주)	23	427,705	-
	SK에너지(주)	463	4,653	-
	SK네트웍스(주)	-	155	-
	코원에너지서비스	-	-	-
	SKC솔믹스(주)	-	8,361	-
	충청에너지서비스(주)	-	2,160	-
	행복나래주식회사	4	8,936	-
	기 타	26	24,283	-
합 계		1,614	660,098	8,778

(*1) 미지급금 등에는 미지급배당금 43,830백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 당분기 중 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.에 대한 담보부 차입금 13,774백만원이 상환되었습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	채 권	채 무	
		매출채권 등	미지급금 등	차입금
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	18,393	113,257	22,552
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	2,763	2,622	-
	SK(주)	-	3,080	-
	에스케이건설(주)	23	561,004	-
	SK에너지(주)	462	5,961	-
	SK네트웍스(주)	-	479	-
	SKC솔믹스(주)	-	9,258	-
	충청에너지서비스(주)	-	3,295	-
	행복나래주식회사	1	14,606	-
	기 타	32	14,455	-
합 계		21,674	728,017	22,552

(4) 주요 경영진에 대한 보상

연결실체의 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회 구성원, 재무책임자 및 내부감사 책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급 될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급 여	18,931	22,200
퇴직급여	1,716	1,399
기 타	4	5
합 계	20,651	23,604

32. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① SanDisk Corporation의 영업비밀 침해 소송

2014년 3월 13일에 SanDisk Corporation은 지배기업과 종속기업인 SK hynix America Inc.와 SK hynix memory solutions Inc.를 상대로 SanDisk Corporation과 Toshiba Corporation이 공동 소유한 영업비밀을 침해했다는 소송을 미국 캘리포니아 산타클라라 지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 지역에서 제기된 SanDisk Corporation의 영업비밀침해 관련 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태입니다.한편, 지배기업은 2014년 11월 6일 소송을 캘리포니아 연방법원으로 이관을 요청하였으며, 지배기업의 이관요청에 대한 SanDisk의 이의신청이 있어 이에 대한 심리가 향후 예정되어 있습니다. 당분기말 현재 소송은 초기단계로서 최종결과를 예측할 수 없습니다.

② 통상임금 관련 소송

2014년 8월 1일 지배기업의 종업원 일부는 지배기업을 상대로 정기상여금, 고정시간외수당, 교대근무수당 등 각종 수당이 통상임금에 해당하므로 이를 반영하여 연장근로수당 등의 임금을 추가 지급할 것을 요청하는 통상임금 관련 소를 수원지방법원 여주지원에 제기하였습니다. 이와 관련하여 지배기업은 2014년 9월 5일 답변서를 제출하였고, 이후 수 차례에 걸쳐 변론이 진행되었으며 향후 추가변론이 예정되어 있습니다. 당분기말 현재 당사는 승소가능성이 높은 것으로 판단하여 충당부채를 인식하지 않았으나 이러한 우발상황의 최종결과는 예측할 수 없습니다.

③ 기타의 소송 및 특허 클레임 등

상기 소송 외에, 연결실체는 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며향후자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. 그러나 당분기말 현재 이러한 우발상황의 최종결과는 예측할 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

(2) 특허라이선스 계약

연결실체는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

연결실체는 2001년에 베올리아워터산업개발㈜ ("Veolia")와 2001년 3월부터 2013년3월까지 총 12년간 공업용수를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 2006년 12월에 2018년 3월까지의 연장계약을 체결하였으며 이후 공장 등 신설공사에 따른 수정계약을 체결한 바 있습니다. 동 계약에 의하면 연결실체는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH과 후공정서비스계약

연결실체는 2009년 중 HITECH과 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 HITECH은 지배기업 및 지배기업의 종속기업인 SKHYMC로부터 기계장치를매입하기로 계약하였으며, 설립 후 5년 동안 연결실체에 대한 후공정 서비스 제공을 위하여 동 매입 장비를 배타적으로 사용하기로 하였습니다. 이후 연결실체는 2011년중 HITECH과 기존 후공정 서비스 공급계약과 연계하여 모듈서비스 공급을 추가하는계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 연결실체는 HITECH에 일정액의 약정수익을보장하는 후공정서비스 가격을 지불하기로 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
토 지	25,202	1,241,565	신디케이트론, 담보부대출 및 시설자금대출, Revolving Credit Facility및 청주공장 지급보증 관련
건 물	118,718		
기계장치	679,350		
합 계	823,270	1,241,565	

(*) 상기 담보제공자산 이외에 연결실체의 금융리스자산은 해당 금융리스 계약에 의하여 관련 금융리스 부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	금융기관	약정사항	한도금액	
			통 화	금 액
지배기업	외환은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	265
		매입외환 등 수출금융약정	USD	350
		수입 · 수출 포괄한도약정	USD	1,390
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	중국농업은행 등	Usance 등 수입금융약정	RMB	1,700
			USD	1,235
SK hynix America Inc. (SKHYA)등 판매법인	씨티은행 등	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	USD	495
국내종속기업	외환은행	무역어음대출	KRW	5,000
		기타원화지급보증	KRW	2,000
		통화선도	USD	1

연결실체는 당분기말 현재 금융기관에 222,002백만원(전기말: 220,663백만원)에 상당하는 매출채권을 양도하였으며, 동 거래는 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. 대출약정 상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결실체가 금융기관에 해당금액을 지급할 의무를 가지고 있습니다.

(7) 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	27	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 867,895백만원(전기말: 348,802백만원)입니다.

33. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	1,295,456	802,254
조정항목:		
법인세비용	306,624	167,235
퇴직급여	38,738	34,913
감가상각비	880,164	774,311
투자부동산상각비	330	311
무형자산상각비	61,682	49,864
외화환산손실	46,997	43,412
유형자산손상차손	2	25,397
이자비용	26,011	53,340
외화환산이익	(51,535)	(17,427)
이자수익	(8,964)	(16,273)
파생상품관련손익	325	(15,797)
지분법손익	(5,695)	(388)
기 타	(11,357)	864
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	476,469	(322,342)
기타수취채권의 감소(증가)	580,064	82,508
재고자산의 감소(증가)	(63,545)	(85,586)
기타자산의 감소(증가)	(182,771)	(52,723)
매입채무의 증가(감소)	(109,443)	34,426
미지급금의 증가(감소)	(45,025)	(70,819)
기타지급채무의 증가(감소)	(433,257)	(266,412)
충당부채의 증가(감소)	(659)	(5,529)
기타부채의 증가(감소)	(31,241)	19,947
퇴직금의 지급	(2,770)	(7,202)
영업으로부터 창출된 현금	2,766,600	1,228,284

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산 취득관련 미지급금 증가	282,708	350,795

4. 재무제표

재무상태표

제 68 기 1분기말 2015.03.31 현재

제 67 기말 2014.12.31 현재

제 66 기말 2013.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 68 기 1분기말	제 67 기말	제 66 기말
자산			
유동자산	8,339,267	8,641,074	5,798,909
현금및현금성자산	153,074	252,078	371,204
단기금융상품	3,301,855	3,172,173	2,115,581
매출채권	3,111,307	3,540,213	1,803,460
기타수취채권	288,066	317,075	207,625
기타금융자산	0	0	245,808
재고자산	1,269,733	1,217,282	920,590
당기법인세자산		0	7,731
기타유동자산	215,232	142,253	126,910
매각예정자산			
비유동자산	18,048,885	16,707,826	14,097,350
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,131,083	3,973,889	3,326,243
매도가능금융자산	126,074	126,605	158,374
기타수취채권	50,245	48,601	46,361
기타금융자산	319	319	594
유형자산	11,888,199	10,862,530	9,243,030
무형자산	1,018,533	971,316	819,009
투자부동산	28,126	28,456	28,609
이연법인세자산	190,595	190,595	110,254
기타비유동자산	615,711	505,515	364,876

자산총계	26,388,152	25,348,900	19,896,259
부채			
유동부채	4,739,144	4,812,528	2,476,997
매입채무	1,013,234	910,521	661,059
미지급금	1,779,636	1,296,900	595,959
기타지급채무	569,939	1,042,160	598,456
차입금	705,586	956,049	547,836
기타금융부채	0	30	267
유동충당부채	33,286	33,328	62,387
당기법인세부채	598,780	512,247	
기타유동부채	38,683	61,293	11,033
비유동부채	2,927,114	2,861,708	4,216,651
기타지급채무	120,855	132,649	168,158
차입금	2,253,683	2,216,231	3,264,565
기타금융부채	956	708	107,094
퇴직급여부채	494,803	455,301	626,906
기타비유동부채	56,817	56,819	49,928
부채총계	7,666,258	7,674,236	6,693,648
자본			
자본금	3,657,652	3,657,652	3,568,645
자본잉여금	4,182,016	4,182,016	3,444,363
기타자본	(24)	(24)	
기타포괄손익누계액	0	0	7,824
이익잉여금(결손금)	10,882,250	9,835,020	6,181,779
자본총계	18,721,894	17,674,664	13,202,611
자본과부채총계	26,388,152	25,348,900	19,896,259

포괄손익계산서

제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 68 기 1분기		제 67 기 1분기		제 67 기	제 66 기
	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	4,799,778	4,799,778	3,716,317	3,716,317	16,893,716	13,896,309
매출원가	2,583,654	2,583,654	2,096,805	2,096,805	9,502,113	8,947,323
매출총이익	2,216,124	2,216,124	1,619,512	1,619,512	7,391,603	4,948,986
판매비와경상개발비	644,579	644,579	533,316	533,316	2,344,250	1,733,870

영업이익(손실)	1,571,545	1,571,545	1,086,196	1,086,196	5,047,353	3,215,116
금융수익	121,789	121,789	113,432	113,432	585,386	459,701
금융비용	111,807	111,807	120,801	120,801	685,897	669,239
기타영업외수익	8,764	8,764	6,116	6,116	34,311	36,604
기타영업외비용	17,078	17,078	40,701	40,701	440,041	47,240
법인세비용차감전 순이익(손실)	1,573,213	1,573,213	1,044,242	1,044,242	4,541,112	2,994,942
법인세비용	305,966	305,966	168,884	168,884	769,351	197,975
당기순이익(손실)	1,267,247	1,267,247	875,358	875,358	3,771,761	2,796,967
기타포괄손익	(1,616)	(1,616)	3,394	3,394	(126,344)	13,567
매도가능금융자 산평가손익	0	0	3,418	3,418	(7,824)	(655)
보험수리적손익	(1,616)	(1,616)	(24)	(24)	(118,520)	14,222
총포괄손익 소계	1,265,631	1,265,631	878,752	878,752	3,645,417	2,810,534
지배기업의 소유지 분에 대한 주당이 익						
기본주당이익 (원)	1,741	1,741	1,233	1,233	5,252	3,938
계속영업기본 주당이익(손실)	1,741	1,741	1,233	1,233	5,252	3,938
희석주당이익 (원)	1,741	1,741	1,204	1,204	5,252	3,938
계속영업희석 주당이익(손실)	1,741	1,741	1,204	1,204	5,252	3,938

자본변동표

제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

			자본				
			자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금
2013.01.01 (기초자본)			3,488,419	3,092,155	8,479		3,370,590
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					2,796,967
		보험수리적손익					14,222
		매도가능금융자산평가 손익			(655)		(655)
		총포괄손익			(655)		2,811,189
							2,810,534
	주식선택권의행사						
	주식선택권의소멸						
	전환사채의전환						
	종석기업 취득을 위한 신주교부						
	자가주식의 취득						

			배당금지금						
			유상증자						
2013.12.31 (기말자본)				3,568,645	3,444,363	7,824		6,181,779	13,202,611
2014.01.01 (기초자본)				3,568,645	3,444,363	7,824		6,181,779	13,202,611
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)						3,771,761	3,771,761
		보험수리적손익						(118,520)	(118,520)
		매도가능금융자산평가				(7,824)			(7,824)
		손익							
		총포괄손익				(7,824)		3,653,241	3,645,417
	주식선택권의행사								
	주식선택권의소멸								
	전환사채의전환		82,214	690,376					772,590
	종석기업 취득을 위한 신주교부		6,793	47,277					54,070
	자기주식의 취득						(24)		(24)
	배당금지금								
	유상증자								
2014.12.31 (기말자본)				3,657,652	4,182,016		(24)	9,835,020	17,674,664
2014.01.01 (기초자본)				3,568,645	3,444,363	7,824		6,181,779	13,202,611
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)						875,358	875,358
		보험수리적손익						(24)	(24)
		매도가능금융자산평가				3,418			3,418
		손익							
		총포괄손익				3,418		875,334	878,752
	주식선택권의행사								
	주식선택권의소멸								
	전환사채의전환								
	종석기업 취득을 위한 신주교부								
	자기주식의 취득								
	배당금지금								
	유상증자								
2014.03.31 (기말자본)				3,568,645	3,444,363	11,242		7,057,113	14,081,363
2015.01.01 (기초자본)				3,657,652	4,182,016		(24)	9,835,020	17,674,664
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)						1,267,247	1,267,247
		보험수리적손익						(1,616)	(1,616)
		매도가능금융자산평가							
		손익							
		총포괄손익						1,265,631	1,265,631
	주식선택권의행사								
	주식선택권의소멸								
	전환사채의전환								
	종석기업 취득을 위한 신주교부								
	자기주식의 취득								
	배당금지금							218,401	218,401
	유상증자								
2015.03.31 (기말자본)				3,657,652	4,182,016		(24)	10,882,250	18,721,894

현금흐름표

제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지

제 67 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 68 기 1분기	제 67 기 1분기	제 67 기	제 66 기
영업활동현금흐름	1,973,562	980,029	5,100,398	5,419,815
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,194,607	993,718	5,483,275	5,529,830
이자수취	26,715	15,961	32,310	54,812
이자지급	(29,322)	(34,474)	(131,431)	(185,524)
배당금수취	995		42,957	17,414
법인세납부(환급)	(219,433)	4,824	(326,713)	3,283
투자활동현금흐름	(1,859,699)	(1,368,316)	(5,003,769)	(4,006,387)
단기금융상품의 감소	3,735,950	3,576,101	20,908,645	3,789,918
단기금융상품의 증가	(3,855,000)	(4,240,396)	(21,930,573)	(4,830,838)
기타수취채권의 감소	509	358	2,440	15,944
기타수취채권의 증가	(2,063)	(2,225)	(13,552)	(5,685)
매도가능금융자산의 처분	531	768	28,600	331
매도가능금융자산의 취득		(325)	(1,101)	(115,565)
기타금융자산의 감소		245,808	275,422	29,670
기타금융자산의 증가		(29,611)	(29,612)	(275,478)
파생상품거래로 인한 현금유입	560		2,371	3,656
파생상품거래로 인한 현금 유출	(667)	(237)	(2,928)	(6,550)
유형자산의 처분	7,772	29,160	215,570	42,599
유형자산의 취득	(1,486,035)	(851,835)	(3,530,499)	(2,312,081)
무형자산의 처분	155		353	200
무형자산의 취득	(107,072)	(64,092)	(328,198)	(275,102)
투자부동산의 처분				
정부보조금수령	378	502	502	
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	362,477			2,179

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(515,000)	(32,292)	(601,209)	(69,585)
기타투자활동으로 인한 현금유출				
관계기업투자의 취득	(2,194)			
매각예정자산의 처분				
재무활동현금흐름	(212,867)	145,805	(215,748)	(1,519,971)
차입금의 증가	773,651	1,232,492	2,878,448	3,184,919
차입금의 상환	(986,518)	(1,086,687)	(3,094,172)	(4,704,890)
자기주식의 취득			(24)	
보통주의발행				
배당금의 지급				
지배력을 상실하지 않은 종속기업에 대한 소유지분의 변동				
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(7)	
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(99,004)	(242,482)	(119,126)	(106,543)
기초현금및현금성자산	252,078	371,204	371,204	477,747
기말현금및현금성자산	153,074	128,722	252,078	371,204

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "당사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 당사는 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 서울특별시 강남구 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

한편, 2015년 3월 31일 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤주	146,100,000	20.07
주식관리협의회(*):	7,432,667	1.02
(주)한국외환은행	7,092,500	0.97
(주)신한은행	335,000	0.05
기타	5,167	0.00
국민연금공단 및 기타주주	574,469,698	78.91
합 계	728,002,365	100.00

(*) SK텔레콤(주)가 주식관리협의회와 2011년 11월 14일에 체결한 에스케이하이닉스주식회사 주식매매계약에 의하여 주식관리협의회는 거래종결일(2012년 2월 14일) 이후 잔여 주식을 보유하는 동안 당사의 이사 및 감사의 선임에 관하여 SK텔레콤(주)의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

또한, 주식관리협의회는 동 주식에 대한 의결권을 행사함에 있어서 직접적인 이해관계가 없는 안건에 대하여 합리적으로 거부할 만한 사유가 없는 한 SK텔레콤(주)의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

따라서 SK텔레콤(주)는 당분기말 현재 주식관리협의회가 보유하고 있는 주식에 대하여 의결권을 실질적으로 행사할 수 있습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주식에는 직전 연차 보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 원가로 표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2014년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

당사는 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 구분 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	153,074	153,074
단기금융상품	1,960,855	-	1,341,000	3,301,855
매출채권	-	-	3,111,307	3,111,307
기타수취채권	-	-	338,311	338,311
기타금융자산	-	-	319	319
매도가능금융자산	-	126,074	-	126,074
합 계	1,960,855	126,074	4,944,011	7,030,940

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	252,078	252,078
단기금융상품	1,471,170	-	1,701,003	3,172,173
매출채권	-	-	3,540,213	3,540,213
기타수취채권	-	-	365,676	365,676
기타금융자산	-	-	319	319
매도가능금융자산	-	126,605	-	126,605
합 계	1,471,170	126,605	5,859,289	7,457,064

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 구분내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	1,013,234	1,013,234
미지급금	-	1,779,636	1,779,636
기타지급채무(*)	-	690,794	690,794
차입금	-	2,959,269	2,959,269
기타금융부채	956	-	956
합 계	956	6,442,933	6,443,889

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	910,521	910,521
미지급금	-	1,296,900	1,296,900
기타지급채무(*)	-	1,174,809	1,174,809
차입금	-	3,172,280	3,172,280
기타금융부채	738	-	738
합 계	738	6,554,510	6,555,248

(*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	569,939	1,042,160
소 계	569,939	1,042,160
비유동:		
임대보증금	2,998	2,740
장기미지급금	117,857	129,909
소 계	120,855	132,649
합 계	690,794	1,174,809

5. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2014년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기 말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 당사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	2,963	3,274,622	2,380	2,629,962
EUR	2	2,412	84	101,099
JPY	9,542	87,807	27,913	256,872

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	64,466	(64,466)
EUR	(9,869)	9,869
JPY	(16,907)	16,907

(나) 가격위험

당사는 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 당사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의가격위험에 노출되어 있지 않습니다.

(다) 이자율위험

당사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동 될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

당사는 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 당사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 당사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의 차이를 결제하게 됩니다.

당사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 3개월 간 당사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 2,588백만원만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

② 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 당사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성 위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

당분기 중 차입금의 차입 및 상환, 장기차입금의 유동성 대체를 제외하면 전기말 대비 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다.

(2) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	7,666,258	7,674,236
자 본 (B)	18,721,894	17,674,664
현금및현금성자산 등 (C)(*)	3,454,929	3,424,251
차입금 (D)	2,959,269	3,172,280
부채비율 (A/B)	41%	43%
순차입금비율 (D-C)/B	-3%	-1%

(*) 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합계액입니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	1,960,855	-	1,960,855	-	1,960,855
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	153,074	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,341,000	-	-	-	-
매출채권(*1)	3,111,307	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	338,311	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	319	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	126,074	-	-	-	-
합 계	5,070,085	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	956	-	956	-	956
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	1,013,234	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,779,636	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	690,794	-	-	-	-
차입금	2,959,269	-	3,040,751	-	3,040,751
합 계	6,442,933	-	3,040,751	-	3,040,751

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	1,471,170	-	1,471,170	-	1,471,170
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	252,078	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,701,003	-	-	-	-
매출채권(*1)	3,540,213	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	365,676	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	319	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	126,605	-	-	-	-
합 계	5,985,894	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	738	-	738	-	738
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	910,521	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,296,900	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	1,174,809	-	-	-	-
차입금	3,172,280	-	3,241,495	-	3,241,495
합 계	6,554,510	-	3,241,495	-	3,241,495

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 동일한 상품(즉, 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정하였습니다.

③ 가치평가기법

수준 2의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1과 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없습니다.

6. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
국책과제관련 사용제한	-	3
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	46,000	46,000
소 계	46,000	46,003
기타금융자산:		
직장보육시설자금 담보제공	308	308
당좌개설보증금	11	11
소 계	319	319
합 계	46,319	46,322

7. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	217,423	228,438
미수수익	9,623	27,914
단기대여금	61,020	60,723
소 계	288,066	317,075
비유동:		
장기미수금	24,156	24,067
장기대여금	1,190	1,627
보증금	24,899	22,907
소 계	50,245	48,601
합 계	338,311	365,676

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	3,112,974	(1,667)	3,111,307	3,541,948	(1,735)	3,540,213
유동성 기타수취채권	289,495	(1,429)	288,066	318,742	(1,667)	317,075
비유동성 기타수취채권	55,371	(5,126)	50,245	53,684	(5,083)	48,601
합 계	3,457,840	(8,222)	3,449,618	3,914,374	(8,485)	3,905,889

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	기 말
매출채권	1,735	-	(68)	-	1,667
유동성 기타수취채권	1,667	-	(238)	-	1,429
비유동성 기타수취채권	5,083	43	-	-	5,126
합 계	8,485	43	(306)	-	8,222

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	기 말
매출채권	2,449	426	-	-	2,875
유동성 기타수취채권	2,062	10	-	(26)	2,046
비유동성 기타수취채권	11,338	19	-	-	11,357
합 계	15,849	455	-	(26)	16,278

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
제품	458,330	(43,572)	414,758	410,049	(24,795)	385,254
재공품	623,973	(41,830)	582,143	635,024	(32,640)	602,384
원재료	149,312	(2,579)	146,733	136,763	(1,899)	134,864
저장품	73,292	-	73,292	61,870	-	61,870
미착품	52,807	-	52,807	32,946	(36)	32,910
합 계	1,357,714	(87,981)	1,269,733	1,276,652	(59,370)	1,217,282

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	1,907	1,902
선급비용	207,344	134,370
기 타	5,981	5,981
소 계	215,232	142,253
비유동:		
장기선급비용	603,750	492,059
기 타	11,961	13,456
소 계	615,711	505,515
합 계	830,943	647,768

10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
종속기업	4,036,281	3,881,281
관계기업 및 공동기업	94,802	92,608
합 계	4,131,083	3,973,889

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
			지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
에스케이하이엔지㈜	국 내	사업지원 및 서비스	100	7,521	100	7,521
에스케이하이텍㈜	국 내	사업지원 및 공사 등	100	6,760	100	6,760
㈜실리콘화일	국 내	전자·전기부품 개발 및 제조	100	62,208	100	62,208
SK hynix America Inc.(SKHYA)	미 국	해외판매법인	97.74	31	97.74	31
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA)(※1)	미 국	해외제조법인(영업중단)	0.05	-	0.05	-
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	독 일	해외판매법인	100	22,011	100	22,011
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	영 국	해외판매법인	100	1,775	100	1,775
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	싱가포르	해외판매법인	100	52,380	100	52,380
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)(※2)	인 도	해외판매법인	1.00	5	1.00	5
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	홍 콩	해외판매법인	100	32,623	100	32,623
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SKHYCS)	중 국	해외판매법인	100	4,032	100	4,032
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	일 본	해외판매법인	100	42,905	100	42,905
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	대 만	해외판매법인	100	37,562	100	37,562
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	중 국	해외제조법인	90.26	2,520,881	90.26	2,520,881
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	중 국	해외제조법인	100	238,271	100	238,271
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	중 국	해외판매법인	100	237	100	237
SK hynix Italy S.r.l.(SKHYIT)	이탈리아	해외연구개발법인	100	18	100	18
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	미 국	해외연구개발법인	100	311,283	100	311,283
SK hynix Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	대 만	해외연구개발법인	100	7,819	100	7,819
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	홍 콩	지주회사	100	158,380	100	158,380
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)(※3)	중 국	해외제조법인	-	-	-	-
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	벨라루스	해외연구개발법인	100	14,579	100	14,579
MMT(특정금전신탁)(※4)	국 내	특정금전신탁	100	515,000	100	360,000
합 계				4,036,281		3,881,281

(※1) 종속기업인 SK hynix America Inc.(SKHYA)의 종속기업입니다.

(※2) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)의 종속기업입니다.

(※3) 종속기업인 SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)의 종속기업입니다.

(※4) 당분기 중 MMT(특정금전신탁)을 전액 처분하고 신규 취득하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
				지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(*)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.10	2,194	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	중 국	반도체 부품 제조	45.00	92,608	45.00	92,608
합 계					94,802		92,608

(*) 당분기 중 Stratio, Inc.의 우선주식 1,136,013주를 취득하였습니다. 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

11. 매도가능금융자산

당분기와 전분기 중 매도가능금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	126,605	158,374
취득금액	-	325
처분금액	(531)	(548)
자본으로 분류된 기타포괄손익	-	3,506
기말장부금액	126,074	161,657

12. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	10,862,530	9,243,030
취득금액	1,678,475	1,226,477
처분금액	(5,021)	(31,204)
대체(*)	-	1,389
감가상각	(647,785)	(567,595)
손상차손	-	(25,397)
기말장부금액	11,888,199	9,846,700

(*) 전분기 중 투자부동산에서 1,389백만원 대체되었습니다.

(2) 당분기말 현재 당사의 일부 토지와 건물 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 30 참조)

(3) 금융리스와 운용리스 이용내역

당분기말 현재 당사는 ME Semiconductor Rental First L.L.C. 등으로부터 기계장치등을 금융리스계약을 통하여 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 금융리스 계약에 따른 기계장치 등의 장부금액은 150,641백만원(전기말: 169,313백만원)입니다. 동 기계장치 등은 금융리스부채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

당사는 보유중인 기계장치 중 일부에 대하여 에스케이하이이엔지(주) 등과 운용리스 계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 동 운용리스로 제공된 자산의 장부금액은 45,240백만원(전기말: 43,943백만원)입니다.

13. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	971,316	819,009
취득금액	107,072	64,092
처분금액	(2,007)	(3,517)
상각액	(57,794)	(48,798)
손상차손	(54)	-
기말장부금액	1,018,533	830,786

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 78,448백만원(전분기:34,728백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 398,178백만원(전분기:319,777백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

14. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	28,456	28,609
감가상각	(330)	(311)
대체(*)	-	(1,389)
기말장부금액	28,126	26,909

(*) 전분기 중 유형자산으로 1,389백만원 대체되었습니다.

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 330백만원(전분기:311백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 1,132백만원(전분기:1,134백만원)입니다.

15. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	221,017	241,913
유동성장기차입금	484,569	514,136
유동성사채	-	200,000
소 계	705,586	956,049
비유동:		
장기차입금	1,095,878	1,059,264
사채	1,157,805	1,156,967
소 계	2,253,683	2,216,231
합 계	2,959,269	3,172,280

(2) 당분기와 전분기 중 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	3,172,280	3,812,401
신규차입	773,651	1,232,492
차입금상환	(986,518)	(1,086,687)
기 타(*)	(144)	25,056
기말장부금액	2,959,269	3,983,262

(*) 환율변동효과 및 현재가치할인차금 상각액 등이 포함되어 있습니다.

16. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	156	273
선수수익	288	322
예수금	37,037	60,641
보증예수금	356	57
배출부채	846	-
소 계	38,683	61,293
비유동:		
기타장기종업원급여부채	56,817	56,819
소 계	56,817	56,819
합 계	95,500	118,112

17. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
계약손실충당부채	784	-	(784)	-	-
판매보증충당부채	6,739	242	(940)	-	6,041
반품충당부채	21,405	6,585	(5,145)	-	22,845
소송충당부채	4,400	-	-	-	4,400
합 계	33,328	6,827	(6,869)	-	33,286

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
계약손실충당부채	157	2,537	-	-	2,694
판매보증충당부채	13,914	297	(5,181)	-	9,030
반품충당부채	22,210	6,261	(6,906)	-	21,565
소송충당부채	26,106	-	-	-	26,106
합 계	62,387	9,095	(12,087)	-	59,395

(2) 계약손실충당부채

당사는 해외소재 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer반제품을 구매하고 있으며, 당분기말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매 후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실충당부채전입액으로하여 매출원가에 가산하고 충당부채의 과목으로 계상하고 있습니다.

(3) 판매보증충당부채

당사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

(4) 반품충당부채

당사는 판매 후 반품이 예상되는 매출액을 합리적으로 추정하여 매출액과 매출원가에서 각각 차감하고 매출총이익에 해당하는 금액과 반품과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용의 합계액을 충당부채로 설정하고 있습니다.

(5) 소송충당부채

당사는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 계상하고 있습니다.

18. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	892,209	857,390
사외적립자산의 공정가치	(397,406)	(402,089)
합 계	494,803	455,301

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
할인율	4.50%	4.50%
미래임금상승률	5.81%	5.81%

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	857,390	631,757
당기근무원가	32,224	25,101
이자원가	9,519	8,573
관계사전출입액	219	481
퇴직급여지급액	(7,143)	(7,556)
기말장부금액	892,209	658,356

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	402,089	4,851
이자수익	4,438	41
관계사전출입액	42	-
퇴직급여지급액	(7,547)	(388)
재측정요소	(1,616)	(24)
기말장부금액	397,406	4,480

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
당기근무원가	32,224	25,101
순이자원가	5,081	8,532
합 계	37,305	33,633

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	395,816	400,461
기 타	1,590	1,628
합 계	397,406	402,089

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 2,822백만원과 17백만원입니다.

19. 파생상품거래

(1) 당사는 이자율 스왑 등을 통하여 이자율위험 등을 관리하고 있습니다. 또한 내재파생상품인 해외전환사채에 내재되어 있는 전환권옵션을 분리하여 공정가치로 평가하여 당기손익으로 인식하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채로 계상되어 있는 파생금융부채의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
이자율스왑	-	30
비유동:		
이자율스왑	956	708
합 계	956	738

(3) 당분기와 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	-	247	560	638

② 전분기

(단위: 백만원)				
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
이자율스왑	200	115	-	237
내재파생상품	15,627	-	-	-
합 계	15,827	115	-	237

20. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 당사의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금 및 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
전환권대가	42,928	42,928
기 타	513,291	513,291
합 계	4,182,016	4,182,016
기타자본		
취득금액	(24)	(24)
자기주식수	1	1

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 당사의 유통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천주)		
구 분	당분기	전기
기초	728,002	710,201
종속기업 취득을 위한 신주교부	-	1,358
전환사채의 전환	-	16,443
기말	728,002	728,002

21. 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
매도가능금융자산평가손익	-	-

(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
매도가능금융자산평가손익	-	-	-

② 전분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
매도가능금융자산평가손익	7,824	3,418	11,242

22. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	30,694	8,854
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	10,616,050	9,590,660
합 계	10,882,250	9,835,020

(*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2015년 3월 20일자 주주총회에서 배당금 218,401백만원이 결의되었으며, 당분기말 현재 미지급배당금은 미지급금에 포함되어 있습니다.

23. 판매비와 관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급 여	73,587	58,890
퇴직급여	5,861	5,222
복리후생비	13,587	9,183
지급수수료	33,812	42,781
감가상각비	17,472	12,858
무형자산상각비	55,723	48,090
경상개발비	398,178	319,777
송무비	701	2,320
임차료	3,083	1,232
세금과공과	1,437	1,016
교육훈련비	6,886	2,971
광고선전비	7,280	1,237
수도광열비	2,488	1,787
운반보관비	7,839	7,427
소모품비	11,787	6,921
수선비	1,086	3,858
여비교통비	1,875	2,122
기 타	1,897	5,624
합 계	644,579	533,316

24. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품의 변동	(9,263)	(115,777)
원재료 및 소모품 사용	1,018,918	984,469
종업원급여	487,396	400,123
감가상각 및 무형자산상각	705,375	615,897
기술료	45,349	41,940
지급수수료	182,640	90,175
동력 및 수도광열비	154,513	122,993
수선비	179,206	177,123
외주가공비	328,141	240,693
기 타	135,958	72,485
합 계(*)	3,228,233	2,630,121

(*) 포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

25. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
금융수익 :		
이자수익	8,424	15,421
배당금수익	995	-
당기손익인식금융자산처분이익	5,060	-
매도가능금융자산처분이익	-	220
외환차이	101,177	75,882
파생상품관련이익	560	15,827
당기손익인식금융자산평가이익	5,573	6,082
소 계	121,789	113,432
금융비용 :		
이자비용	20,955	48,501
외환차이	89,967	71,948
파생상품관련손실	885	352
소 계	111,807	120,801
순금융수익(비용)	9,982	(7,369)

26. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분이익	2,815	580
종속기업및관계기업투자주식처분이익	2,477	-
기 타	3,472	5,536
합 계	8,764	6,116

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	64	2,624
무형자산처분손실	1,852	3,517
매출채권처분손실	107	111
기부금	12,360	322
무형자산손상차손	54	-
유형자산손상차손	-	25,397
기 타	2,641	8,730
합 계	17,078	40,701

27. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

28. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 백만원, 주)		
구 분	당분기	전분기
보통주분기순이익	1,267,247	875,358
가중평균유통보통주식수(*)	728,001,795	710,200,891
기본주당이익	1,741 원	1,233 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)		
구 분	당분기	전분기
발행주식수	728,002,365	710,200,891
자기주식 효과	(570)	-
가중평균유통보통주식수	728,001,795	710,200,891

(2) 희석주당이익

당분기는 희석화 효과가 발생하지 아니하여 희석주당이익은 기본주당이익과 동일하며, 전분기 중 희석주당이익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 주)	
구 분	전분기
보통주분기순이익	875,358
전환사채 관련 손익	(570)
보통주희석분기순이익	874,788
가중평균희석유통보통주식수(*)	726,638,891
희석주당이익	1,204 원

(*) 전분기 중 희석주당순이익 계산에 사용된 가중평균희석유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)	
구 분	전분기
가중평균유통보통주식수	710,200,891
전환사채 효과	16,438,000
가중평균희석유통보통주식수	726,638,891

29. 특수관계자 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
종속기업	SKHYA외 21개사(*)
관계기업	Stratio, Inc.
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
기타특수관계자	연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(*) 종속기업인 MMT(특정금융신탁)는 제외하였습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지배기업	비 고
에스케이하이이엔지(주)	당 사	국내종속기업
에스케이하이스텍(주)	당 사	국내종속기업
(주)실리콘화일	당 사	국내종속기업
SK hynix America Inc.(SKHYA)	당 사	해외판매법인
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc.(HSMA)	SKHYA	영업중단법인
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	당 사	해외판매법인
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	당 사	해외판매법인
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	당 사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)	SKHYS	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	당 사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SKHYCS)	당 사	해외판매법인
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	당 사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	당 사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	당 사	해외제조법인
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	당 사	해외제조법인
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	당 사	해외판매법인
SK hynix Italy S.r.l.(SKHYIT)	당 사	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	당 사	해외연구개발법인
SK hynix Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	당 사	해외연구개발법인
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	당 사	Holding company
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)	SKAPTECH	해외제조법인
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	당 사	해외연구개발법인

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득
종속기업	해외판매법인	4,528,108	91,563	133,715
	해외제조법인	3,499	564,180	88,188
	해외연구개발법인	35	37,408	-
	국내종속기업	22,617	62,567	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	515	175,808	-
기타특수관계자	SK텔레콤㈜(*1)	5	46,463	253
	SK㈜(*2)	-	9,389	-
	에스케이건설㈜	56	-	387,008
	SK에너지㈜	315	18,614	-
	SK네트웍스㈜	-	277	-
	솔믹스㈜	-	5,591	35
	충청에너지서비스㈜	-	10,989	-
	행복나래주식회사	3	10,333	352
	기 타	2	11,256	2,717
합 계		4,555,155	1,044,438	612,268

(*1) 영업비용 등에는 배당금 43,830백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 당사는 SK㈜와 2012년 3월부터 SK브랜드 사용을 위하여 매출액의 일정비율에 해당하는 금액을 사용료로 지급하기로 약정하였으며 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 7,058백만원(전분기: 5,079백만원)입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	자산취득
종속기업	해외판매법인	3,424,071	11,472	178,798
	해외제조법인	3,946	466,382	28,923
	해외연구개발법인	33	26,962	-
	국내종속기업	3,509	60,880	-
관계기업	(주)실리콘화일	15,268	411	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	90	145,445	-
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	879	1,551	308
	SK(주)	-	5,079	-
	SK C&C(주)	14	5,690	12,225
	에스케이건설(주)	56	7,800	124,241
	SK에너지(주)	332	19,053	-
	SK네트웍스(주)	-	307	2,772
	솔믹스(주)	-	4,119	222
	충청에너지서비스(주)	-	11,500	-
	행복나래주식회사	3	9,301	1,928
	기 타	1	3,812	439
합 계		3,448,202	779,764	349,856

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	채 권		채 무	
		매출채권 등	대여금	미지급금 등	차입금(*2)
종속기업	해외판매법인	2,868,929	49,725	172,159	-
	해외제조법인	54,984	-	473,563	-
	해외연구개발법인	427	11,050	644	-
	국내종속기업	14,795	-	40,687	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	515	-	135,297	8,778
기타특수관계자	SK텔레콤(주)(*1)	-	-	46,203	-
	SK(주)	-	-	2,343	-
	에스케이건설(주)	20	-	427,686	-
	SK에너지(주)	77	-	4,653	-
	SK네트웍스(주)	-	-	6	-
	SKC솔믹스(주)	-	-	7,054	-
	충청에너지서비스(주)	-	-	2,160	-
	행복나래주식회사	1	-	6,833	-
	기 타	1	-	22,628	-
합 계		2,939,749	60,775	1,341,916	8,778

(*1) 미지급금 등에는 미지급배당금 43,830백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 당분기 중 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.에 대한 담보부 차입금 13,774백만원이 상환되었습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	채 권		채 무	
		매출채권 등	대여금	미지급금 등	차입금
종속기업	해외판매법인	3,339,375	49,464	129,522	-
	해외제조법인	46,714	-	244,166	-
	해외연구개발법인	743	10,992	581	-
	국내종속기업	9,492	-	61,634	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	-	113,257	22,552
기타특수관계자	SK텔레콤㈜	2,763	-	2,561	-
	SK㈜	-	-	3,080	-
	에스케이건설㈜	20	-	558,594	-
	SK에너지㈜	74	-	5,961	-
	SK네트웍스㈜	-	-	332	-
	SKC솔믹스㈜	-	-	7,850	-
	충청에너지서비스㈜	-	-	3,295	-
	행복나래주식회사	1	-	12,208	-
	기 타	1	-	12,914	-
합 계		3,399,183	60,456	1,155,955	22,552

(5) 주요경영진에 대한 보상

당사의 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회 의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
급 여	15,860	19,632
퇴직급여	1,690	1,347
기 타	4	4
합 계	17,554	20,983

30. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① SanDisk Corporation의 영업비밀 침해 소송

2014년 3월 13일에 SanDisk Corporation은 당사와 당사의 종속기업인 SK hynix America Inc.와 SK hynix memory solutions Inc.를 상대로 SanDisk Corporation과 Toshiba Corporation이 공동 소유한 영업비밀을 침해했다는 소송을 미국 캘리포니아 산타클라라 지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 지역에서 제기된 SanDisk Corporation의 영업비밀침해 관련 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태입니다.한편, 당사는 2014년 11월 6일 소송을 캘리포니아 연방법원으로 이관을 요청하였으며, 당사의 이관요청에 대한 SanDisk의 이의신청이 있어 이에 대한 심리가 향후 예정되어 있습니다. 당분기말 현재 소송은 초기단계로서 최종결과를 예측할 수 없습니다.

② 통상임금 관련 소송

2014년 8월 1일 당사의 종업원 일부는 당사를 상대로 정기상여금, 고정시간외수당, 교대근무수당 등 각종 수당이 통상임금에 해당하므로 이를 반영하여 연장근로수당 등의 임금을 추가 지급할 것을 요청하는 통상임금 관련 소를 수원지방법원 여주지원에 제기하였습니다. 이와 관련하여 당사는 2014년 9월 5일 답변서를 제출하였고, 이후 수 차례에 걸쳐 변론이 진행되었으며 향후 추가변론이 예정되어 있습니다. 당분기말 현재 당사는 승소가능성이 높은 것으로 판단하여 충당부채를 인식하지 않았으나 이러한 우발상황의 최종결과는 예측할 수 없습니다.

③ 기타의 소송 및 특허 클레임 등

상기 소송 외에, 당사는 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. 그러나 당분기말 현재 이러한 우발상황의 최종결과는 예측할 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

(2) 특허라이선스 계약

당사는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

당사는 2001년에 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 2001년 3월부터 2013년3월까지 총 12년간 공업용수를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 2006년 12월에 2018년 3월까지의 연장계약을 체결하였으며 이후 공장 등 신설공사에 따른 수정계약을 체결한 바 있습니다. 동 계약에 의하면 당사는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH과 후공정서비스계약

당사는 2009년 중 HITECH과 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 HITECH은 당사 및 당사의 종속기업인 SKHYMC로부터 기계장치를 매입하기로 계약하였으며, 설립 후 5년 동안 당사에 대한 후공정 서비스 제공을 위하여 동 매입 장비를 배타적으로 사용하기로 하였습니다. 이후 당사는 2011년 중 HITECH과 기존 후공정 서비스 공급계약과 연계하여 모듈서비스 공급을 추가하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 당사는 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 후공정서비스 가격을 지불하기로 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
토 지	25,202	752,343	시설자금대출 관련 등
건 물	118,718		
기계장치	338,841		
합 계	482,761	752,343	

(*) 상기 담보제공자산 이외에 당사의 금융리스자산은 해당 금융리스 계약에 의하여 관련 금융리스 부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 백만USD)			
금융기관	약정사항	한도금액	
		통 화	금 액
외환은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	265
	매입외환 등 수출금융약정	USD	350
	수입.수출 포괄한도약정	USD	1,390

당사는 당분기말 현재 금융기관에 221,017백만원(전기말: 219,853백만원)에 상당하는 매출채권을 양도하였으며, 동 거래는 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. 대출약정 상 매출 거래처의 부도가 발생하는 경우, 당사가 금융기관에 해당금액을 지급할 의무를 부담고 있습니다.

(7) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	27	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 792,556백만원(전기말: 145,139백만원)입니다.

31. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	1,267,247	875,358
조정항목:		
법인세비용	305,966	168,884
이자비용	20,955	48,501
이자수익	(8,424)	(15,421)
유형자산상각비	647,785	567,595
투자부동산상각비	330	311
무형자산상각비	57,794	48,798
유형자산처분손실	64	2,624
무형자산처분손실	1,852	3,517
유형자산손상차손	-	25,397
무형자산손상차손	54	-
퇴직급여	37,305	33,633
외화환산손실	29,085	30,005
파생상품관련손익	325	(15,475)
유형자산처분이익	(2,815)	(580)
외화환산이익	(33,003)	(11,662)
종속기업및관계기업투자주식처분이익	(2,477)	-
당기손익인식금융상품처분이익	(5,060)	-
당기손익인식금융상품평가이익	(5,573)	(6,082)
매도가능금융자산처분이익	-	(220)
배당금수익	(995)	-
기 타	(154)	456
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	429,561	(396,087)
기타수취채권의 감소(증가)	11,473	(19,148)
재고자산의 감소(증가)	(52,452)	(103,787)
기타자산의 감소(증가)	(186,597)	(56,266)
매입채무의 증가(감소)	103,036	93,095
미지급금의 증가(감소)	(16,400)	(57,596)
기타지급채무의 증가(감소)	(379,466)	(232,190)
충당부채의 증가(감소)	(41)	(2,992)
기타부채의 증가(감소)	(22,177)	20,218
퇴직금의 지급	(2,591)	(7,168)

영업으로부터 창출된 현금	2,194,607	993,718
---------------	-----------	---------

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산 취득 관련 미지급금 증가	181,931	372,325

6. 기타 재무에 관한 사항

1. 부문별 연결재무정보

가. 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

나. 지역별 재무 정보

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 1분기	제67기	제66기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	293,056	1,179,949	1,105,083
지역간내부매출액	4,614,981	16,120,740	13,080,509
계	4,908,037	17,300,689	14,185,591
2. 영업이익	1,574,861	5,060,563	3,224,815
3. 자산	26,526,887	25,498,068	19,982,891
미주			
1. 매출액			
외부매출액	1,993,696	6,359,461	5,191,619
지역간내부매출액	39,843	104,264	65,448
계	2,033,539	6,463,726	5,257,067
2. 영업이익	(6,904)	25,114	9,422
3. 자산	1,600,659	1,820,729	1,029,940
중국			
1. 매출액			

외부매출액	952,884	3,825,747	3,038,355
지역간내부매출액	692,671	2,431,140	2,075,362
계	1,645,555	6,256,886	5,113,717
2. 영업이익	13,783	△18,260	127,727
3. 자산	5,270,287	5,589,650	4,399,934
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	1,258,484	4,637,721	3,751,737
지역간내부매출액	9,342	27,887	16,302
계	1,267,825	4,665,608	3,768,038
2. 영업이익	1,830	11,061	12,883
3. 자산	1,227,303	1,308,979	785,001
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	320,222	1,122,688	1,078,309
지역간내부매출액	5,847	18,452	20,676
계	326,069	1,141,139	1,098,985
2. 영업이익	1,540	5,191	6,043
3. 자산	331,614	336,274	180,951
합계			
1. 매출액			
외부매출액	4,818,341	17,125,565	14,165,102
지역간내부매출액	5,362,685	18,702,483	15,258,296
계	10,181,026	35,828,049	29,423,398
2. 영업이익			
연결조정	3,419	25,797	△1,105
계	1,588,530	5,109,466	3,379,785
3. 자산			
연결조정	△7,563,838	△7,670,422	△5,581,419
계	27,392,913	26,883,278	20,797,297

[△는 부(-)의 수치임]

2. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등

(단위: 백만 달러)

구분	장비그룹	매각금액	적용연도	회계처리	
				별도기준	연결기준
에스케이하이닉스(주)	PROBE TEST	15	2012	담보부차입	담보부차입
에스케이하이닉스(주)	MODULE	10	2011	담보부차입	
에스케이하이닉스(주)	PKG/PKT	177	2010	담보부차입	

SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	PROBE TEST	128	2009	금융리스	
계		330			

3. 대손충당금 설정현황

가. 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제68기 1분기	매출채권	3,263,276	2,498	0
	장·단기 대여금	10,135	0	0
	장·단기 미수금	294,478	6,209	2
	장·단기 미수수익	9,786	0	0
	장·단기 보증금	35,547	346	1
	장·단기 예치금	1,268	951	75
	합 계	3,614,489	10,004	0
제67기 연간	매출채권	3,735,845	2,919	0
	장·단기 대여금	10,710	6	0
	장·단기 미수금	874,772	6,424	1
	장·단기 미수수익	28,337	0	0
	장·단기 보증금	33,487	326	1
	장·단기 예치금	1,271	946	74
	합 계	4,684,422	10,621	0
제66기 연간	매출채권	1,945,121	3,446	0
	장·단기 대여금	9,329	6	0
	장·단기 미수금	341,621	13,054	4
	장·단기 미수수익	11,071	0	0
	장·단기 보증금	15,027	222	1
	장·단기 예치금	4,253	1,171	28
	장기성 외상매출금	119	119	100
	합 계	2,326,541	18,019	1

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 1분기	제67기	제66기
-----	----------	------	------

1. 기초 대손충당금 잔액합계	10,622	18,018	21,131
2. 순대손처리액(①－②±③)	－	12,473	430
① 대손처리액(상각채권액)	－	12,473	430
② 상각채권회수액	－	－	－
③ 기타증감액	－	－	－
3. 대손상각비 계상(환입)액	(617)	5,076	(2,682)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	10,004	10,621	18,019

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

－ 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분		설정 기준
매출채권	1)정상채권	－.과거 경험률을 바탕으로 설정
	2)장기채권	－.거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 －.담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 －.담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

* 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

라. 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	일반	3,262,215	－	－	－	3,262,215
	특수관계자	1,061	－	－	－	1,061
	계	3,263,276	－	－	－	3,263,276
구성비율		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

4. 재고자산 현황 등

가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제68기 1분기	제67기	제66기	비고
반도체	제품	444,750	408,256	345,872	－
	재공품	742,184	762,420	608,402	－
	원재료	193,568	188,037	141,625	－

	저장품	121,079	102,705	45,672	-
	미착품	63,280	36,144	36,729	-
	합 계	1,564,861	1,497,563	1,178,300	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]		5.7%	5.6%	5.7%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		6.6회	7.1회	6.6회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2015-01-01	삼정회계법인	
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			
원부자재			
제품	2014-01-01	삼일회계법인/ 삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2013-02-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2013-01-01	삼일회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-

5. 공정가치 평가방법 및 평가내역

가. 공정가치 측정 - 작성기준

연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치

서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

나. 회계정책

비파생 금융자산

연결실체는 비파생금융자산의 인식 및 측정을 위하여 당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산의 네가지 범주로 구분하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고 있습니다.

비파생금융자산은 최초인식시점에 공정가치로 측정하며, 당기손익인식금융자산이 아닌 경우 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시점에 공정가치에 가산하고 있습니다.

① 당기손익인식금융자산

단기매매금융자산이나 최초 인식시점에 당기손익인식금융자산으로 지정한 금융자산을 당기손익인식금융자산으로 분류하고 있습니다. 당기손익인식금융자산은 최초인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 취득과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기손익으로인식하고 있습니다.

② 매도가능금융자산

매도가능항목으로 지정되거나 당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 또는 대여금 및 수취채권으로 분류되지 않은 비파생금융자산을 매도가능금융자산으로 분류하고 있습니다. 최초인식후에는 공정가치로 측정하며 공정가치의 변동은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품 등은 원가로 측정하고 있습니다.

파생금융상품

파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 각각 아래와 같이 인식하고 있습니다.

① 내재파생상품

내재파생상품은 주계약의 경제적 특성 및 위험도와 밀접한 관련성이 없고 내재파생상품과 동일한 조건의 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하는 경우, 복합금융상품이 당기손익인식항목이 아니라면 내재파생상품을 주계약과 분리하여 별도로 회계처리하고 있습니다. 주계약과 분리한 내재파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로인식하고 있습니다.

② 기타 파생상품

위험회피수단으로 지정되어 위험회피에 효과적인 파생상품을 제외한 모든 파생상품은 공정가치로 측정하며, 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

비파생금융부채

연결실체는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고 있습니다.

① 당기손익인식금융부채

당기손익인식금융부채는 단기매매금융부채나 최초 인식시점에 당기손익인식금융부채로 지정한 금융부채를 포함하고 있습니다. 당기손익인식금융부채는 최초인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 발행과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

② 기타금융부채

당기손익인식금융부채로 분류되지 않은 비파생금융부채는 기타금융부채로 분류하고 있습니다. 기타금융부채는 최초 인식시 발행과 직접 관련되는 거래원가를 차감한 공정가치로 측정하고 있습니다. 후속적으로 기타금융부채는 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정되며, 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 인식합니다.

금융부채는 소멸한 경우 즉, 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 재무상태표에서 제거하고 있습니다.

다. 금융상품의 범주별 분류

당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	342,269	342,269
단기금융상품	2,477,506	-	1,428,487	3,905,993
매출채권	-	-	3,260,778	3,260,778
기타수취채권	-	-	343,707	343,707
기타금융자산	-	-	323	323
매도가능금융자산	-	126,783	-	126,783
합 계	2,477,506	126,783	5,375,564	7,979,853

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	436,761	436,761

단기금융상품	1,842,020	-	1,775,994	3,618,014
매출채권	-	-	3,732,926	3,732,926
기타수취채권	-	-	940,874	940,874
기타금융자산	-	-	323	323
매도가능금융자산	-	127,314	-	127,314
합 계	1,842,020	127,314	6,886,878	8,856,212

당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	684,649	684,649
미지급금	-	1,919,395	1,919,395
기타지급채무(*)	-	778,280	778,280
차입금	-	3,572,243	3,572,243
기타금융부채	956	-	956
합 계	956	6,954,567	6,955,523

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	787,822	787,822
미지급금	-	1,358,816	1,358,816
기타지급채무(*)	-	1,315,903	1,315,903
차입금	-	4,174,759	4,174,759
기타금융부채	738	-	738
합 계	738	7,637,300	7,638,038

라. 공정가치 평가내역

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	2,477,506	-	2,477,506	-	2,477,506
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					

현금및현금성자산(*1)	342,269	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,428,487	-	-	-	-
매출채권(*1)	3,260,778	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	343,707	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	323	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	126,783	-	-	-	-
합 계	5,502,347	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	956	-	956	-	956
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	684,649	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,919,395	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	778,280	-	-	-	-
차입금	3,572,243	-	3,653,724	-	3,653,724
합 계	6,954,567	-	3,653,724	-	3,653,724

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	1,842,020	-	1,842,020	-	1,842,020
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	436,761	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,775,994	-	-	-	-
매출채권(*1)	3,732,926	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	940,874	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	323	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	127,314	-	-	-	-
합 계	7,014,192	-	-	-	-
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	738	-	738	-	738
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	787,822	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,358,816	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	1,315,903	-	-	-	-
차입금	4,174,759	-	4,243,974	-	4,243,974
합 계	7,637,300	-	4,243,974	-	4,243,974

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 동일한 상품(즉 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정하였습니다.

③ 가치평가기법

수준 2의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1과 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없습니다.

6. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2011년 05월 06일	400,000	6.20	A- (NICE신평/한기평/한신평)	2016년 05월 06일	미상환	NH투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2012년 09월 04일	200,000	3.72	A (NICE신평/한기평/한신평)	2017년 09월 04일	미상환	신한금융투자
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2012년 05월 30일	450,000	5.35	A (NICE신평/한기평/한신평)	2019년 05월 30일	일부상환	삼성증권
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2012년 06월 20일	110,500	3M Libor +2.85%	A(S&P)	2017년 06월 20일	미상환	Shinhan Asia Limited
SK하이닉스(주)	기업어음 증권	사모	2012년 05월 25일	100,000	3.90	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2015년 05월 26일	미상환	동양증권
SK하이닉스(주)	기업어음 증권	사모	2012년 05월 25일	100,000	3.90	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2015년 05월 26일	미상환	한양증권
합 계	-	-	-	1,360,500	-	-	-	-	-

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 기준일의 환율을 적용하였습니다.

※ 상기 '권면총액'은 기준일 현재의 잔액기준임.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000
	합계	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000

다. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
------	--------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----	-------	-------

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	400,000	200,000	-	-	-	-	600,000
	사모	-	-	110,500	-	450,000	-	-	560,500
	합계	-	400,000	310,500	-	450,000	-	-	1,160,500

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[개별기준]

위 연결 기준과 동일함.

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

가. 연결 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제68기 1분기(당분기)	삼정회계법인	-	-
제67기(전기)	삼정회계법인	적정	-
제66기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

나. 당해 사업연도의 연결감사(검토)절차 요약

1. 감사(검토)절차의 개요

본인(감사인)은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업의 요약 분기연결재무제표를 검토 하였습니다. 동 요약 분기연결재무제표는 2015년 3월 31일 현재의 요약 분기연결재무상태표, 2015년과 2014년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약 분기연결포괄손익계산서, 요약 분기연결자본변동표 및 요약 분기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견

본인의 검토결과 상기 요약 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

본인은 2014년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라

감사하였고, 2015년 2월 17일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2014년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2. 감사일정

□ 당기 감사(검토): 2015. 4. 6 ~ 4. 17

2. 회계감사인의 감사의견 등

가. 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제68기 1분기(당분기)	삼정회계법인	-	-
제67기(전기)	삼정회계법인	적정	-
제66기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

나. 당해 사업연도의 감사(검토) 절차 요약

1. 감사(검토)절차의 개요

본인(감사인)은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사의 요약 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 분기재무제표는 2015년 3월 31일 현재의 요약 재무상태표, 2015년과 2014년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약 포괄손익계산서와 요약 자본변동표 및 요약 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약 분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 분기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견

본인의 검토결과 상기 요약 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

본인은 2014년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2015년 2월 17일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2014년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2. 감사(검토)일정

□ 당기 감사(검토): 2015. 4. 6 ~ 4. 17

다. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제68기(당기)	삼정회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도) - 재무제표감사 (연결, 별도)	695	1,400
제67기(전기)	삼정회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도) - 재무제표감사 (연결, 별도)	685	10,307
제66기(전전기)	삼일회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도) - 재무제표감사 (연결, 별도)	695	11,530

※ 위 보수는 해당 사업연도의 보수 계약 금액이며, 당기의 총소요시간은 보고일까지의 누적 소요시간입니다.

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제68기(당기)	2015년 03월 31일	이전가격 관련 용역	2015.03~2016.03	60	-
제67기(전기)	2014년 03월 29일	이전가격 및 인수 자문	2014.03~2015.03	75	-
제66기(전전기)	2013년 09월 16일	계약이행 감사 자문	2013.09~12	60	-

3. 회계감사인의 변경

가. 변경 사유

당사는 2012년 2월 SK그룹에 편입되어 당사의 지분을 보유하고 있는 SKT의 지분법주식 평가 대상

법인이 되었습니다.

개정된 한국회계감사기준에 따라 그룹감사인의 역할이 확대된 만큼 감사 효율성 제고를 위하여 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제4조3의 규정에 따라 2014 회계연도부터 2016 회계연도까지 당사의 외부감사인을 SKT의 외부감사인인 삼정회계법인으로 선정하였습니다.

나. 감사위원회 의결사항

2014년 2월 24일에 개최된 감사위원회에서 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조(감사인의 선임), 제4조의2(주권상장법인의 감사인 선임 등), 회사 감사위원회 규정 제14조의2(외부감사인의 선임)에 의거, '제3호 의안: 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 이에 감사위원회 감사위원 3인(김두경, 김대일, 이창양)의 만장일치로 원안대로 가결되었습니다.

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성지침에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 5인의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회의 2개의 소위원회가 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

1. 상법상의 결의사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (7) 신주의 발행
- (8) 사채의 모집
- (9) 준비금의 자본전입
- (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
- (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
- (15) 소규모 주식교환
- (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
- (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
- (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- (19) 지배인의 선임 및 해임

2. 회사 경영에 관한 중요사항

- (1) 주주총회에 부의할 의안
- (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- (3) 회사의 예산·결산
- (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신규투자 계획, 차입(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)

(5) <삭제 2012.3.5>

(6) 해외증권의 발행

(7) <삭제 1999.4.9>

(8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지

(9) <삭제 2012.3.5>

(10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위

단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황

[제68기(2015), 2015년 3월 20일 정기주주총회 선임 이후]

(성명, 학력 및 경력, 최대주주등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 등)

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고
김두경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발관국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	-	2015. 3. 20 재선임
박영준	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기·정보공학부 교수(現)	해당사항 없음	-	2015. 3. 20 재선임
김대일	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-	2015. 3. 20 재선임
이창양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산업자원부 산업정책과장 KAIST 경영대학 교수(現)	해당사항 없음	-	2015. 3. 20 재선임

최종원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 행정고시 26회 공정거래위원회 정책평가위원 서울대 행정대학원장 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음	-	-
-----	--	---------	---	---

* 2015년 3월 20일 주주총회를 통해 김두경, 박영준, 김대일, 이창양 사외이사가 재선임 되었습니다.

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 이사회사무국 (담당자 :유선우 수석 ☎ 02-3459-5427)

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함	
개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 이내에 개최함
	임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함
소집권자	이사회 의장	
소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.	
결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름	
부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항	
위 임	다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항 - 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.	
의 사 록	이사회 의사에 관하여 의사록을 작성함 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하 고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)	

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석					
				김두경 (출석률: 100%)	박영준 (출석률: :75%)	윤세리 (출석률: 100%)	김대일 (출석률: 100%)	이창양 (출석률: 100%)	최종원 (출석률: 100%)
1	'15.01.28	1. 제67기(2014년) 재무제표(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제67기(2014년) 영업보고서(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
2	'15.02.25	1. 제67기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	'15.03.23	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

		3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
4	'15.04.22	1. 준법지원인 임명(안)	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성
		2. SK텔레콤과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

[제68기(2015), 2015년 3월 20일 정기주주총회 선임 이후]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	[제68기] 사외이사 4명	김두경(위원장) 김대일 이창양 최종원	"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조	-
사외이사후보추천위원회	[제68기] 사외이사 2명 사내이사 1명	박영준(위원장) 최종원 박성욱	"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 감사위원회

"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조

(나) 사외이사후보추천위원회

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 총 8인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 5명입니다. 사외이사는 심층면접 및 사외이사후보추천위원회의 추천에 따라 주주총회에서 선임합니다.

(1) 이사회후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 경영참고사항 비치·공시 시(2015. 02. 25) 이사 후보에 대한 인적사항 공시

성 명 (생년월일)	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	비 고
임 형 규 (1953.02.04)	삼성종합기술원장 사장 삼성 전략기획실 신사업팀장 사장 SK수펙스추구협의회 ICT 기술·성장 총괄 부회장 (現)	이사회	없음	

박 성 욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 메모리 연구소 소장 하이닉스반도체 연구개발제조총괄본부장 SK하이닉스 대표이사 (現)	이사회	없음	이사회 의장
김 준 호 (1957.08.28)	법무부 부장검사 SK(주) 윤리경영실장/부사장 SK에너지(주) CMS 사장 겸 SK(주) 윤리경영부문 장 SK텔레콤(주) GMS 사장 SK하이닉스 경영지원부문장 (現)	이사회	없음	-
김 두 경 (1949.10.10)	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위 원
박 영 준 (1952.11.17)	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기·정보공학부 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	
김 대 일 (1962.08.18)	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위 원
이 창 양 (1962.09.20)	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산업자원부 산업정책과장 KAIST 경영대학 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위 원
최 종 원 (1958.10.28)	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 행정고시 26회 공정거래위원회 정책평가위원 서울대 행정대학원장 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위 원

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적]

관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.

[권한]

① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[제68기(2015), 2015년 3월 20일 정기주주총회 선임 이후]

성명	사외이사 여부	비고
박영준	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
최종원	○	
박성욱	X	

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			박영준(출석률: 100%)	윤세리(출석률: 100%)
			찬반여부	
15.02.25	1. 제67기 정기주주총회에 대한 사외이사 후보 추천(안)	가결	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

지원조직	구성	주요담당업무
이사회사무국	직원 3명 (팀장 1명 포함)	- 이사회 및 소위원회 지원 - 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실적

교육일시	교육내용	교육주체
2015. 3.13, 14:00	- 2015년 제1차 사외이사 Workshop · To-be Model · NAND 본원적 경쟁력 강화 방안	이사회사무국

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에

의하여 선임된 감사위원이 되는사외이사 4인(김두경, 김대일, 이창양, 최종원)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인 선임 등
- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)
위원장은 호선에 의하여 선임
- 회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[제68기(2015), 2015년 3월 20일 정기주주총회 선임 이후]

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고
김 두 경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	위원장
김 대 일	서울대 경제학 학사 시카고대 경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-
이 창 양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학 교수(現)	해당사항 없음	-
최 종 원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 행정고시 26회 공정거래위원회 정책평가위원 서울대 행정대학원장 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음	-

다. 감사위원회의 위원의 독립성

당사는 감사위원회 4인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 4인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접

근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

– 감사위원회 규정 제3조

③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

– 감사위원회 규정 제12조(부의사항)

3. 감사에 관한 사항

(1) 업무·재산 조사

(2) 자회사의 조사

(3) 이사의 보고 수령

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

– 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.

② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

– 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

– 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)

① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치·운영하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.

② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회사	일자	의 안	가결여부	사외이사의 성명			
				김두경 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :100%)	이창양 (출석률 :100%)	최종원 (출석률 : 80%)
				찬반여부			
1	15.01.26	1. 2014년 내부회계관리제도 운영 실태	보고	-	-	-	-
		2. 2014년 하반기 내부감사 실적 및 2015년 업무계획	보고	-	-	-	-
		3. SK이노베이션 소유의 업무용 항공기 지분 매입	보고	-	-	-	-
		4. SK C&C와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2	'15.02.23	1. 2014 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-	-

		2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	불참
3	'15.03.11	1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제67기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 감사보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
4	'15.03.23	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK C&C와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
5	'15.04.20	1. SK이노베이션과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에스케이텔레콤(주)	최대주주	보통주	146,100,000	20.07	146,100,000	20.07	유상증자 참여/구주지 분 인수
최신원	특별관계자	보통주	11,000	0.00	11,000	0.00	-
박성욱	특별관계자	보통주	1,502	0.00	1,502	0.00	-
김준호	특별관계자	보통주	8,940	0.00	8,940	0.00	-
임형규	특별관계자	보통주	5,000	0.00	5,000	0.00	-
계		-	146,126,442	20.07	146,126,442	20.07	-
		-	146,126,442	20.07	146,126,442	20.07	-

최대주주명 : 에스케이텔레콤(주)

특수관계인의 수 : 4명

(주1) 최대주주(법인)에 대한 개요

에스케이텔레콤은 정보통신업, 단말기 매매 및 임대업, 뉴미디어사업 등을 영위하는 사업자로 1984년 3월 29일 설립되었습니다. 에스케이텔레콤은 단말, 요금제, 네트워크, 콘텐츠등의 본원적 경쟁력을 기반으로 하여 이동통신서비스를 제공하고 있으며, 국내 최초 LTE 상용화를 통해 기존에는 유선 네트워크 환경에서 가능했던 고품질의 동영상 서비스 및 멀티미디어 게임 등 다양한 서비스가 무선 환경에서도 활성화될 수 있는 제공 기반을 마련하였습니다. 2015년 3월 20일 정기주주총회 기준 에스케이텔레콤의 등기임원은 총 6명으로 사내이사 2명(장동현, 조대식), 사외이사 4명(오대식, 정재영, 이재훈, 안재현)으로 구성되어 있습니다.

- 주요재무정보 (연결기준)

(단위: 백만원)

구분	2014년말	2013년말
자산총계	27,941,233	26,576,515
부채총계	12,692,963	12,409,958
자본총계	15,248,270	14,166,557
영업이익	1,825,105	2,011,109
당기순이익	1,799,320	1,609,549

나. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고
-	(주)한국외환은행	37,742,000	8.2	-
2009년 01월 17일	(주)한국외환은행	37,742,000	7.3	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2009년 05월 19일	(주)한국외환은행	37,742,000	6.4	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2010년 03월 16일	한국정책금융공사	32,412,935	5.5	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 03월 19일	미래에셋자산운용투자자문(주)	35,362,056	6.0	장내 매수/매도
2010년 05월 04일	미래에셋자산운용투자자문(주)	44,041,030	7.46	장내 매수/매도
2010년 08월 03일	한국정책금융공사	32,412,935	5.50	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 10월 11일	국민연금공단	35,894,454	6.08	장내 매수/매도
2011년 01월 10일	국민연금공단	47,786,668	8.10	장내 매수/매도
2011년 04월 11일	국민연금공단	53,774,325	9.11	장내 매수/매도
2011년 07월 08일	국민연금공단	47,838,426	8.08	장내 매수/매도
2011년 10월 07일	국민연금공단	54,202,391	9.15	장내 매수/매도
2012년 02월 15일	에스케이텔레콤(주)	146,100,000	21.05	유상증자 참여 및 구주 지분 인수
2012년 02월 23일	에스케이텔레콤(주)	146,105,000	21.05	특별관계자 추가
2012년 04월 02일	에스케이텔레콤(주)	146,119,894	21.05	계열편입에 따른 특별관계자추가
2012년 06월 22일	에스케이텔레콤(주)	146,127,934	21.05	특별관계자 추가
2013년 05월 09일	에스케이텔레콤(주)	146,115,374	20.57	특별관계자 제외 및 추가
2014년 01월 06일	에스케이텔레콤(주)	146,119,374	20.57	장내 매수
2014년 03월 27일	에스케이텔레콤(주)	146,124,334	20.57	특별관계자 제외 및 추가
2015년 02월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,126,442	20.07	장내 매수

(주1) 위 지분율은 최대주주등소유주식변동신고서상 지분율을 적용하였음.

2. 주식의 분포

가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	에스케이텔레콤(주)	146,126,442	20.07	(주1)
	국민연금공단	70,243,518	9.65	(주2)
우리사주조합		-	-	-

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제 3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특별관계자의 보유주식 26,442주를 합산한 것임.

(주2) 상기 국민연금공단의 보유내역은 2014년 12월 31일자 주주명부 기준임.

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주주		보유주식		비 고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	183,836	99.99	509,244,226	69.95	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
	<p>① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 신주를 인수하게 하는 경우 <개정 2009.3.26></p> <p>2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하게 하는 경우 <개정 2009.3.26></p> <p>3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 <개정 2009.3.26></p> <p>4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 <개정 2009.3.26></p> <p>5) 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 <개정 2000.3.24, 2009.3.26></p> <p>6) 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융 기관 (여기서 '금융기</p>

	<p>관'이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 <개정 1999.3.26, 2001.3.29, 2009.3.26, 2010.3.26></p> <p>7) 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>8) 회사가 "경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자"에게 신주를 발행하는 경우 [신설 1999.3.26] <개정 2009.3.26></p> <p>9) 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우[신설 1999.3.26]</p> <p>10) 근로자복지기본법의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 [신설 2006.3.28]</p> <p>③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.</p>		
결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월 중
주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권 (8종)		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지게재<개정 2012.03.23>

4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종 류		'15년 3월	'15년 2월	'15년 1월	'14년 12월	'14년 11월	'14년 10월
보통주	최고주가	48,300	47,600	50,300	49,450	49,200	47,450
	최저주가	43,250	45,150	47,000	46,500	45,900	41,700
	평균주가	45,982	46,653	48,255	47,895	47,593	45,064
거래량	최고일거래량	5,232	4,548	5,021	2,775	5,493	7,289
	최저일거래량	1,831	1,355	1,156	843	915	1,722
	월간거래량	66,877	39,895	53,484	34,079	38,943	64,400

※ 주가는 일별 종가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 룩셈부르크]

(단위 : USD, DR)

종 류		'15년 3월	'15년 2월	'15년 1월	'14년 12월	'14년 11월	'14년 10월
GDR	최 고	-	-	-	-	-	

	최 저	-	-	-	-	-	
월간거래량		-	-	-	-	-	

※ GDR의 거래량은 미미하며, 장외비중이 크므로 거래량의 정확한 산정이 어려워 기재를 생략함.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(1) 등기임원의 현황

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
임형규	남	1953년 02월	부회장	등기임원	상근	부회장	플로리다대 반도체 공학 박사 삼성종합기술원장 사장 삼성 전략기획실 신사업팀장 사장 SK수펙스추진협의회 ICT 기술·성장 총괄 부회장(現)	5,000	-	선임(14.03.21)	-
박성욱	남	1958년 01월	사장	등기임원	상근	대표이사 사외이사후보 추천위원회 위원	한국과학기술원(KAIST) 재료공학 박사 하이닉스반도체 메모리 연구소 소장 하이닉스반도체 연구개발제조총괄본부장 SK하이닉스 대표이사(現)	1,502	-	선임(09.03.26) 종임(12.02.14, 15.03.20)	-
김준호	남	1957년 08월	사장	등기임원	상근	경영지원부문장	고려대 법학 학사 법무부 부장검사 SK 윤리경영실장/부사장 SK에너지 CMS 사장 겸) SK(주) 윤리경영부문장 SK텔레콤 GMS 사장 SK하이닉스 경영지원부문장 (現)	8,940	-	선임(13.03.22)	-
김두경	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 말권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	-	-	선임(12.02.14) 종임(15.03.20)	-
박영준	남	1952년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보 추천위원회 위원	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 삼성반도체 책임연구원 서울대 전기·정보공학부 교수(現)	-	-	선임(12.02.14) 종임(15.03.20)	-
김대일	남	1962년 08월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	-	-	선임(12.02.14) 종임(15.03.20)	-

이창양	남	1962년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산업자원부 산업정책과장 KAIST 경영대학 교수(現)	-	-	선임(12.02.14) 중임(15.03.20)	-
최종원	남	1958년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원 사외이사후보추 천위원회 위원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 행정고시 26회 공정거래위원회 정책평가위원 서울대 행정대학원장 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원 교수(現)	-	-	선임(14.03.21)	-

※ 임기 만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임.

(2) 등기임원의 겸직 현황

[제출일 현재]

겸직임원		겸직회사		비 고
성 명	직 위	회 사 명	직 위	
박 성 욱	대표이사/사장	SK hynix Semiconductor China Ltd.	이 사	-
		SK hynix memory solutions Inc.	이 사	-
김 준 호	경영지원부문장	SK hynix Semiconductor China Ltd.	이 사	-
최 종 원	사외이사	두산건설(주)	사외이사	-

(3) 미등기 임원 현황

직 명 (상근여부)	등기임원 여부	성 명	성 별	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수		비 고
							보통주	우선주	
회장 (비상근)	미등기임원	최태원	남	60.12.03	미국 시카고대 경제학 박사수료 SK하이닉스 대표이사	회장	-	-	-
사장 (상근)	미등기임원	오세용	남	54.12.15	MIT(재료) 박사 AIPT	제조/기술부문장	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	김동균	남	57.11.05	고려대(재료) 학사 FAB제조본부장	환경안전본부장	428	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	이동훈	남	57.10.07	Univ.of Michigan(전자) 박사 메모리시스템연구소장	미래기술부문장	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	이석희	남	65.06.23	Stanford Univ.(재료) 박사 미래기술연구원장	DRAM개발부문장	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	진정훈	남	63.10.21	JOHN MARSHALL LAW SCHOOL 해외영업단장	마케팅부문장	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	홍성주	남	62.11.06	KAIST(물리) 박사 DRAM개발본부장	미래기술연구원장	6,842	-	-

전무 (상근)	미등기임원	김진국	남	64.07.17	연세대(전기)학사 Mobile개발본부장	DRAM기술본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	김진웅	남	64.02.01	KAIST(재료) 박사 Flash공정그룹장	NAND개발본부장	2,771	-	-
전무 (상근)	미등기임원	송현중	남	65.11.23	M.I.T(경영) 석사 SK텔레콤	미래전략본부장	3,000	-	-
전무 (상근)	미등기임원	양예석	남	60.01.11	인하대(화학) 학사 Mobile개발본부장	품질보증본부장	428	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이명영	남	62.02.20	연세대(경영) 학사 SK네트웍스	재무본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이상선	남	61.09.23	고려대(전기) 학사 M11제조기술/신제품그룹장	청주FAB센터장	4,000	-	-
전무 (상근)	미등기임원	임종필	남	60.11.14	고려대(화학공업) 학사 SK텔레콤	SCM본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	진교원	남	62.09.22	서울대(물리) 학사 NAND상품기획실장	NAND개발부문장	112	-	-
전무 (상근)	미등기임원	최영준	남	63.01.09	동국대(전자) 학사 Flash상품기획그룹장	NAND Solution개발본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	한성규	남	58.10.27	경북대(전자) 학사 CIS사업부장	SystemIC FAB장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	현순엽	남	63.10.27	서울대(경영) 석사 SK이노베이션	기업문화본부장	3,520	-	-
상무 (상근)	미등기임원	곽노정	남	65.11.06	고려대(재료) 박사 GLDP파견	미래기술연구원 공정기술 그룹장	1,103	-	-
상무 (상근)	미등기임원	곽봉수	남	64.01.29	서울대(경영) 석사 CorporateCenter CC지원담당	SCM본부 SCM TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	권원택	남	62.10.10	광운대(전자) 학사 미래기술연구원 Photo팀장	제조/기술부문 Photo기술 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김기석	남	62.06.26	연세대(물리)박사 미래기술연구원 Flash소자기술P팀장	미래기술연구원 소자기술 그룹	1,612	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김남석	남	67.02.20	서울대(금속) 박사 PKG&TEST IPT개발그룹장	제조/기술부문 P&T기술그 룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김대영	남	62.09.21	부산대(재료) 학사 DRAM개발본부 DRAM소자TD팀장	DRAM기술본부 Core개발 그룹	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김상근	남	62.01.05	동아대(전기) 학사 환경안전본부 설비기술실장	환경안전본부 이천설비기 술실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영래	남	66.01.25	연세대(전자) 학사 마케팅본부 FlashComputing마케팅 팀장	마케팅부문 Flash마케팅그 룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영서	남	63.11.30	광운대(재료) 학사 생산추진1그룹장	환경안전본부 환경안전실 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영일	남	65.10.13	Univ. of Denver(경영) 석사 기술전략팀장	DRAM개발부문 DRAM개 발기획그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영호	남	61.05.17	고려대(재료) 학사 M10Yellow제조기술그룹장	SCM본부 구매1실장	328	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김용균	남	62.10.22	동아대(전자) 학사 생산기술본부 EE그룹장	환경안전본부 청주설비기 술실장	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	김용희	남	61.03.15	고려대(물리) 학사 DRAM제품기술PD팀장	DRAM기술본부 제품기술 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김윤생	남	63.08.06	홍익대(전자) 석사 핵심설계기술그룹장	DRAM제품본부 D- Convergence설계그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김은대	남	58.11.12	인하대(전자) 학사 특허그룹장	윤리경영실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김정기	남	64.01.20	서강대(언론학) 석사 SK이노베이션	대외협력본부 Communication실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김종호	남	67.01.12	고려대(전자) 학사 마케팅본부 Flash마케팅그룹장	마케팅부문 영업그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김주선	남	66.06.01	성균관대(산업공학) 학사 영업기획팀장	마케팅부문 마케팅전략그 룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김태훈	남	63.02.17	경북대(전기) 학사 청주FAB FC기술그룹장	제조/기술부문 BEPT그룹 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김현곤	남	62.07.17	KAIST(물리) 박사 Mobile개발그룹장	DRAM제품본부 Mobile설 계그룹장	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김현수	남	65.07.19	KAIST(물리) 박사 미래기술연구원 수율개선그룹장	미래기술연구원 기술기획 그룹장	112	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김형수	남	65.02.24	KAIST(재료공학) 박사 미래기술연구원 수율개선그룹장	미래기술연구원 NM공정그 룹장	500	-	-
상무 (상근)	미등기임원	민경현	남	66.01.19	New York Univ.(법학) 석사 특허그룹장	대외협력본부 법무특허실 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박근우	남	66.04.20	KAIST(전자) 석사 선행설계그룹장	NAND개발본부 NAND설계 그룹장	1	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박래학	남	61.05.05	한양대(물리) 학사 DRAM&CIS마케팅그룹장	마케팅부문 DRAM마케팅 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박성계	남	67.06.21	KAIST(전자) 박사 미래기술연구원 Flash소자기술D팀장	미래기술연구원 소자기술 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박성기	남	59.08.12	연세대(요업) 학사 미래기술연구원 공정그룹장	제조/기술부문 FEPT그룹 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박윤세	남	59.04.25	연세대 고체물리 석사 AIPT	생산기술센터장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박재광	남	66.04.06	Havard Univ.(종교학) 석사 마케팅본부 마케팅GlobalizationTF장	마케팅부문 사업개발담당	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박재수	남	61.04.26	경북대(전자) 학사 이천FAB PE-TF장	SystemIC FAB 제조그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박정식	남	63.12.05	홍익대(전자) 석사 D-TEST기술그룹장	P&T센터장	112	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박철규	남	66.06.16	경북대(전자) 학사 DRAM품질기술팀장	품질보증본부 DRAM품질 보증그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박현열	남	59.08.10	서울시립대(화공) 학사 품질혁신그룹장	제조/기술부문 QE그룹장	1,728	-	-
상무 (상근)	미등기임원	백현철	남	65.03.15	고려대(화학) 학사 미래기술연구원 DRAM공정팀장	DRAM기술본부 Deneb공 정TF	630	-	-
상무 (상근)	미등기임원	사택진	남	61.11.20	고려대(경영) 석사 회계팀장	재무본부 회계관리실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	송창록	남	69.01.20	서울대(무기재료) 박사 이천FAB DI수율그룹장	이천FAB센터 DRAM공정 /수율분석PJT PM	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	신승국	남	62.11.03	Vanderbilt Univ.(법학) 박사 SK에너지	대외협력본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	신희풍	남	60.10.22	인하대(회계) 학사 원가그룹장	SCM본부 G-ERP추진실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안규옥	남	62.09.01	중앙대(회계) 석사 원가그룹장	재무본부 수익성분석실장	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안근옥	남	59.08.15	단국대(전자) 학사 리디스테크놀로지	NAND개발본부 NAND소자 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안현	남	67.06.04	서울대(원자핵공학) 박사 경영전략실장	NAND개발부문 NAND개발 기획그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	양중섭	남	64.12.19	KAIST(물리) 석사 Flash제품그룹장	NAND Solution개발본부 MobileSolution개발그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	오종훈	남	64.08.20	서울대(전자) 학사 DRAM상품기획실장	DRAM제품본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	위보령	남	64.06.26	KAIST(물리) 박사 메모리시스템연구소 E-Project장	DRAM개발부문 메모리시 스템연구소장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	유경동	남	61.12.23	옥스포드(재료) 박사 CIS개발설계그룹장	CIS사업부 개발그룹장	2,480	-	-
상무 (상근)	미등기임원	유상동	남	65.12.10	한양대(전자) 박사 Analog/PX설계팀장	CIS사업부 설계그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	윤건상	남	62.10.05	성균관대(전자) 학사 제품기술그룹장	DRAM제품본부 시스템솔 루션그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이동재	남	62.10.02	성균관대(전자) 학사 파운드리/신사업부장	신사업부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이병석	남	61.03.25	영남대(화학) 석사 미래기술연구원 Etch팀장	미래기술연구원 Flash공정 팀장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이상래	남	65.07.09	Boston(MBA) 경영전략그룹장	SC사업기획본부파견	2	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이석규	남	63.12.21	서울대(재료) 박사 미래기술연구원 Flash소자기술팀장	미래기술연구원 DMR팀장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이성동	남	65.03.04	서강대(전자) 학사 PKG제조그룹장	P&T센터 청주P&T장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이우빈	남	64.10.27	Univ. of Washington(전자) 박사 H-TF장	CIS사업부 CIS마케팅그룹 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이정훈	남	64.06.10	연세대(물리) 석사 소자기술PCRAM팀장	미래기술연구원 NM소자그 룹장	2,500	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이종수	남	62.08.03	광운대(재료) 석사 파운드리사업그룹장	SystemIC FAB Service Enablement그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이철호	남	60.09.15	광운대(재료) 학사 DRAM품질보증그룹장	현장경영실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이희기	남	64.07.13	인하대(전기) 학사 Flash제품그룹장	NAND개발본부 NAND제품 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임동규	남	64.04.10	서울대(물리교육) 박사 선행공정1팀장	미래기술연구원 MASK기 반기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임성빈	남	63.06.17	울산대(기계) 학사 청주FAB FC-FAB그룹장	생산기술센터 장비기술 PJT PM	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장종태	남	64.10.20	한양대(사회학) 학사 기업문화본부 총무/인력개발실장	청주지원본부장	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	장태식	남	61.10.02	고려대(전자) 학사 Mobile소자그룹장	DRAM기술본부 Core개발 그룹	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장희현	남	63.01.26	연세대(전자) 학사 NAND개발본부 NAND소자C팀장	NAND개발본부 NAND소자 그룹	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전영호	남	61.04.01	광운대(전자) 학사 청주FAB F-NTD팀장	청주FAB센터 NAND신제 품PJT PM	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전윤석	남	64.12.25	Univ. of Utah(재료) 박사 미래기술전략총괄 R-Project장	미래기술부문 기술개발그 룹	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전준현	남	66.05.19	경북대(전자) 학사 Mobile설계1팀장	DRAM제품본부 DRAM설 계그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정의삼	남	65.03.01	고려대(화공) 학사 제조/기술부문 M&T기획그룹장	제조/기술부문 투자기획팀 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정재관	남	60.09.09	영남대(물리) 석사 미래기술연구원 소자기술그룹장	DRAM기술본부 Core개발 그룹장	2,144	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정종호	남	64.03.21	광운대(재료공학) 학사 우시FAB DW수율그룹장	미래기술연구원 수율개선 그룹	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	차선용	남	67.08.04	KAIST(전기전자공학) 박사 미래기술연구원 DRAM소자기술D팀 장	미래기술연구원 소자기술 그룹	400	-	-
상무 (상근)	미등기임원	차성근	남	64.01.08	연세대(경영학) 학사 SK이노베이션	재무본부 IR실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최근민	남	60.09.20	Tohoku Univ.(전자) 박사 우시-제조기술그룹장	이천FAB센터장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최봉호	남	62.09.20	연세대(요업) 석사 이천FAB센터 DRAM신제품PJT PM	DRAM기술본부 Deneb공 정TF장	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최석문	남	66.04.13	Univ. of Michigan(경영) 석사 SK텔레콤	미래전략본부 경영기획실 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최석훈	남	57.12.23	일산고등학교 청주지원본부장	경영지원부문 노사전문위 원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최수환	남	68.05.18	KAIST(전자) 학사 SK텔레콤	NAND개발부문 NAND상품 기획실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	피승호	남	66.04.10	KAIST(재료) 박사 미래기술연구원 Flash공정팀장	미래기술연구원 수율개선 그룹장	569	-	-
상무 (상근)	미등기임원	한종희	남	66.01.07	KAIST(반도체) 박사 StorageSolution그룹	NAND Solution개발본부 StorageSolution개발그룹 장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	허용진	남	61.02.13	건국대(전자) 석사 청주FAB FC수율그룹장	청주FAB센터 NAND공정 /수율분석PJT PM	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	허현국	남	65.03.03	부산대(경제학) 학사 노사지원팀장	청주지원본부 청주경영지 원실장	71	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍권	남	65.11.03	고려대(요업) 박사 미래기술연구원 기술기획팀장	기업문화본부 HR실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍상후	남	63.02.20	성균관대(전자) 학사 품질기술담당	품질보증본부 Solution품 질보증그룹장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	김현준	남	65.09.13	성균관대(경영학) 학사 상해법인	기업문화본부 SUPLEX추구 협의회파견	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	신현상	남	67.08.20	KAIST(재료공학) 박사 미래기술연구원 수율개선2팀장	미래기술연구원 수율개선 그룹	-	-	-

상무보 (상근)	미등기임원	심대용	남	69.06.10	서울대(전기전자컴퓨터공학) 박사 Mobile제품그룹장	DRAM제품본부 D- Convergence설계그룹	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	오종진	남	65.02.05	경희대(정보통신공학) 석사 SCM실 인프라구매팀장	SCM본부 구매2실장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	유진산	남	63.06.03	고려대(화학) 학사 제조/기술PL	생산기술센터 M14 PJT PM	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	장혁준	남	67.06.22	Indiana Univ.(경영학) 석사 재경실 국제금융팀장	재무본부 재무기획실장	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	정철우	남	65.04.27	성균관대(전자) 학사 DRAM개발본부 Embedded응용기술 팀장	DRAM제품본부 시스템솔 루션그룹	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	조돈구	남	63.10.26	건국대(전자) 학사 PKG&TEST DT기술그룹장	제조/기술부문 DRAM TEST기술PJT PM	-	-	-
상무보 (상근)	미등기임원	최정산	남	67.01.25	연세대(물리학) 석사 품질보증본부 DRAM고객만족팀장	품질보증본부 고객품질그 룹장	-	-	-
수석연구위 원 (상근)	미등기임원	노재성	남	60.11.27	KAIST(재료) 박사 NM공정S팀장	미래기술연구원 FT Lab장	2,586	-	-
수석연구위 원 (상근)	미등기임원	전중석	남	58.02.10	Univ. of Arizona(재료공학) 박사 AMD	미래기술부문 기술개발그 룹장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김태훈	남	70.02.22	Arizona State Univ.(전자) 박사 선행소자Ntt팀	미래기술연구원 NM소자그 룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	나한주	남	63.05.22	서강대(물리학) 학사 PKG&TEST SSD기술팀장	NAND Solution개발본부 StorageSolution개발그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	박성수	남	65.02.09	KAIST(전기전자공학) 박사 Silicon Image	NAND Solution개발본부 SoC설계그룹장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	복철규	남	64.07.25	연세대(경영) 석사 DRAM공정P팀	미래기술연구원 Photo팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	안상기	남	66.09.16	배재대(정보통신공학) 석사 BROADCOM	신사업부 제품개발그룹장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	양현조	남	63.11.28	연세대(요업) 석사 노광OPC팀	미래기술연구원 노광 OPC팀장	508	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이상원	남	67.01.16	고려대(메카트로닉스과) 박사 Intel	신사업부 설계인프라그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이인경	여	63.11.06	Univ. of Pittsburgh(화학) 박사 생산기술본부 YS-Project	미래기술연구원 C&C팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이재진	남	63.10.30	서울대(물리) 학사 DRAM제품본부 DRAM설계그룹	DRAM제품본부	5,609	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이진용	남	64.08.23	광운대(전자) 학사 휴먼칩스	신사업부 설계인프라그룹 장	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이창렬	남	67.02.20	KAIST(전자) 박사 DRAM개발본부 DRAM소자팀	미래기술연구원 DMR팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이창세	남	63.02.07	San Jose State Univ.(경영) 석사 NAND Solution개발본부 SoCArchitecture팀	NAND Solution개발본부 SW Engineering TF장	-	-	-

연구위원 (상근)	미등기임원	임용희	남	69.01.10	Purdue Univ.(전기전자) 박사 NAND Solution개발본부 SoCArchitecture팀	NAND Solution개발본부 SoC설계그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	임찬	남	66.01.12	연세대(물리) 석사 미래기술연구원 Flash소자기술D팀	미래기술연구원 소자기술 그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	임창문	남	66.06.15	KAIST(물리) 박사 DRAM공정P팀	미래기술연구원 Photo팀	8,500	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	장경식	남	67.07.05	포항공대(전자) 석사 DRAM개발본부 DRAM소자분석팀장	DRAM기술본부 DRAM소 자그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	장세억	남	66.03.05	포항공대(재료) 석사 미래기술연구원 DRAM공정D팀	미래기술연구원 Diffusion팀	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	장재영	남	68.10.26	Univ. of Colorado(전자) 박사 메모리시스템연구소 E-Project	NAND Solution개발본부 SoC설계그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	전홍신	남	67.08.22	서강대(전자) 박사 DRAM개발본부 TSV제품기술팀	DRAM기술본부 제품기술 그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	정성웅	남	67.08.09	KAIST(재료) 박사 미래기술연구원 선행소자S팀장	미래기술연구원 NM소자그 룹	242	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	정현모	남	75.07.23	서울대(컴퓨터공학) 석사 FlashSolution개발본부 PCIeFW개발 팀장	NAND Solution개발본부 StorageSolution개발그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	조규석	남	64.01.18	KAIST(반도체) 박사 미래기술연구원 Flash소자기술D팀	미래기술연구원 소자기술 그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	조명관	남	66.05.17	포항공대(전자) 박사 NAND개발본부 NAND소자D팀장	NAND개발본부 NAND소자 그룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	조인욱	남	68.08.21	한양대(전기및컴퓨터) 석사 CIS사업부 TD팀장	미래기술부문 기술개발그 룹	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	최기식	남	68.08.13	Texas Tech Univ.(전자) 박사 미래기술전략총괄 U-Project	미래기술부문 기술개발그 룹	-	-	-
기술위원 (상근)	미등기임원	이한주	남	65.11.15	성균관대(기계) 학사 생산기술본부 S-Project장	생산기술센터 자동화기술 PJT PM	-	-	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수				평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	비고
		정규직	계약직	기 타	합 계				
-	남	12,280	14	-	12,294	10	561,668,319	45,686	-
-	여	9,388	25	-	9,413	9	284,654,514	30,241	-
합 계		21,668	39	-	21,707	10	846,322,833	38,988	-

※ 상기 직원의 수는 본사기준이며, 사내이사 제외 기준임.

※ 상기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임

.

※ 상기 급여총액에는 성과급이 포함되어 있음.

다. 노동조합의 현황

(기준일: 2015년 3월 31일)

구 분	관 련 내 용	비 고
가입대상	이천 7,269명 / 청주 5,152명	-
가입인원	이천 7,038명 / 청주 5,115명	-
근로시간 면제자	이천 10명 / 청주 6명	-
소속된 연합단체	한국노총 금속노련	-
기 타	-	-

2. 임원의 보수 등

가. 이사·감사 전체의 보수 현황

(1) 주총승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기임원	8명	12,000	-

(2) 지급금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사	3	1,764	588	-
사외이사	1	39	21	-
감사위원회 위원 또는 감사	4	78	20	-
계	8	1,881	212	-

※ 인원수는 2015.03.31 현재 기준임

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 당분기까지 총액 기준임

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 분기평균인원수로 나누어 계산함

나. 이사·감사의 개인별 보수 현황

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
박성욱	대표이사	1,060	-
김준호	이사	704	-

2. 산정기준 및 방법

구분	보수의 종류		금액	산정기준 및 방법
대표이사 박성욱	근로소득	급여	160	이사보수한도의 범위 내에서 수행 직무의 가치를 반영한 Position Grade에 따라 산정하였음
		상여	891	'14년 성과에 대한 경영성과급으로 '15년 2월에 지급하였고 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~200% 내에서 지급함. 수익성 중심 경영을 통해 '14년 매출액 17조 1,256억원 및 영업이익 5조 1,095억원 (이상 연결기준) 달성 등 계량 지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 제품 경쟁력 강화 및 기술 혁신, 적시의 투자 의사 결정, 조직문화 개선 등 회사의 본원적 경쟁력 강화를 통해 미래를 준비함으로써 질적 성장 기반을 공고히 한 점을 고려하여 성과급 891백만원을 지급하였음.
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	9	자녀학자금 등 회사 복지제도 지원 기준에 따른 복리후생으로 구성
	퇴직소득		-	-
	기타 소득		-	-
이사 김준호	근로소득	급여	135	이사보수한도의 범위 내에서 수행 직무의 가치를 반영한 Position Grade에 따라 산정하였음
		상여	569	'14년 성과에 대한 경영성과급으로 '15년 2월에 지급하였고 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~200% 내에서 지급함. 수익성 중심 경영을 통해 '14년 매출액 17조 1,256억원 및 영업이익 5조 1,095억원 (이상 연결기준) 달성 등 계량 지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 전략/인사/재무/구매 등 전반적인 경영지원을 통해 회사 성과 창출 및 안정적인 경영 환경 구축에 기여한 점을 고려하여 성과급 569백만원을 지급하였음.
		주식매수선택권 행사이익	-	-

	기타 근로소득	-	-
	퇴직소득	-	-
	기타 소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

※ 해당사항 없음.

라. 임원배상책임보험 가입 현황

(1) 보험의 개요

[2015. 3. 31 현재]

(단위 : 백만원)

보험의 명칭	보험료납입액		부보(보상) 한도	비 고
	당기 납입액	누적납입액 (당기분 포함)		
임원배상책임보험	35	35	50,000	

(2) 피보험자

회사 및 회사의 과거·현재·미래의 모든 임원으로 보험기간 중 선임, 퇴임 임원을 모두 포함합니다.

(3) 보상하는 손해

임원의 업무상 과실 및 임원으로서 의무위반으로 최초 제기된 손해배상 청구에 따른 주주 또는 제 3자에 대한 손해배상책임을 보상하며, 임원의 손해배상청구에 대해 회사가 해당임원에게 지급한 회사발생 손해를 보상합니다.

(4) 보험회사의 면책사항

- 보험개시일 이전의 원인행위로 인해 발생한 손해배상
- 법령을 위반하여 발생한 환경오염에 대해 제기되는 손해배상청구
- 임원의 범죄행위(사기, 횡령, 배임 등)로 인한 손해배상청구

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단의 개요

- 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

(2) 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○
- 지정시기 : 1987년

○ 규제내용 요약

- 기업결합의 제한
- 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
- 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
- 기업집단 현황 공시 등

(3) 관계회사간 출자현황

[2015년 3월 31일 기준]

(보통주 기준)

\ 피투자회사 투자회사	SK(주)	SK이노베이션	SK에너지	SK종합화학	SK텔레콤	SK네트웍스	SKC	SK건설	SK해운	SK증권
SK(주)		33.4%			25.2%	39.1%	42.3%	44.5%	83.1%	
SK이노베이션			100.0%	100.0%						
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤										
SK케미칼						0.02%		28.3%		
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C	31.8%									10.0%
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신택										
아이리버										
계열사 계	31.8%	33.4%	100.0%	100.0%	25.2%	39.2%	42.3%	72.7%	83.1%	10.0%
\ 피투자회사 투자회사	SK E&S	SK가스	대한송유관 공사	충청에너지 서비스	영남에너지 서비스	코원에너지 서비스	엔티스	SK텔링크	부산도시가스	전남도시가스
SK(주)	94.1%									

SK이노베이션			41.0%							
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤								83.5%		
SK케미칼		45.6%					50.0%			
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C	5.9%									
SK E&S				100.0%	100.0%	100.0%			67.3%	100.0%
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신택		10.0%								
아이리버										
계열사 계	100.0%	55.5%	41.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	83.5%	67.3%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	강원도시가 스	전북에너지 서비스	당진 에코파워	엠앤서비스	SK와이번스	인포섹	행복나래	SK텔레시스	하남에너지 서비스	에프앤유 신용정보	에스엠피씨
SK(주)											
SK이노베이션							42.5%				
SK에너지											
SK종합화학											
SK네트웍스											
SK텔레콤					100.0%		42.5%			50.0%	
SK케미칼											
SKC								50.6%			100.0%
SK건설											
SK가스			45.0%				5.0%				
SK C&C						99.4%	5.0%				
SK E&S	100.0%	100.0%									
SK커뮤니케이션즈											
SK브로드밴드											
SK D&D											
SK루브리컨츠											
SK해운											
SK플래닛				100.0%							
SK하이닉스											
코원에너지서비스									100.0%		
SK신택											
아이리버											
계열사 계	100.0%	100.0%	45.0%	100.0%	100.0%	99.4%	95.0%	50.6%	100.0%	50.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	SK디앤디	내트릭	SK하이닉스	스피드모터스	SK모바일 에너지	SK유휘	SK커뮤니 케이션즈	SK플래닛	SKC에어가스	SK네트웍스 서비스
SK(주)										
SK이노베이션					100.0%					
SK에너지		100.0%								

SK종합화학										
SK네트웍스				100.0%						86.5%
SK텔레콤			20.1%					100.0%		
SK케미칼										
SKC									80.0%	
SK건설										
SK가스	40.3%									
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛							64.5%			
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신타						100.0%				
아이리버										
계열사 계	40.3%	100.0%	20.1%	100.0%	100.0%	100.0%	64.5%	100.0%	80.0%	86.5%

\ 피투자회사 투자회사	커머스플래닛	이니츠	SKC솔믹스	SK브로드밴드	바이오랜드	피엠피	PS&마케팅	유비케어	위례에너지 서비스	제주 유나이 티드 FC
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										100.0%
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤				50.6%			100.0%			
SK케미칼		66.0%						44.0%		
SKC			45.0%		23.6%					
SK건설										
SK가스										
SK C&C										
SK E&S						100.0%			89.5%	
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛	100.0%									
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신타										
아이리버										
계열사 계	100.0%	66.0%	45.0%	50.6%	23.6%	100.0%	100.0%	44.0%	89.5%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	MKS개런티	SK임업	SK루브리컨츠	SKC라이팅	SK하이이엔지	SK하이신타	실리콘화일	SK바이오팜	SK신타	대전왓은물
SK(주)		100.0%						100.0%		
SK이노베이션			100.0%							
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										

SK텔레콤										
SK케미칼									100.0%	
SKC				100.0%						
SK건설										32.0%
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D	100.0%									
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스					100.0%	100.0%	100.0%			
코원에너지서비스										
SK신택										
아이리버										
계열사 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32.0%

\ 피투자회사 투자회사	광주광역시 물	에스케이 더블유	텔레비전 미디어코리아	네트웍 오앤에스	서비스에이스	서비스탑	SK핀크스	유베이스매뉴 팩처링아시아	울산 아로마텍스	SK배터리 시스템즈
SK(주)										
SK이노베이션										100.0%
SK에너지										
SK종합화학									50.0%	
SK네트웍스							100.0%			
SK텔레콤				100.0%	100.0%	100.0%				
SK케미칼										
SKC		90.0%								
SK건설	42.0%									
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK루브리컨츠								100.0%		
SK해운										
SK플래닛			51.0%							
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신택										
아이리버										
계열사 계	42.0%	90.0%	51.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	지허브	SK인천 석유화학	SK트레이딩 인터내셔널	보령 LNG터미널	네오에스 네트웍스	SK엔카닷컴	아이리버	SK 어드밴스드
SK(주)								
SK이노베이션		100.0%	100.0%					
SK에너지								
SK종합화학								
SK네트웍스								
SK텔레콤					66.7%		49.0%	
SK케미칼								

SKC								
SK건설								
SK가스	100.0%							65.0%
SK C&C						50.0%		
SK E&S				50.0%				
SK커뮤니케이션즈								
SK브로드밴드								
SK D&D								
SK루브리컨츠								
SK해운								
SK플래닛								
SK하이닉스								
코원에너지서비스								
SK산텍								
아이리버								
계열사 계	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	66.7%	50.0%	49.0%	65.0%

(*) 사명 변경 : 울산아로마텍스(주) (舊 아로케미(주)), 행복나래(주) (舊 엠알오코리아(주)),
SK하이닉스(주) (舊 (주)하이닉스), 에스케이하이이엔지(주) (舊 (주)하이닉스엔지니어링)
엔티스(주) (舊 SK사이텍(주)), SK배터리시스템즈(주) (舊 SK컨티넨탈이모션코리아(주))

(4) 계열회사 등 관리조직 현황

[SK하이이엔지, SK하이닉스, 실리콘화일]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영기획실에서 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영기획실은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 서비스도급계약 및 파운드리 서비스계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[SKHYA(미주), SKHYCS(상해), SKHYT(대만), SKHYD(독일), SKHYU(영국), SKHYJ(일본), SKHYS(싱가폴), SKHYIS(인도), SKHYH(홍콩), SKHYCW(우시)]

당사의 상기 판매법인들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매행위를 대행하며, 이에 법인 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 판매법인은 본사 조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다. 법인의 영업활동에 필요한 제반항목에 대해 본사의 마케팅전략팀이 커뮤니케이션 창구로서의 지원 업무를 수행하며 영업과 무관한 고유업무는 해당기능의 본부에서 관할합니다.

(5) 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[제출일 현재]

겸직임원		겸직 계열회사		비 고
성 명	직 위	회 사 명	상근여부	
박 성 욱	대표이사/사장	SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-
		SK hynix memory solutions Inc.	비상근	-

김 준 호	경영지원부문장	SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-
-------	---------	-----------------------------------	-----	---

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 3월 31일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초 취득일자	출자 목적	최초 취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
에스케이하이엔지 주식회사	01.07.05	경영참 가	7,399	500,689	100.00	7,521	-	-	-	500,689	100.00	7,521	55,008	3,608
에스케이하이텍 주식회사	08.03.15	경영참 가	5,840	277,203	100.00	6,760	-	-	-	277,203	100.00	6,760	40,789	2,956
(주)실리콘화일	08.08.12	경영참 가	76,904	8,444,276	100.00	62,208	-	-	-	8,444,276	100.00	62,208	53,371	3,239
SK hynix Semiconductor America Inc.(SKHYA)	83.03.15	경영참 가	1,231,196	6,285,587	97.74	31	-	-	-	6,285,587	97.74	31	1,711,746	21,385
SK hynix Semiconductor Manufacturing America Inc.(SKHYMA)	04.07.09	경영참 가	98	100,000	0.05	0	-	-	-	100,000	0.05	0	49,061	-8,751
SK hynix Semiconductor Deutschland GmbH(SKHYD)	89.03.01	경영참 가	80,956	출자증서	100.00	22,011	-	-	-	출자증서	100.00	22,011	135,384	6,197
SK hynix UK Ltd.(SKHYU)	13.11.05	경영참 가	1,775	186,240,200	100.00	1,775	-	-	-	186,240,200	100.00	1,775	194,318	1,813
SK hynix Semiconductor Asia Pte.Ltd.(SKHYS)	91.09.12	경영참 가	137,531	196,303,500	100.00	52,380	-	-	-	196,303,500	100.00	52,380	386,135	2,773
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.(SKHYH)	95.04.27	경영참 가	223,233	170,693,661	100.00	32,623	-	-	-	170,693,661	100.00	32,623	563,598	12,941
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	06.06.29	경영참 가	6,357	출자증서	100.00	4,032	-	-	-	출자증서	100.00	4,032	53,853	5,112
SK hynix Semiconductor Japan Inc.(SKHYJ)	96.09.16	경영참 가	81,587	20,000	100.00	42,905	-	-	-	20,000	100.00	42,905	285,122	9,890
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	96.09.16	경영참 가	13,330	35,725,000	100.00	37,562	-	-	-	35,725,000	100.00	37,562	628,791	7,599
SK hynix Semiconductor Indian Subcontinent Private Ltd.(SKHYIS)	07.03.29	투자	5	270	1.00	5	-	-	-	270	1.00	5	722,457	73
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	05.06.30	경영참 가	1,966,060	출자증서	90.26	2,520,881	-	-	-	출자증서	90.26	2,520,881	4,179,186	381,729
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	06.04.17	경영참 가	47,384	출자증서	100.00	238,271	-	-	-	출자증서	100.00	238,271	269,999	-297
HiTech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	09.11.17	경영참 가	90,150	출자증서	45.00	92,608	-	-	-	출자증서	45.00	92,608	584,071	38,599
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	10.07.29	경영참 가	237	출자증서	100.00	237	-	-	-	출자증서	100.00	237	22,647	159
SK hynix Italy(SKHYIT)	12.05.11	경영참 가	18	출자증서	100.00	18	-	-	-	출자증서	100.00	18	2,610	310

SKHMS(SK Hynix Memory Solutions Inc.)	12.08.20	경영참가	311,284	128	100.00	311,284	-	-	-	128	100.00	311,284	59,922	10,183
SK hynix Semiconductor Flash Solution Taiwan (SKHYFST)	13.08.29	경영참가	7,819	출자증서	100.00	7,819	-	-	-	출자증서	100.00	7,819	8,209	313
SK APtech	13.09.02	경영참가	158,380	150,000,000	100.00	158,380	-	-	-	150,000,000	100.00	158,380	158,383	-1
Softeq Flash Solutions LLC.	14.06.03	경영참가	14,579	출자증서	99.90	14,579	-	-	-	출자증서	99.90	14,579	3,961	25
STRATIO, INC.	15.02.12	투자	2,194	-	-	-	1,136,013	2,194	0	1,136,013	9.10	2,194	-	-
Sky Property	13.12.27	투자	112,361	5,745	15.00	112,361	-	-	-	5,745	15.00	112,360	842,578	17,894
특정금전신탁	08.11.17	투자	21,847	201,600,000	7.93	0	-	-	-	201,600,000	7.93	0	1,405,327	-470,296
인텔렉추얼디스커버리	11.05.13	투자	4,000	800,000	7.05	4,000	-	-	-	800,000	7.05	4,000	44,353	-7,792
합계						3,730,250	-	-	-			3,732,444		

※ 최근 사업년도 재무현황은 2014년 말 실적이며 특정금전신탁은 가장 최근 자료인 2012년 9월말 기준 재무제표상 금액을 반영함

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과 목	변 동 내 역				미수 이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
SK hynix America Inc.(SKHYA)	계열사	단기 대여금	49,464 (USD 45,000,000)	-	-	49,725 (USD 45,000,000)	78 (USD 72,386)	거래기간: 2010.11.16~ 2015.11.15
SK hynix memory solutions Inc. (SKHMS)	계열사	장기 대여금	5,496 (USD 5,000,000)	-	-	5,525 (USD 5,000,000)	1 (USD 886)	거래기간: 2012.09.27~ 2015.09.27
		장기 대여금	5,496 (USD 5,000,000)	-	-	5,525 (USD 5,000,000)	8 (USD 7,009)	거래기간: 2012.11.20~ 2015.09.27
합 계			60,456	-	-	60,775	87	-

※ 당기 중 증감분에는 환율변동으로 인한 외화평가금액이 반영되었음.

2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래금액	거래내용	비 고
SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd.	해외법인	2015.03.09	매각일자	449	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd.	해외법인	2015.03.10	매각일자	320	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd.	해외법인	2015.03.16	매각일자	276	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd.	해외법인	2015.03.24	매각일자	1,617	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2015.01.14	매입일자	379	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2015.02.06	매입일자	39,196	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2015.03.04	매입일자	129	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2015.03.11	매입일자	37,503	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2015.03.15	매입일자	1,405	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2015.03.18	매입일자	1,259	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2015.03.27	매입일자	1,818	매입	생산 효율화 목적

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 · 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	제 목	신고 내용
2015.01.16	기타 주요경영사항 (자율공시)	도시바 주식회사는 1) 도시바 주식회사의 영업비밀에 해당하는 기술정보 파기 및 이를 이용하여 제조한 NAND Flash 제품 등을 제조, 판매하는 행위 등 금지, 2) 1091억 5100만엔 청구(이 금액은 스기타 요시타카와 연대)를 내용으로 하는 당사에 대해 소송을 제기함. 위 소송은 당사가 도시바 주식회사에 합의금 USD 278,000,000를 지급함으로써 취하하기로 합의하였으며, 법원의 소송 취하를 통해 종결되었음.
2014.10.23	신규 시설투자 등	이천 공장의 신규 클린룸 건설을 위해 1.8조원 투자 예정이었으나, fab 설계변경, 환경안전 인프라 보강, 사무공간 및 기숙사 확장 등으로 인하여 2.1조원으로 투자 예정 금액이 증가함.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 67기 정기주주총회 (2015.03.20)	제67기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	
제 66기 정기주주총회 (2014.03.21)	제66기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보: 임형규)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 120억원)	
	임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	
제 65기 정기주주총회 (2013.03.22)	제65기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보: 김준호)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	

제 64기 정기주주총회 (2012.03.23)	제64기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	
임시주주총회 (2012.02.13)	정관 변경의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
제 63기 정기주주총회 (2011.03.30)	제63기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

□SanDisk Corporation의 영업비밀 침해 소송

2014년 3월 13일에 SanDisk Corporation은 지배기업과 종속기업인 SK hynix America Inc.와 SK hynix memory solutions Inc.를 상대로 SanDisk Corporation과 Toshiba Corporation이 공동 소유한 영업비밀을 침해했다는 소송을 미국 캘리포니아 산타클라라 지방법원에 제기하였습니다. 당분기말 현재 미국 지역에서 제기된 SanDisk Corporation의 영업비밀침해 관련 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태입니다. 한편, 지배기업은 2014년 11월 6일 소송을 캘리포니아 연방법원으로 이관을 요청하였으며, 지배기업의 이관요청에 대한 SanDisk의 이의신청이 있어 이에 대한 심리가 향후 예정되어 있습니다. 당분기말 현재 소송은 초기단계로서 최종결과를 예측할 수 없습니다.

□통상임금 관련 소송

2014년 8월 1일 지배기업의 종업원 일부는 지배기업을 상대로 정기상여금, 고정시간외수당, 교대근무수당 등 각종 수당이 통상임금에 해당하므로 이를 반영하여 연장근로수당 등의 임금을 추가 지급할 것을 요청하는 통상임금 관련 소를 수원지방법원 여주지원에 제기하였습니다. 이와 관련하여 지배기업은 2014년 9월 5일 답변서를 제출하였고, 이후 수 차례에 걸쳐 변론이 진행되었으며 향후 추가변론이 예정되어 있습니다. 당분기말 현재 당사는 승소가능성이 높은 것으로 판단하여 충당부채를 인식하지 않았으나 이러한 우발상황의 최종결과는 예측할 수 없습니다.

□기타의 소송 및 특허 클레임 등

상기 소송 외에, 연결실체는 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며향후자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다

다. 그러나 당분기말 현재 이러한 우발상황의 최종결과는 예측할 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

나. 채무보증 현황

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	27	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

3. 녹색경영 현황

가. 온실가스·에너지 관리업체 지정

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스·에너지 관리업체 지정·관리 지침(환경부 고시 제2010-109호)'에 따라 2010년 9월 30일 산업·발전 부문 관리 업체로 지정되었습니다.

매년 주어지는 온실가스 및 에너지 배출 할당량을 달성하기 위해 당사는 온실가스 에너지 목표관리제 TF를 조직하여 기후변화의 영향에 신속하고 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2014년 온실가스 배출량은 3,209,561톤 CO₂e (tCO₂e), 에너지 사용량은 41,749 테라줄(TJ)입니다.

4. 합병 등의 사후 정보

가. (주)실리콘화일과의 주식의 포괄적 교환

(1) 일정

본건 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의 6 및 상법 제360조의 2 내지 제360조의 14등에 의거하여 진행됩니다.

구 분		에스케이하이닉스(주)	(주)실리콘화일
이사회 결의일		2014년 01월 27일	2014년 01월 27일
주주명부 기준일 및 폐쇄 공고		2014년 01월 27일 ※에스케이하이닉스(주)는 상법 360조10조에 따라 소규모 주식교환으로 반대의사표시 기준일 공고	2014년 01월 27일
주식 교환 계약일		2014년 01월 28일	2014년 01월 28일
주주 확정일		2014년 02월 11일	2014년 02월 11일
주주총회 소집통지일		해당사항 없음	2014년 02월 28일
주식교환 반대의사 통지 접수기간	시작일	2014년 02월 11일	2014년 02월 28일
	종료일	2014년 02월 25일	2014년 03월 16일
주식교환 승인을 위한 이사회결의일 또는 주주총회일		2014년 03월 17일 (이사회 결의)	2014년 03월 17일

주식매수청구권 행사 기간	시작일	해당사항 없음	2014년 03월 18일
	종료일	해당사항 없음	2014년 04월 07일
완전자회사가 되는 회사의 주권실효 통지 · 공고예정일		해당사항 없음	2014년 03월 18일
주식매수청구대금 지급 예정일		해당사항 없음	2014년 04월 18일
구주권 제출기간 종료 예정일		해당사항 없음	2014년 04월 21일
주식교환을 할 날		2014년 04월 22일	2014년 04월 22일
주식교환 등기 예정일		2014년 04월 23일	2014년 04월 23일
상장폐지신청 예정일		해당사항 없음	2014년 04월 24일
신주권 상장신청 예정일		2014년 05월 16일	해당사항 없음
신주권 교부 예정일		2014년 05월 22일	해당사항 없음
신주권 상장 예정일		2014년 05월 23일	해당사항 없음
상장폐지 예정일		해당사항 없음	2014년 05월 23일

(2) 주식교환의 배경

에스케이하이닉스(주)는 2008년 6월 전략적 제휴 차원에서 CMOS 이미지센서(CMOS Image Sensor, CMOS 공정으로 설계된 카메라용 이미지 센서) 전문기업인 (주)실리콘화일의 지분을 제3자 배정 유상증자에 참여하여 신주 1,179,416주(주당 6,915원, 총 81.6억원)를 취득하고 이도영 외 9인의 구주지분 중 1,179,416주(주당 12,446원, 총 146.8억원)를 취득함으로써 총 2,358,832주(총 228.4억원)를 인수하여 (주)실리콘화일의 최대주주 지위를 확보하였습니다. 이 후 양 당사 회사는 공동설계협력단을 구성하여 CMOS 이미지센서 등의 제품을 공동 개발함에 따라 연구자원을 최대한 효율적으로 활용하고 있으며, (주)실리콘화일의 기술경쟁력과 에스케이하이닉스(주)의 생산경쟁력을 기반으로 시너지 효과를 창출하여 시장에서의 경쟁우위를 확보할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

에스케이하이닉스(주)는 SK텔레콤(주)가 당사 지분 21.1%를 취득하여 최대주주가 되면서 2012년 02월 15일 SK기업집단에 편입되었으며, 이에 따라 에스케이하이닉스(주)가 최대주주인 (주)실리콘화일도 2012년 02월 15일 SK그룹에 편입되었습니다.

이에 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제4항에 따라 에스케이하이닉스(주)는 일반지주회사의 손자회사로서 보유 중인 국내계열회사(주)실리콘화일의 주식을 2년의 유예기간 만료일인 2014년 02월 14일 내에 처분하거나 발행주식총수를 보유하여야 하는 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 에스케이하이닉스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 상태를 해소하는 것과 더불어(주)실리콘화일을 완전자회사로 편입하여 경영상의 효율성을 증대하고 시너지 효과 극대화를 통해 기업가치 제고를 하고자 금번 포괄적 주식교환을 추진하게 되었습니다.

2014년 02월 13일 공정거래위원회는 에스케이하이닉스(주)가 (주)실리콘화일의 주식을 소유한 행위가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제6항에 규정된 연장 사유에 해당된다고 판단하여 2년간의 유예기간 연장신청을 승인하였으며, 이에 따라 에스케이하이닉스(주)는 2016년 02월 14일까지 (주)실리콘화일의 주식을 모두 처분하거나 발행주식총수를 보유하여야 합니다.

(3) 주식매수청구권 행사

가) 완전모회사 (에스케이하이닉스(주))

에스케이하이닉스(주)는 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

나) 완전자회사((주)실리콘화일)

법인명	매수청구가격	매수청구기간	매수청구자	매수청구 주식수	매수청구 대금	매수 일자	매수자금
(주)실리콘화일	보통주 8,055원	2014년 03월 18일 ~ 2014년 04월 07일	개인주주 총 3명	보통주 142주	1,143,810원	2013년 04월 18일	자체자금

(4) 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음.

(5) 관련 소송의 현황

본건 주식교환에 대하여 (주)실리콘화일은 이사회의 업무상 배임에 대하여 수원지방법검찰청 성남지청에 2014년 01월 29일 고소(고발)장이 접수되었습니다. (주)실리콘화일은 2014년 02월 03일 해당 고소(고발) 건과 관련하여 접수증명서를 수신하였습니다. 또한 2014년 02월 18일에 금번 주식의 포괄적 교환을 결의한 (주)실리콘화일의 이사회 결의(2014년 01월 27일) 효력정지 가처분 신청과 임시주주총회 소집 등 이사회 결의에 따른 절차의 중단을 신청하는 소장이 수원지방법원 성남지원에 접수되었으며, (주)실리콘화일은 2014년 02월 24일 해당 신청건과 관련하여 접수증명서를 수신하였습니다.

상기 사건 중 이사회 결의 효력정지 가처분 신청과 임시주주총회 소집 등 이사회 결의에 따른 절차 중단 신청과 관련하여서는 2014년 03월 13일 기각 결정이 선고되어 확정되었으며 (주)실리콘화일은 관련사항을 동일자로 공시하였습니다.

상기 사항 이외에 에스케이하이닉스(주)나 (주)실리콘화일을 상대로 본건 주식교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바는 없습니다.

(6) 신주배정 등에 관한 사항

가) 신주의 배정

주식교환일(2014년 04월 22일 0시) 현재 완전자회사가 되는 (주)실리콘화일 주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 에스케이하이닉스(주)는 제외)에 대하여 (주)실리콘화일의 보통주식(액면 500원) 1주당 완전모회사가 되는 에스케이하이닉스(주)의 보통주식(액면 5,000원) 0.2232438주를 신주로 교부(2014년 05월 22일 교부예정)할 예정이고, 그에 따라 에스케이

하이닉스(주)의 보통주식을 교부받게 될(주)실리콘화일 주주들이 보유하고 있는 (주)실리콘화일 주식은 주식교환일에 에스케이하이닉스(주)에 이전됩니다. 또한 에스케이하이닉스(주)가 보유중인 (주)실리콘화일 주식에 대해서는 에스케이하이닉스(주)의 주식을 배정하지 않을 예정이나, (주)실리콘화일이 본건 주식교환에 반대하는 (주)실리콘화일 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식에 대해서는 에스케이하이닉스(주)의 주식이 배정됩니다.

에스케이하이닉스(주)가 본건 주식교환에 따라 (주)실리콘화일의 주주(단, 에스케이하이닉스(주)는 제외)에 대해 배정한 기명식 보통주식은 총 1,358,537주로서 에스케이하이닉스(주)의 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 교부됩니다.

또한, 신주 배정시 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 주식교환으로 인하여 발행, 교부되는 에스케이하이닉스(주)의 신주가 한국거래소에 상장(2014년 05월 23일)되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 계산된 금액을 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급됩니다.

나) 교부금 지급

본건 주식교환에 있어 (주)실리콘화일 주주에게 교환비율에 따른 주식의 교부와 단주대금의 지급 이외에는 별도의 주식교환 관련 교부금 지급은 없습니다.

다) 특정주주에 대한 보상

본건 주식교환에 있어 일방당사회사 및 그 특수관계인이 타방당사회사의 특정주주에게 지급하는 특별교부금 등의 직·간접적인 추가보상은 없습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.